

上海晶丰明源半导体股份有限公司

(中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室)

首次公开发行股票

招股说明书

(申报稿)

保荐人（主承销商）：



广东省广州市黄埔区中新广州知识城

腾飞一街2号618室

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。

发行股票类型	人民币普通股（A股）	本次拟发行股数	不超过1,540万股
每股面值	1.00元	每股发行价格	[ ]元
预计发行日期	[ ]年[ ]月[ ]日	拟上市的证券交易所	上海证券交易所
发行后总股本	不超过6,160万股		
公司发行及股东发售股份数量	本次拟公开发行股票不超过1,540万股，不低于发行后总股本25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。		
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺	公司实际控制人胡黎强、刘洁茜承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。		
	公司实际控制人之一胡黎强控制的企业宁波沪蓉杭承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。		
	公司股东上海晶哲瑞、苏州奥银、珠海奥拓承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。		
	其他直接或间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员夏风、张宜、周占荣、李宁、孙顺根、汪星辰承诺：自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。		
	<p>公司董事、高级管理人员胡黎强、刘洁茜、夏风、孙顺根、汪星辰承诺：（1）公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长6个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）；（2）除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>公司监事张宜、周占荣、李宁承诺：除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p>		
保荐人（主承销商）	广发证券股份有限公司		
招股说明书签署日期	2017年9月18日		

## 声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 重大事项提示

### 一、关于股份锁定的承诺

#### 1、公司实际控制人胡黎强、刘洁茜承诺：

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

（2）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

（3）除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

2、公司实际控制人胡黎强控制的企业宁波沪蓉杭承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

3、公司股东上海晶哲瑞、苏州奥银、珠海奥拓承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

#### 4、公司股东夏风承诺：

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

（2）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

（3）除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

5、持有公司股份的高级管理人员孙顺根、汪星辰承诺：

（1）自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

（2）公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长6个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

（3）除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

6、持有公司股份的监事张宜、周占荣、李宁承诺：

（1）自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

（2）除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

## 二、持有公司股份5%以上的重要股东持股意向及减持意向的承诺

持有公司股份5%以上的股东胡黎强、夏风、上海晶哲瑞就持股意向及减持意向承诺：

1、在承诺的锁定期内，持续持有公司股份。

2、如本人/本机构所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于本次发行价格（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，发行价亦将作相应调整），每年减持数量不超过上一年末本人/本机构所持有公司股份总数的 20%。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人/本机构拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通知公司并通过公司予以公告，未履行公告程序前不进行减持；本人/本机构减持公司股份将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

如本人/本机构违反相关承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票；如因未履行上述承诺事项而获得收益的，则本人/本机构将在获得收益的 5 个交易日内将前述收益支付给公司指定账户，否则公司有权暂时扣留应支付给本人/本机构现金分红中应该上交公司违规减持所得收益金额相等的现金分红；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的，本人/本机构将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

### 三、关于稳定股价的预案及承诺

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司制定了《上海晶丰明源半导体股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》，具体如下：

#### “一、启动稳定股价措施的条件

公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。

#### 二、稳定股价的具体措施

##### （一）公司回购

1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

2、公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。

3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

4、公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：

（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额；

（2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元；

（3）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。

5、公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。

（二）实际控制人、控股股东增持

1、下列任一条件发生时，公司实际控制人、控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；

（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发；

（3）公司实际控制人、控股股东承诺按其所持公司股份比例对公司股份进行同比例增持，且单次增持总金额不应少于人民币 500 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

### （三）董事、高级管理人员增持

1、下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

（1）控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；

（2）控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的在公司领取薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

3、在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。

4、本公司如有新聘任董事、高级管理人员，本公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。

### 三、稳定股价措施的启动程序

#### （一）公司回购

1、公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出回购股份的决议。



2、公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。

3、公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕。

4、公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

## （二）控股股东及董事、高级管理人员增持

1、公司董事会应在上述控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起2个交易日内做出增持公告。

2、控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕。

## 四、稳定股价的进一步承诺

在启动条件首次被触发后，公司控股股东及持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期自动延长6个月。为避免歧义，此处持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期，是指该等人士根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第四条第（三）款的规定做出的承诺中载明的股份锁定期限。

本预案需经公司股东大会审议通过，公司完成首次公开发行A股股票并上市之日起生效，有效期三年。”

公司承诺：在公司上市后三年内，公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按照《上海晶丰明源半导体股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股份。

公司实际控制人胡黎强、刘洁茜承诺：将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票；将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

公司全体董事承诺：将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票；将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

公司全体高级管理人员承诺：将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

## 四、关于信息披露违规的承诺

### 1、发行人相关承诺

若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司回购价格为二级市场价格且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。

若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

### 2、实际控制人相关承诺

若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，实际控制人胡黎强、刘洁茜将促成公司及时启动依法回购公司首次公开发行的全部新股工作，并启动依法购回本人已转让的原限售股份工作。回购价格为二级市场价格且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。

若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

### 3、公司全体董事、监事、高级管理人员相关承诺

若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

#### 4、中介机构相关承诺

保荐机构广发证券股份有限公司承诺：因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

发行人律师国浩律师（杭州）事务所承诺：因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

申报会计师、验资机构及验资复核机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

## 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次发行后公司股本总额和净资产将大幅增加。公司募集资金将应用于公司主营业务，募集资金投资项目符合行业发展趋势及公司的发展规划。但由于募股资金投资项目实施并产生效益需要一定时间，在此之前，如公司净利润未产生相应幅度的增长，公司的每股收益和净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

因此，公司拟通过加强市场开拓，降低公司运营成本，积极实施募投项目，完善利润分配制度等方式，提高公司盈利能力，以填补被摊薄即期回报，具体措施如下：

#### 1、加强市场开拓，提高公司持续盈利能力

公司作为行业领先的 LED 照明驱动芯片供应商，主要从事模拟和混合信号集成电路的研发与销售，凭借着持续的研发投入和优良的产品质量，公司产品已具有较大的市场影响力。公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步提升公司产品品牌影响力及主营产品市场占有率。同时，公司将继

续加大研发投入和技术储备，加强自身核心技术的开发和积累，提高公司竞争能力和持续盈利能力。

## 2、提高发行人日常运营效率，降低发行人运营成本

发行人经过多年的经营积累，已经形成了较为有效的管理体系以保证日常高效运营，但随着募集资金投资项目实施，公司的业务规模将不断扩大，公司经营活动、组织架构以及管理体系均将趋于复杂，管理难度相应增加。因此，培养优秀人才、建立完善的绩效考核体系是提升公司经营业绩的必要选择。

公司将坚持“以人为本”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性；明确各岗位的职责权限、任职条件和工作要求；通过公开招聘、竞争上岗等多种方式选聘优秀人才，切实做到因事设岗、以岗选人。

公司将不断完善目标管理和绩效考核体系，设置科学的业绩考核指标，对各级管理人员和全体员工进行合理的考核与评价。公司通过晋升规划、补充规划、培训开发规划、职业规划等人力资源计划确保员工队伍持续优化，实现人力资源管理的良性循环。

## 3、积极实施募投项目，争取实现项目预期收益

本次募集资金投资项目经过公司充分论证，符合行业发展趋势及公司发展规划，项目实施后将进一步巩固和扩大公司主要产品的市场份额，提升公司综合竞争优势。在募集资金到位前，公司以自有资金先期投入建设，以争取尽早产生收益。

## 4、完善利润分配制度

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的相关要求，修订了公司章程。《公司章程（草案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行上市后三年分红回报规划》，进一步明确对新老股东权益分红的回报，细化了本次发行后关于股利分配原则的条款。

上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报，然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

公司实际控制人胡黎强、刘洁茜根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

## 六、发行前滚存未分配利润的安排及本次发行上市后的股利分配政策

### （一）发行前滚存未分配利润的安排

根据公司通过的2017年第二次临时股东大会决议：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

### （二）本次发行上市后的股利分配政策

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司发行上市后的利润分配政策如下：

（一）利润分配原则：

公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分配股利，公司利润分配政策的基本原则为：

1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利；

4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配形式及时间间隔：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律、法规允许的其他方式分配利润，分配的利润不得超过累计可分配利润的范围。具备现金分红条件的，公司优先考虑采取现金方式分配利润。公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况提议公司进行中期现金分红。

（三）利润分配政策的具体内容：

1、现金分红的具体条件：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

2、现金分红的比例：

在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下，公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### 3、发放股票股利的具体条件：

公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司经营情况良好，且董事会认为公司股本规模与公司规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，根据公司的累计可分配利润、公积金及现金流情况提出股票股利分配预案。

（四）利润分配政策的调整：若公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整或者变更利润分配政策的，董事会应当经过详细论证后，以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策。公司利润分配政策的修改由公司董事会向公司股东大会提出，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。独立董事应当对利润分配政策的修改发表意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

此外，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会制定的《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

关于股利分配的详细政策，请仔细阅读本招股说明书“第十四节 股利分配政策”关于股利分配的相关内容。

## 七、公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风险：

### （1）市场风险

公司所属集成电路设计行业正处于快速发展阶段，良好的行业前景及国家对本行业的扶持政策吸引了诸多国内企业进入本领域。公司现阶段主要产品通用 LED 照明驱动芯片经过多年的发展，技术已相对成熟，产品差异程度较小，面临竞争较为激烈。集成电路技术革新较快，产品的更新换代速度较快，若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能在产品研发、市场拓展等方面进一步巩固优势地位、保证自身核心竞争力，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。

### （2）应收账款回收风险

2014 年末至 2017 年 3 月末，公司应收账款净额分别为 2,730.87 万元、6,506.17 万元、8,155.78 万元和 9,765.21 万元，占公司各期末总资产的比重分别为 10.61%、23.60%、29.38% 和 31.06%。虽然报告期各期末公司应收账款账龄主要在半年以内且公司已制订合理的坏账计提政策并有效执行，但若公司下游客户经营不利或由于其他原因导致无法按期支付货款，将对公司应收账款回收产生不利影响。

### （3）供应链管理风险

2014 至 2017 年 1-3 月，公司向前五大供应商采购的金额分别为 23,291.87 万元、25,392.11 万元、38,713.46 万元和 10,623.03 万元，占同期采购总额的比例分别为 96.37%、89.05%、85.88% 和 77.55%，采购的集中度较高。公司已与行业内大型晶圆制造商及封装测试商建立了合作关系，未来通过进一步增加供应商数量，降低供应商集中度的空间较小，供应链管理难度较大。如公司的供应商因内



外部原因导致无法正常向公司提供相关产品及服务，将对公司的生产经营产生较大的不利影响。

#### （4）经营业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为 33,727.01 万元、35,712.04 万元、57,088.11 万元、15,309.16 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 6,688.94 万元、1,924.51 万元、2,991.53 万元、1,190.24 万元。报告期内，虽然公司的经营业绩整体上呈现增长态势，但各期增长速度仍具有一定波动性。集成电路设计企业的经营业绩受终端市场波动影响较大，LED 照明驱动芯片领域竞争较为激烈，市场供需变化快，如果公司未来芯片产品的研发和生产不能及时有效地满足市场的需求，将导致公司未来业绩存在大幅波动的风险。

# 目 录

<b>第一节 释义 .....</b>	<b>22</b>
<b>第二节 概览 .....</b>	<b>25</b>
一、公司简介.....	25
二、控股股东及实际控制人简介.....	26
三、主要财务数据.....	27
四、本次发行情况.....	28
五、募集资金主要用途.....	29
<b>第三节 本次发行概况 .....</b>	<b>30</b>
一、本次发行的基本情况.....	30
二、本次发行有关机构.....	31
三、与本次发行上市有关的重要日期.....	33
<b>第四节 风险因素 .....</b>	<b>34</b>
一、经营风险.....	34
二、财务风险.....	37
三、募集资金投资项目风险.....	37
四、所得税税收优惠政策变动风险.....	38
五、净资产收益率下降风险.....	39
<b>第五节 发行人基本情况 .....</b>	<b>40</b>
一、公司基本信息.....	40
二、公司改制设立情况.....	40
三、公司股本形成及变化和重大资产重组情况.....	42
四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.....	49
五、公司组织结构.....	49
六、公司控股子公司、参股子公司基本情况.....	51
七、股东及实际控制人的基本情况.....	52
八、公司股本情况.....	55
九、发行人历史上的委托持股情况.....	58
十、员工及其社会保障情况.....	62
十一、发行人及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的主要股东以及证券服务机构作出的重要承诺及其约束措施和履行情况.....	64
十二、公司稳定股价的预案.....	68
<b>第六节 业务和技术 .....</b>	<b>72</b>

一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.....	72
二、发行人所处行业的基本情况.....	74
三、发行人在行业中的竞争地位.....	96
四、发行人的竞争优势与劣势.....	97
五、发行人的主营业务情况.....	101
六、发行人主要固定资产及无形资产.....	109
七、主要技术及研发情况.....	120
八、主要产品的质量控制情况.....	125
<b>第七节 同业竞争与关联交易 .....</b>	<b>127</b>
一、发行人在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性情况.....	127
二、同业竞争情况.....	128
三、关联交易情况.....	129
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .....</b>	<b>143</b>
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历.....	143
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况.....	147
三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资.....	147
四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况.....	148
五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况.....	149
六、公司董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况.....	150
<b>第九节 公司治理 .....</b>	<b>152</b>
一、公司股东大会制度的建立健全及运行机制.....	152
二、公司董事会制度的建立健全及运行情况.....	153
三、公司监事会制度的建立健全及运行情况.....	154
四、公司独立董事制度的建立健全及运行情况.....	155
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.....	157
六、专门委员会的设置情况.....	157
七、公司近三年的规范运作情况.....	158
八、公司近三年资金占用和违规担保情况.....	158
九、公司内部控制制度的情况简述.....	158
<b>第十节 财务会计信息 .....</b>	<b>159</b>
一、财务报表.....	159
二、审计意见.....	173
三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.....	174
四、主要会计政策和会计估计.....	174

五、税项.....	198
六、非经常性损益.....	199
七、最近一期末主要资产情况.....	201
八、最近一期末主要债项.....	202
九、所有者权益变动情况.....	203
十、现金流量.....	203
十一、报告期内的主要财务指标.....	204
十二、资产评估情况.....	205
十三、公司设立时验资情况.....	205
<b>第十一节 管理层讨论与分析 .....</b>	<b>206</b>
一、财务状况分析.....	206
二、盈利能力分析.....	225
三、现金流量分析.....	247
四、资本性支出分析.....	250
五、会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	250
六、担保、诉讼、其他或有事项.....	250
七、公司经营优势、困难及未来发展趋势分析.....	251
八、公司未来分红回报规划及安排.....	252
九、本次发行摊薄即期回报的分析.....	254
<b>第十二节 业务发展目标 .....</b>	<b>259</b>
一、公司发展规划.....	259
二、拟定上述计划所依据的假设条件.....	261
三、实施上述计划将面临的主要困难.....	262
四、公司业务发展规划与现有业务的关系.....	262
五、本次募集资金对上述业务发展目标的作用.....	262
<b>第十三节 本次募集资金运用 .....</b>	<b>263</b>
一、募集资金运用概况.....	263
二、募集资金运用对同业竞争和独立性的影响.....	264
三、通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化项目 .....	264
四、智能 LED 照明芯片开发及产业化项目 .....	269
五、补充流动资金项目.....	275
六、新增固定资产折旧对公司经营状况的影响.....	277
七、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响.....	277
八、募集资金投资项目实施后对公司现有经营模式的影响.....	278
<b>第十四节 股利分配政策 .....</b>	<b>279</b>

一、发行人现行股利分配政策.....	279
二、近三年股利分配情况.....	279
三、发行后的股利分配政策.....	280
四、本次发行完成前滚存利润的分配安排.....	283
<b>第十五节 其他重要事项 .....</b>	<b>284</b>
一、信息披露相关情况.....	284
二、重要合同.....	284
<b>第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.....</b>	<b>287</b>
一、董事、监事、高级管理人员声明.....	287
二、保荐人（主承销商）声明.....	288
三、发行人律师声明.....	289
四、会计师事务所声明.....	290
五、资产评估机构声明.....	291
六、验资机构声明.....	292
七、验资复核机构声明.....	293
<b>第十七节 备查文件 .....</b>	<b>294</b>
一、附录和备查文件.....	294
二、整套发行申请材料和备查文件查阅地点.....	294

## 第一节 释义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

一、一般释义		
发行人、公司、本公司、晶丰明源	指	上海晶丰明源半导体股份有限公司
晶丰有限	指	上海晶丰明源半导体有限公司
上海晶哲瑞	指	上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）
苏州奥银	指	苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）
珠海奥拓	指	珠海奥拓投资中心合伙企业（有限合伙）
晶丰香港	指	晶丰明源半导体（香港）有限公司，公司的全资子公司
上海汉枫	指	上海汉枫电子科技有限公司
宁波沪蓉杭	指	宁波梅山保税港区沪蓉杭投资管理合伙企业（有限合伙）
上海兴工微	指	上海兴工微电子有限公司
苏州浩瀚	指	苏州浩瀚集成电路有限公司
上海巨微	指	上海巨微集成电路有限公司
上海湖杉	指	湖杉投资（上海）合伙企业（有限合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》
公司章程（草案）	指	《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程（草案）》
主承销商、保荐人	指	广发证券股份有限公司
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	国浩律师（杭州）事务所
A 股	指	每股面值 1.00 元的人民币普通股
新股	指	公司本次首次公开发行时拟向社会公众发行的股份
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期、最近三年一期	指	2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-3 月

二、专业释义		
集成电路、芯片、IC	指	Integrated Circuit, 一种微型电子器件或部件。采用半导体制作工艺, 把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起, 制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上, 然后封装在一个管壳内, 成为具有所需电路功能的微型结构
集成电路设计	指	将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体版图物理数据的过程
集成电路布图设计	指	又称版图设计, 集成电路设计过程的一个工作步骤, 即把有连接关系的网表转换成晶圆制造厂商加工生产所需要的布图连线图形的设计过程
模拟芯片	指	Analog IC, 处理连续性模拟信号的集成电路芯片被称为模拟芯片。模拟信号是指用电参数, 如电流和电压的值, 来模拟其他自然量而形成的电信号, 模拟信号在给定范围内通常表现为连续的信号。模拟芯片可以作为人与设备沟通的界面, 并让人与设备实现互动, 是连接现实世界与数字虚拟世界的桥梁, 也是实现绿色节能的关键器件
LED	指	发光二极管 (Light Emitting Diode) 其核心部分是由 p 型半导体和 n 型半导体组成的晶片, 在 p 型半导体和 n 型半导体之间有一个过渡层, 称为 PN 结。在半导体材料的 PN 结中, 注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余能量以光的形式释放出来, 从而把电能直接转换为光能
晶圆	指	又称 wafer, 是硅半导体集成电路制作所用的硅晶片, 由于其形状为圆形, 故称为晶圆; 在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构, 使其成为有特定电性功能的 IC 产品
MOSFET、MOS	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, 金属-氧化物半导体场效应晶体管, 是一种可以广泛使用在模拟与数字电路的场效应晶体管, 通常作为标准器件搭配驱动电路使用
封装	指	把晶圆上的硅片电路, 用导线及各种连接方式, 加工成含外壳和管脚的可使用芯片成品的生产加工过程
中测	指	晶圆针测 (Chip Probing, 简称“CP”), 针对 IC 作电性功能上的测试, 确保在封装之前先行过滤出电性功能不良的芯片, 以避免不良品增加制造成本
成测	指	封装片测试 (Final Test), 是把已封装的成品 IC 进行结构及电气功能测试的确认, 以保证 IC 符合系统的需求, 通过封装测试过滤封装存在缺陷或电性功能不良的 IC, 提高产品品质
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式, 采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售, 而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆制造、封装和测试厂商
IDM	指	Integrated Device Manufacturer 的缩写, 即集成电路整合元件企业运营模式, 该类公司采用垂直布局, 涵盖集成电

		路设计、晶圆加工及封装和测试等各业务环节，形成一体化的完整运作模式
AC/DC	指	交流转直流的电源转换器
DC/DC	指	直流转直流的电源转换器
BCD 工艺	指	一种单片集成工艺技术。这种技术能够在同一芯片上制作双极性晶体管 Bipolar、CMOS 和 DMOS 器件，因而被称为 BCD 工艺。
PWM 调光	指	Pulse Width Modulation，脉宽调制，PWM 调光是一种常见的 LED 调光方式，该种通过频闪调光的模式易于实现，可降低生产成本
FAE	指	Field Application Engineer，现场技术支持工程师，是介于产品研发和业务推广之间的技术支持者，在为客户和销售人员提供技术支持的同时，将获取的市场信息反馈给研发人员
CSIA	指	China Semiconductor Industry Association，中国半导体行业协会
CSA	指	China Solid State Lighting Alliance，国家半导体照明工程研发及产业联盟
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计协会
μm	指	微米，长度计量单位，1 微米=0.001 毫米
nm	指	纳米，长度计量单位，1 纳米=0.001 微米

注：本招股说明书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、公司简介

#### （一）简要情况

公司名称： 上海晶丰明源半导体股份有限公司

英文名称： Shanghai Bright Power Semiconductor Co., Ltd.

公司住所： 中国（上海）自由贸易试验区张衡路 666 弄 2 号 5 层 504-511 室

法定代表人： 胡黎强

注册资本： 4,620 万元

经营范围： 半导体芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售，系统集成，提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司是国内领先的模拟和混合信号集成电路设计企业之一，主营业务为模拟和混合信号集成电路的研发与销售，主要产品为 LED 照明驱动芯片，包括通用 LED 照明驱动芯片、智能 LED 照明驱动芯片等。

公司是经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国税局、上海市地税局联合认定的“高新技术企业”，荣获“上海市科技小巨人企业”、“2016 年上海市集成电路设计企业销售前十”、“中国 LED 首创奖”等荣誉称号。公司自成立以来即注重产品更新、重视技术创新。可控硅调光发光二极管驱动芯片产品荣获中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社联合评选的“第十一届（2016 年度）中国半导体创新产品和技术”荣誉，高性能有源功率因数校正驱动芯片等多项产品被评为上海市高新

技术成果转化项目。公司掌握了LED照明驱动的多项核心技术，自主研发的700V高压集成工艺、LED恒流的源极驱动技术、LED驱动芯片的供电技术、LED电流纹波消除技术、700V单芯片技术已达到行业领先水平。截至本招股说明书签署日，公司已获得国际专利2项，国内专利技术107项，集成电路布图设计专有权61项。凭借技术、品牌、产品等综合优势，公司与国内外主要的LED照明企业如飞利浦、欧普照明、雷士照明、阳光照明、三雄极光、佛山照明、得邦照明等建立了直接或间接的合作关系，2016年“中国LED照明产品出口十强企业”全部企业均配套应用了发行人LED照明驱动芯片。公司已成为国内LED照明驱动芯片细分领域的领先企业之一，主要产品LED照明驱动芯片市场占有率位于前列，在LED照明驱动芯片领域具有较强的竞争优势。

2014年至2017年1-3月，公司分别实现营业收入33,727.01万元、35,712.04万元、57,088.11万元、15,309.16万元，归属于母公司的净利润分别为6,688.94万元、1,924.51万元、2,991.53万元、1,190.24万元。未来公司将依托技术、品牌等综合优势，专注于LED照明驱动芯片的研发与销售，以研发创新为持续发展的驱动力，力争保持领先的市场地位。

**（二）主要竞争优势**（公司竞争优势的详细分析参见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人的竞争优势与劣势”之“（一）竞争优势”有关内容）。

## 二、控股股东及实际控制人简介

截至本招股说明书签署日，胡黎强直接持有公司股份1,656.45万股，通过上海晶哲瑞和苏州奥银间接持有公司18.72万股，合计持有公司1,675.17万股，占公司总股本的36.26%，为公司控股股东。胡黎强、刘洁茜夫妇直接和间接控制公司64.69%的表决权，同时胡黎强担任公司董事长兼总经理，刘洁茜担任公司董事兼副总经理，胡黎强、刘洁茜夫妇为公司实际控制人。公司实际控制人的简要情况如下：

胡黎强：男，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：33012719760116\*\*\*\*，住所为上海市浦东新区罗山路\*\*\*\*。

刘洁茜：女，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：51102419760828\*\*\*\*，住所为上海市浦东新区罗山路\*\*\*\*。

详细情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“（一）董事会成员”。

### 三、主要财务数据

#### （一）简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
资产总额	31,436.50	27,758.16	27,563.15	25,747.60
流动资产	27,344.34	23,849.58	24,021.69	23,913.78
固定资产	450.07	354.57	386.57	354.18
负债总额	17,648.88	17,825.19	7,731.40	8,451.15
流动负债	16,326.01	17,153.41	7,284.59	8,090.94
归属于母公司股东权益	13,787.62	9,932.97	19,831.76	17,296.45

#### （二）简要合并利润表

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	15,309.16	57,088.11	35,712.04	33,727.01
营业利润	1,312.25	2,588.39	877.74	6,875.12
利润总额	1,322.45	3,454.07	1,974.11	7,645.72
净利润	1,190.24	2,991.53	1,924.51	6,688.94
归属母公司股东的净利润	1,190.24	2,991.53	1,924.51	6,688.94

#### （三）简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,833.49	7,973.30	-2,265.85	4,698.76
投资活动产生的现金流量净额	968.60	-2,221.12	-2,583.29	-1,121.19
筹资活动产生的现金流量净额	2,581.59	-8,192.34	43.37	-197.80
汇率变动对现金的影响	-14.11	123.53	16.18	0.25
现金及现金等价物净增加额	1,702.60	-2,316.63	-4,789.59	3,380.01

#### （四）主要财务指标

项目	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
流动比率	1.67	1.39	3.30	2.96
速动比率	1.33	1.16	2.72	2.40
资产负债率（母公司）	56.14%	64.16%	28.05%	32.82%
每股净资产（元）	2.98	2.99	18.03	17.30
无形资产占净资产比例 （扣除土地使用权）	3.83%	2.97%	0.02%	0.03%

项目	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
存货周转率（次）	2.54	11.24	6.57	6.20
应收账款周转率（次）	1.71	7.79	7.73	13.28
息税折旧摊销前利润（万元）	1,377.11	3,696.59	2,128.48	7,703.86
归属于发行人股东的净利润（万元）	1,190.24	2,991.53	1,924.51	6,688.94
归属于发行人股东扣除非经常性 损益后的净利润（万元）	1,165.93	3,224.47	1,348.32	6,182.08
利息保障倍数	-	40.09	35.86	2,735.28
每股净现金流量（元）	0.51	-0.70	-1.44	1.02
每股经营活动产生的现金流量净 额（元）	-0.55	2.40	-0.68	1.41

#### 四、本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行数量	不超过1,540万股
发行价格	[ ]元/股

发行方式	网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式
发行对象	符合相关资格规定的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等（中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销

## 五、募集资金主要用途

本次募集资金计划拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟募集资金投资额 (万元)
1	通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化项目	16,890.00	16,890.00
2	智能 LED 照明芯片开发及产业化项目	24,130.00	24,130.00
3	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		<b>55,020.00</b>	<b>55,020.00</b>

若本次发行实际募集资金低于募集资金项目总投资额，资金缺口部分将由公司通过自筹方式解决。关于本次募集资金项目详细情况详见本招股说明书“第十三节 本次募集资金运用”。

## 第三节 本次发行概况

### 一、本次发行的基本情况

（一）股票种类：人民币普通股（A股）

（二）每股面值：1.00元

（三）发行股数及占发行后总股本的比例：本次公开发行股份数量不超过1,540万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

（四）每股发行价：[ ]元/股

（五）市盈率：[ ]倍（计算口径： ）

（六）发行前每股净资产：2.98元/股（以2017年3月31日经审计的归属于母公司股东的净资产值全面摊薄计算）

（七）发行后每股净资产：[ ]元/股（全面摊薄）

（八）发行市净率：[ ]倍（计算口径： ）

（九）发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式

（十）发行对象：符合相关资格规定的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等（中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外）

（十一）承销方式：余额包销

（十二）预计募集资金总额：本次发行预计募集资金[ ]亿元

（十三）预计募集资金净额：扣除发行费用后本次发行募集资金[ ]亿元

（十四）发行费用概算：

费用项目	金额
------	----

承销费用与保荐费用	[ ]万元
审计费用与验资费用	[ ]万元
律师费用	[ ]万元
评估费用	[ ]万元
路演推介及信息披露费用	[ ]万元

## 二、本次发行有关机构

### （一）发行人：上海晶丰明源半导体股份有限公司

住 所	中国（上海）自由贸易试验区张衡路 666 弄 2 号 5 层 504-511 室
法定代表人	胡黎强
联系人	汪星辰
联系电话	021-51870166
传 真	021-50275095

### （二）保荐机构：广发证券股份有限公司

住 所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人	孙树明
联系电话	020-87555888
传 真	020-87553577
保荐代表人	孟晓翔、林文坛
项目协办人	胡德
其他项目组成员	苏海灵、余冬、蒋文凯、周桂玲

### （三）律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

住 所	浙江省杭州市西湖区杨公堤 15 号国浩律师楼
负责人	沈田丰
联系电话	0571-85775888
传 真	0571-85775643
经办律师	王侃、孙敏虎

### （四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住 所	上海市南京东路 61 号 4 楼
负责人	朱建弟
联系电话	021-63391166
传 真	021-63392558
经办注册会计师	唐国骏、谢嘉

#### （五）资产评估机构：银信资产评估有限公司

住 所	嘉定工业区叶城路 1630 号 4 幢 1477 室
法定代表人	梅惠民
联系电话	021-63391088
传 真	021-63391116
经办资产评估师	刘媛媛、侯旭芳

#### （六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地 址	上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
联系电话	021-58708888
传 真	021-58899400

#### （七）主承销商收款银行：工商银行广州市分行第一支行

户 名	广发证券股份有限公司
收款账号	3602000109001674642

#### （八）申请上市交易所：上海证券交易所

住 所	上海市浦东南路 528 号证券大厦
电 话	021-68808888
传 真	021-68804868

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。



### 三、与本次发行上市有关的重要日期

- |               |              |
|---------------|--------------|
| （一）刊登初步询价公告日期 | [ ]年[ ]月[ ]日 |
| （二）开始询价推介日期   | [ ]年[ ]月[ ]日 |
| （三）刊登发行公告日期   | [ ]年[ ]月[ ]日 |
| （四）申购日期       | [ ]年[ ]月[ ]日 |
| （五）缴款日期       | [ ]年[ ]月[ ]日 |
| （六）股票上市日期     | [ ]年[ ]月[ ]日 |

## 第四节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

### 一、经营风险

#### （一）市场风险

公司所属集成电路设计行业正处于快速发展阶段，良好的行业前景及国家对本行业的扶持政策吸引了诸多国内企业进入本领域。公司现阶段主要产品通用LED照明驱动芯片经过多年的发展，技术已相对成熟，产品差异程度较小，面临竞争较为激烈。集成电路技术革新较快，产品的更新换代速度较快，若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能在产品研发、市场拓展等方面进一步巩固优势地位、保证自身核心竞争力，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。

#### （二）产品结构风险

报告期内，公司主要产品为LED照明驱动芯片，虽然产品型号较多，但产品种类较为单一，下游应用领域集中在LED照明行业。单一的产品类型及下游应用帮助公司在发展初期集中精力实现技术突破，快速占领细分市场并建立竞争优势，但同时也导致公司整体抗风险能力不足，对下游行业需求依赖程度较高。如果LED照明产品的市场需求发生重大不利变化，而公司未能在短时间内完成新产品的研发和市场布局，将会对公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。

#### （三）业务模式风险

公司采用集成电路设计行业较为常见的Fabless运营模式，即主要从事芯片的设计及销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节交由晶圆制造厂商和封装测试厂商完成。集成电路制造行业市场化程度较高且公司与行业内主要的晶圆制造厂商和封装测试厂商均建立了长期合作关系，凭借稳定的加工量获得了一定的产能

保障。但若集成电路行业产能与需求关系发生了较大变化，导致晶圆制造厂商和封装测试厂商产能出现不足，公司产品供应将受到直接影响。

#### （四）毛利率下降风险

报告期初，公司因掌握部分技术优势，产品售价中包含较大部分的技术溢价，毛利率相对较高。随着市场竞争的加剧，公司毛利率在报告期初出现了下滑的情况。报告期内，公司综合毛利率分别为 34.60%、20.29%、20.78%和 21.80%。2015 年以来，公司毛利率在稳定中略有上升，但若未来公司丧失产品技术优势、市场竞争进一步加剧、市场供求形势出现重大变化、采购成本进一步提高或者出现产品销售价格下降等情况，将导致公司毛利率下降。

#### （五）新产品研发风险

集成电路设计产业具有产品更新换代快的特点，持续研发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段。公司始终坚持以客户需求为导向，注重在新产品开发、技术升级的基础之上对客户需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场后能够取得良好效果。但随着市场竞争的不断加剧，LED 照明驱动芯片产品的更新时间不断缩短，照明产品智能化趋势对驱动芯片提出了更高的要求，如果公司不能及时准确地把握市场需求和技术趋势、突破技术难关，无法研发出具有商业价值、符合市场需求的新产品，将导致研发投入无法收回，对公司市场竞争能力和持续盈利能力产生不利影响。

#### （六）核心技术人员流失及技术失密风险

集成电路设计行业属于技术密集型行业，行业内企业的核心竞争力体现在技术储备及研发能力上，对技术人员的依赖程度较高。报告期内，公司的核心技术主要由少数核心技术人员以及核心技术研发团队掌握，存在技术泄密风险；当前公司多项产品和技术处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成技术泄密的风险；此外，公司的Fabless经营模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。

一旦核心技术失密，公司可以通过法律途径维护合法权益，但仍需为此付出大量人力、物力及时间，仍可能对公司业务发展造成不利影响。

### （七）供应链管理风险

2014 至 2017 年 1-3 月，公司向前五大供应商采购的金额分别为 23,291.87 万元、25,392.11 万元、38,713.46 万元和 10,623.03 万元，占同期采购总额的比例分别为 96.37%、89.05%、85.88%和 77.55%，采购的集中度较高。公司已与行业内大型晶圆制造商及封装测试商建立了合作关系，未来通过进一步增加供应商数量，降低供应商集中度的空间较小，供应链管理难度较大。如公司的供应商因内外部原因导致无法正常向公司提供相关产品及服务，将对公司的生产经营产生较大的不利影响。

### （八）成长性风险

公司主营业务为模拟和混合信号集成电路的研发与销售。报告期内，公司业绩实现了快速增长，营业收入从2014年的33,727.01万元增长到2016年的57,088.11万元，年均复合增长率为30.10%。公司未来能否保持持续成长仍然受到国家产业政策、技术创新、人才储备、研发投入、市场推广、经营管理等诸多因素影响，公司存在着成长不能达到预期或经营业绩增长放缓甚至下滑的风险。

### （九）经营业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为 33,727.01 万元、35,712.04 万元、57,088.11 万元、15,309.16 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 6,688.94 万元、1,924.51 万元、2,991.53 万元、1,190.24 万元。报告期内，虽然公司的经营业绩整体上呈现增长态势，但各期增长速度仍具有一定波动性。集成电路设计企业的经营业绩受终端市场波动影响较大，LED 照明驱动芯片领域竞争较为激烈，市场供需变化快，如果公司未来芯片产品的研发和生产不能及时有效地满足市场的需求，将导致公司未来业绩存在大幅波动的风险。

## 二、财务风险

### （一）应收账款回收风险

2014年末至2017年3月末，公司应收账款净额分别为2,730.87万元、6,506.17万元、8,155.78万元和9,765.21万元，占公司各期末总资产的比重分别为10.61%、23.60%、29.38%和31.06%。虽然报告期各期末公司应收账款账龄主要在半年以内且公司已制订合理的坏账计提政策并有效执行，但若公司下游客户经营不利或由于其他原因导致无法按期支付货款，将对公司应收账款回收产生不利影响。

### （二）存货跌价风险

2014年末至2017年3月末，公司存货的账面价值分别为4,484.75万元、4,177.08万元、3,869.85万元和5,560.55万元，占总资产的比例分别为17.42%、15.15%、13.94%和17.69%，占流动资产的比例分别为18.75%、17.39%、16.23%和20.34%。随着公司业务规模的不断扩大，存货绝对额也会随之上升。公司产品技术更新换代速度较快，如果未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，将增加计提存货跌价准备的风险，对公司经营业绩及经营现金流产生不利影响。

## 三、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟募集资金投资额 (万元)
1	通用LED照明驱动芯片开发及产业化项目	16,890.00	16,890.00
2	智能LED照明芯片开发及产业化项目	24,130.00	24,130.00
3	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		<b>55,020.00</b>	<b>55,020.00</b>

本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素而做出的，有利于进一步增强公司产品竞争力。但本次募投项目可能存在以下风险：

## （一）项目实施风险

集成电路设计行业研发项目具有高投入、周期长和高风险的特点，本次募投项目建设期计划为 36 个月，项目建设期间，公司可能面临来自市场变化、技术革新、运营管理等方面的挑战，任何一项因素向不利于公司的方向转化，都有可能

导致项目投资效益不能如期实现，进而导致公司的盈利能力下降。

## （二）项目产品的市场风险

本次募集资金投资项目所开发的通用 LED 照明驱动芯片、智能 LED 照明驱动芯片均为公司已具备一定技术基础，相关产品经过市场认可的产品，公司已对上述募集资金投资项目产品的市场前景进行了充分的调研和论证，公司现有的营销渠道及营销人员可以帮助上述产品快速实现市场推广，是项目经济效益实现的保障。但公司在开拓新市场、推销新产品的过程中依然会面临一定的不确定性。如果上述新产品未来的市场需求增长低于预期，或新产品的市场推广进展与公司预测产生偏差，将会导致募集资金投资项目投产后达不到预期效益的风险。

## （三）折旧摊销增加的风险

报告期内，公司固定资产和无形资产规模较小，本次募集资金将增加公司研发设备投入、生产场所投入等，项目建成后，固定资产将有一定程度的增加。在现有会计政策不变的情况下，公司每年固定资产折旧及无形资产摊销也将相应增加。若募投项目未能达到预期收益水平，将面临因折旧摊销增加导致业绩下滑的风险。

## 四、所得税税收优惠政策变动风险

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）和《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）的规定，公司享受软件企业自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至五年减半征收企业所得税。根据《企业所得税优惠事先备案结果通知书》（浦税十五所备（2012）第

036X号), 公司 2011-2012 年免征所得税, 2013-2015 年减半征收, 税率为 12.5%。2014 年度公司企业所得税按应纳税所得额的 12.5%计缴。

根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），公司 2015 年度符合国家规划布局内重点集成电路设计企业有关企业所得税税收优惠条件，2015 年按照 10%的优惠税率缴纳企业所得税。

公司于 2012 年 11 月 18 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业，并于 2015 年 10 月 30 日通过了高新技术企业复审，取得了《高新技术企业证书》，证书号：GR201531000545。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），本公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2016 年度、2017 年 1-3 月企业所得税实际执行税率为 15%。

如果未来公司所享受的税收优惠政策发生较大变化，将对公司的经营业绩带来较大的不利影响。

## 五、净资产收益率下降风险

报告期内，公司实现净利润分别为6,688.94万元、1,924.51万元、2,991.53万元及1,190.24万元，而加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润口径）分别为47.80%、10.50%、19.08%和11.31%。本次发行完成后，公司净资产规模将有较大幅度增长，而募集资金从投入到产生效益需要一定的建设周期和达产周期，因此，本次发行完成后，公司存在发行当年净利润增长幅度将小于净资产增长幅度，导致公司面临净资产收益率下降的风险。

## 第五节 发行人基本情况

### 一、公司基本信息

- （一）中文名称：上海晶丰明源半导体股份有限公司
- （二）英文名称：Shanghai Bright Power Semiconductor Co., Ltd.
- （三）注册资本：4,620 万元
- （四）法定代表人：胡黎强
- （五）成立日期：2008 年 10 月 31 日（2017 年 2 月 8 日变更为股份公司）
- （六）法定住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 666 弄 2 号 5 层  
504-511 室
- （七）总经理：胡黎强
- （八）董事会秘书：汪星辰
- （九）联系电话：021-51870166
- （十）传真：021-50275095
- （十一）邮政编码：201203
- （十二）电子信箱：bpsemi@bpsemi.com
- （十三）公司网址：www.bpsemi.com

### 二、公司改制设立情况

#### （一）公司设立方式

公司系根据晶丰有限截至 2016 年 11 月 30 日经审计的净资产值为基础，折合 4,500 万股整体变更设立的股份有限公司。

公司于 2017 年 2 月 8 日取得上海市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913100006810384768）。



## （二）公司发起人

公司设立时的总股本为 4,500 万股，发起人为胡黎强、夏风、上海晶哲瑞。公司发起设立时，各发起人的持股数量及持股比例如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	胡黎强	1,656.45	36.81%
2	夏风	1,511.55	33.59%
3	上海晶哲瑞	1,332.00	29.60%
	合计	<b>4,500.00</b>	<b>100.00%</b>

## （三）发行人设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司主要发起人为胡黎强。发行人设立前，胡黎强拥有的主要资产为持有的晶丰有限股权，从事的主要业务为对晶丰有限的投资及经营管理。发行人设立前后，公司主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务未发生变化。

## （四）公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

股份有限公司成立时承继了晶丰有限的整体资产及全部业务，拥有的主要资产为晶丰有限的经营性资产，从事的主要业务为模拟和混合信号集成电路的研发与销售。公司主要资产详细情况参见“第六节 业务和技术”之“六、发行人主要固定资产及无形资产”。

## （五）改制前原企业的业务流程、改制后公司的业务流程，以及原企业和公司业务流程间的联系

改制后公司的业务流程与改制前晶丰有限的业务流程没有发生变化，公司的业务流程参见“第六节 业务和技术”之“五、发行人的主营业务情况”之“（三）主要经营模式”。

## （六）公司成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

公司主要发起人为胡黎强，公司成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系未发生变化。

### **（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况**

晶丰有限整体变更为股份有限公司后，其资产负债全部由公司承继，相应的财产及权属证书由公司办理更名手续。具体情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“六、发行人主要固定资产及无形资产”。

## **三、公司股本形成及变化和重大资产重组情况**

### **（一）公司设立以来股本的形成及变化情况**

时间	事项	基本情况
2008年10月	设立晶丰有限 (注册资本 200.00 万元)	胡黎强、夏风、付利军出资设立晶丰有限。
2009年10月	第一次增资 (注册资本 300.00 万元)	注册资本增至 300.00 万元,由各股东按原出资比例增资。
2012年6月	第一次股权转让 (注册资本 300.00 万元)	胡黎强、夏风将其持有的部分股权转让给上海晶哲瑞。
2013年6月	第二次增资 (注册资本 1,000.00 万元)	胡黎强、夏风、付利军、上海晶哲瑞分别以货币增资 248.30 万元、227.50 万元、31.20 万元、193.00 万元。
2015年4月	第三次增资 (注册资本 1,100.00 万元)	胡黎强、夏风、付利军、上海晶哲瑞分别以货币增资 16.38 万元、14.99 万元、2.03 万元、66.60 万元。
2015年8月	第二次股权转让 (注册资本 1,100.00 万元)	付利军将其持有的全部股权分别转让给胡黎强、夏风。
2016年11月	第四次增资 (注册资本 3,324.00 万元)	注册资本增至 3,324.00 万元,由各股东按原出资比例增资。
2017年2月	整体变更为股份公司 (注册资本 4,500.00 万元)	胡黎强、夏风、上海晶哲瑞共同发起设立股份有限公司,注册资本为 4,500.00 万元。
2017年3月	第五次增资 (注册资本 4,620.00 万元)	苏州奥银、珠海奥拓分别以货币增资 75.00 万元、45.00 万元。

### 1、设立晶丰有限（2008年10月，注册资本200.00万元）

2008年10月，胡黎强、夏风、付利军决定共同出资200.00万元设立晶丰有限，其中：胡黎强以货币出资96.40万元，夏风以货币出资94.00万元，付利军以货币出资9.60万元。

根据上海申洲大通会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（申洲大通（2008）验字第588号），晶丰有限注册资本已足额到位，均为货币出资。

2008年10月31日，晶丰有限取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：310115001096131）。

晶丰有限设立时，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	胡黎强	96.40	48.20%
2	夏风	94.00	47.00%
3	付利军	9.60	4.80%
合计		<b>200.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、第一次增资（2009年10月，注册资本300.00万元）

2009年7月14日，晶丰有限召开股东会，决议同意：注册资本由200.00万元增至300.00万元，增资价格为1.00元/出资额，由各股东按原出资比例增资。

根据上海申洲大通会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（申洲大通（2009）验字第410号），晶丰有限新增注册资本已足额到位，均为货币出资。

2009年10月23日，晶丰有限就上述增资事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，晶丰有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	胡黎强	144.60	48.20%
2	夏风	141.00	47.00%
3	付利军	14.40	4.80%
合计		<b>300.00</b>	<b>100.00%</b>

## 3、第一次股权转让（2012年6月，注册资本300.00万元）

2012年4月2日，晶丰有限召开股东会，决议同意：胡黎强将其持有的30.00万元出资额以150.00万元的价格转让给上海晶哲瑞；夏风将其持有的36.00万元出资额以180.00万元的价格转让给上海晶哲瑞。股权转让各方分别签署了《股权转让协议》。

2012年6月7日，晶丰有限就上述股权转让办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，晶丰有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	胡黎强	114.60	38.20%
2	夏风	105.00	35.00%
3	上海晶哲瑞	66.00	22.00%
4	付利军	14.40	4.80%
合计		<b>300.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 4、第二次增资（2013年6月，注册资本1,000.00万元）

2013年5月29日，晶丰有限召开股东会，决议同意：注册资本由300.00万元增至1,000.00万元，增资价格为1.00元/出资额，其中：胡黎强以货币增资248.30万元，夏风以货币增资227.50万元，付利军以货币增资31.20万元，上海晶哲瑞以货币增资193.00万元。

根据上海瑞通会计师事务所（普通合伙）出具的《验资报告》（沪瑞通会验字（2013）第060002号），晶丰有限新增注册资本已足额到位，均为货币出资。

2013年6月9日，晶丰有限就上述增资事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，晶丰有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	胡黎强	362.90	36.29%
2	夏风	332.50	33.25%
3	上海晶哲瑞	259.00	25.90%
4	付利军	45.60	4.56%
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 5、第三次增资（2015年4月，注册资本1,100.00万元）

2015年1月17日，晶丰有限召开股东会，决议同意：注册资本由1,000万元增至1,100万元，增资价格为1.00元/出资额，其中：胡黎强以货币增资16.38万元，夏风以货币增资14.99万元，付利军以货币增资2.03万元，上海晶哲瑞以货币增资66.60万元。

2015年4月8日，晶丰有限就上述增资事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，晶丰有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	胡黎强	379.28	34.48%
2	夏风	347.49	31.59%
3	上海晶哲瑞	325.60	29.60%
4	付利军	47.63	4.33%
合计		<b>1,100.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 6、第二次股权转让（2015年8月，注册资本1,100.00万元）

2015年6月20日，晶丰有限召开股东会，决议同意：付利军将其持有的25.63万元出资额以433.27万元的价格转让给胡黎强，将其持有的22.00万元出资额以371.59万元的价格转让给夏风。同日，股权转让各方签署了《股权转让协议》。

2015年8月9日，晶丰有限就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，晶丰有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	胡黎强	404.91	36.81%
2	夏风	369.49	33.59%
3	上海晶哲瑞	325.60	29.60%
合计		<b>1,100.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 7、第四次增资（2016年11月，注册资本3,324.00万元）

2016年11月11日，晶丰有限召开股东会，决议同意：以未分配利润2,224.00万元转增注册资本，注册资本由1,100.00万元增至3,324.00万元，由各股东按原出资比例增资。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10032号），晶丰有限注册资本已足额到位。

2016年11月23日，晶丰有限就上述增资事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，晶丰有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	胡黎强	1,223.56	36.81%
2	夏风	1,116.53	33.59%
3	上海晶哲瑞	983.90	29.60%
合计		<b>3,324.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 8、股份公司的设立（2017年2月，注册资本4,500.00万元）

2017年1月6日，晶丰有限召开股东会，决议同意：以截至2016年11月30日经审计的净资产10,294.58万元为基础折合股份总数4,500.00万股，整体变更为股份有限公司。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10316号），公司注册资本已足额到位。

2017年2月8日，晶丰明源就上述事项办理了工商变更登记手续并换取《营业执照》（统一社会信用代码：913100006810384768）。

股份公司设立时，股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	胡黎强	1,656.45	36.81%
2	夏风	1,511.55	33.59%
3	上海晶哲瑞	1,332.00	29.60%
合计		<b>4,500.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 9、第五次增资（2017年3月，注册资本4,620.00万元）

2017年3月2日，晶丰明源召开股东大会，决议同意：注册资本由4,500.00万元增至4,620.00万元，增资价格为22.22元/股，其中：苏州奥银以货币增资75.00万元，珠海奥拓以货币增资45.00万元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15479号），公司注册资本已足额到位，均为货币出资。

2017年3月21日，晶丰明源就上述增资事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，晶丰明源股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	胡黎强	1,656.45	35.85%
2	夏风	1,511.55	32.72%
3	上海晶哲瑞	1,332.00	28.83%
4	苏州奥银	75.00	1.62%
5	珠海奥拓	45.00	0.97%
合计		<b>4,620.00</b>	<b>100.00%</b>

## （二）公司设立以来的主要资产重组情况及主要资产收购和出售情况

公司设立以来，未发生重大资产重组行为或重大资产收购及出售行为。

公司分别于2016年3月、2017年5月完成两次资产收购，具体情况如下：

报告期内，为增强在智能LED照明驱动芯片及电机驱动芯片产品的技术储备，丰富公司产品线，公司分别于2016年3月、2017年5月购买成都岷创科技有限公司、英特格灵芯片（天津）有限公司部分资产：

单位：万元

公司名称	收购资产内容	收购金额
成都岷创 科技有限 公司	无形资产（包括多项发明专利、实用新型专利、专有技术、集成电路布图设计等）	295.74
	存货（包括晶圆、光刻板、产成品等）	108.09
	固定资产（包括EMI接收机、功率计等）	0.23
	小计	404.07
英特格灵 芯片（天 津）有限公 司	无形资产（包括多项发明专利、光刻板Mask）	956.49
	存货（晶圆、产成品等）	223.17
	固定资产（磁滞测功机、电机测试系统）	7.89
	小计	1,187.55



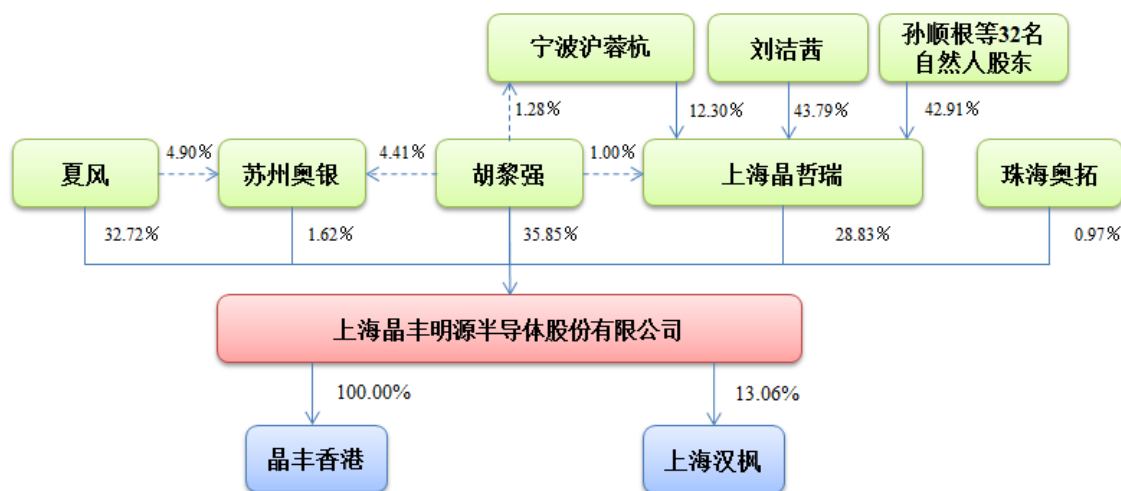
发行人收购成都岷创科技有限公司、英特格灵芯片（天津）有限公司资产占收购前一会计年度末总资产的比例分别为 1.47%和 4.28%，对发行人财务数据及经营状况的影响较小。

#### 四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

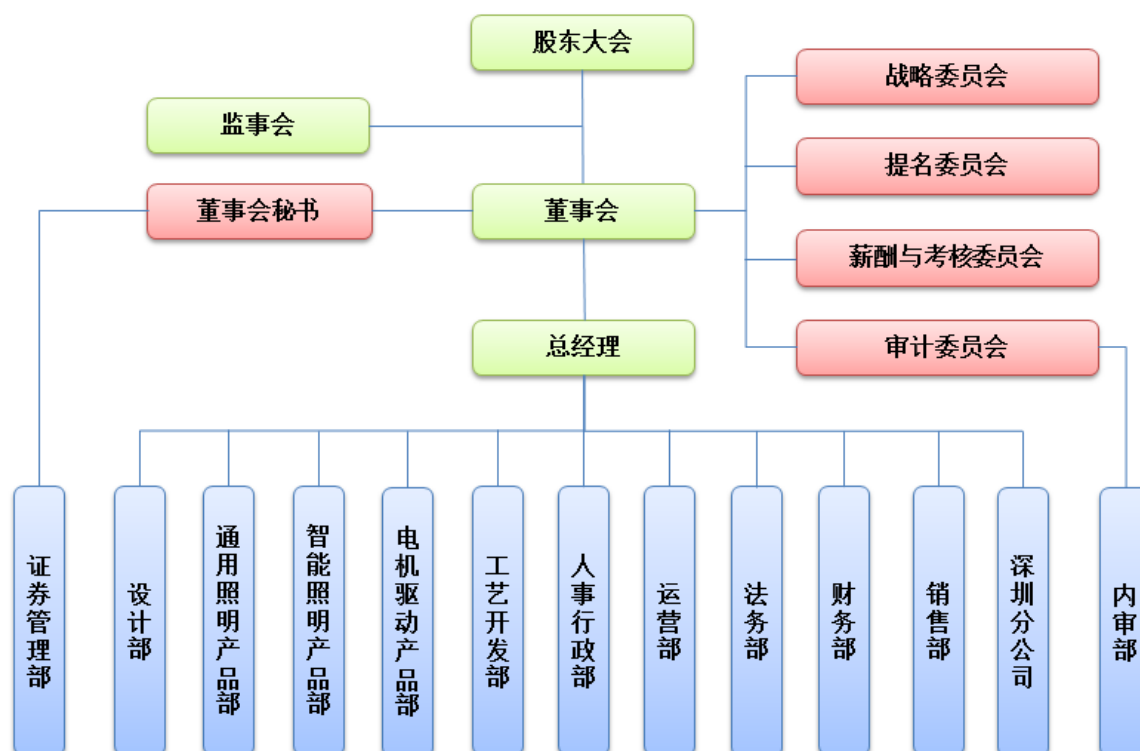
序号	报告出具日期	验资机构	验资报告编号	验资事项	出资方式
1	2008年10月22日	上海申洲大通会计师事务所有限公司	申洲大通（2008）验字第588号	设立晶丰有限，注册资本200万元	货币资金
2	2009年10月12日	上海申洲大通会计师事务所有限公司	申洲大通（2009）验字第410号	晶丰有限增资至300万元	货币资金
3	2013年6月5日	上海瑞通会计师事务所（普通合伙）	沪瑞通会验字（2013）第060002号	晶丰有限增资至1,000万元	货币资金
4	2017年1月5日	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	信会师报字[2017]第ZA10032号	晶丰有限增资至3,324万元	未分配利润转增
5	2017年1月21日	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	信会师报字[2017]第ZA10316号	晶丰有限整体变更为股份公司	净资产折股
6	2017年4月11日	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	信会师报字[2017]第ZA15479号	晶丰明源增资至4,620万元	货币资金
7	2017年7月31日	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	信会师报字[2017]第ZA15884号	验资复核	-

#### 五、公司组织结构

##### （一）公司股权结构



##### （二）公司内部组织结构



公司各主要职能部门情况如下表：

序号	职能部门名称	主要职责
1	证券管理部	负责组织实施及管理企业资本市场运作；负责公司股东大会、董事会及监事会的筹备工作，并保管相关会议文件；负责协调公司与投资者间的关系；负责公司在证券媒体的形象宣传工作；负责公司信息披露工作并执行信息披露管理制度和重大信息披露的内部报告制度。
2	设计部	负责通用照明产品部、智能照明产品部、电机驱动产品部的系统设计、电路设计、版图设计、流片、中/成测开发、芯片评估、典型方案开发等一系列产品设计开发工作。
3	通用照明产品部	负责通用 LED 照明驱动产品的经营管理，包括市场占有率、销售额、毛利、费用；负责产品线所有产品的生命周期，从产品定义、产品开发、市场导入、量产管理到退出市场。
4	智能照明产品部	负责智能 LED 照明驱动产品的经营管理，包括市场占有率、销售额、毛利、费用；负责产品线所有产品的生命周期，从产品定义、产品开发、市场导入、量产管理到退出市场。
5	电机驱动产品部	负责电机驱动产品的经营管理，包括市场占有率、销售额、毛利、费用；负责产品线所有产品的生命周期，从产品定义、产品开发、市场导入、量产管理到退出市场。
6	工艺开发部	负责建立工艺模拟平台开发新工艺，建立工艺流程，完成流片并提取模型；负责向代工厂转移技术获取自主工艺产能；负责根据市场需求，确定关键器件及要求；负责提出新结构、新工艺，以达到优化质量与成本的效果。

7	人事行政部	负责建立有效的招聘体系，及时招聘到公司需要的优秀人才；负责建立明确的员工培训流程及制度，做好员工培训计划及实施安排；负责根据国家政策，完成员工各类用工手续的办理、合同的签订解除以及各项福利、津贴规划；负责建立公司内部薪酬体系，完成各岗位薪酬规划及调整等；负责建立绩效评估体系，明确公司内部组织架构及各岗位职责、权限、考评等；负责公司内部沟通及员工关系平台的构建。
8	运营部	负责构建公司供应链体系，管理供应商，平衡产需关系；管理客户订单，安排生产计划，利用仓储物流系统满足客户需求；维护产品工程体系和测试工程体系，服务于公司产品线新产品的要求和量产产品的维护；建立公司质量体系，监控预防质量事故的发生、管理内部流程的合规及处理客户投诉等。
9	法务部	负责知识产权申请和维护、提供法务服务、政府补贴项目申报；负责为公司运营、管理提供法律支持，实现公司合规化管理，规避公司法律风险，维护公司合法权益。
10	财务部	负责公司日常会计核算，保证会计信息真实完整；负责制定财务和税务制度和规范，保护公司资产完整、降低公司财务和税务风险；负责提供财务预算、财务报表和财务分析数据，为管理层决策提供数据的支持；负责搭建公司的 IT 架构、IT 系统应用支持以及桌面应用支持。
11	销售部	负责根据公司年度目标带领团队完成销售业绩目标；负责进行重点客户的发现和突破，构建立体的客户关系网；负责销售渠道的管理和维护；负责销售管理系统建设和维护。
12	内审部	负责对本公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；负责对本公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等。

## 六、公司控股子公司、参股子公司基本情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有 1 家全资子公司及 1 家参股公司，其基本情况如下：

### （一）晶丰香港

公司名称	晶丰明源半导体（香港）有限公司	成立时间	2016 年 5 月 10 日
注册资本	5.00 万美元	实收资本	5.00 万美元
注册地和 主要生产经营地	Rooms 05-15, 13A/F., South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong		
主营业务	公司产品的海外销售及服务		

股权结构	股东名称		股权比例	
	晶丰明源		100.00%	
	合计		100.00%	
主要财务数据 (单位:万元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)	2016年12月31日		2017年3月31日	
	总资产	31.67	总资产	87.75
	净资产	9.29	净资产	22.21
	2016年度		2017年1-3月	
	净利润	4.29	净利润	12.92

## (二) 上海汉枫

公司名称	上海汉枫电子科技有限公司	成立时间	2011年3月28日	
注册资本	639.3882万元	实收资本	639.3882万元	
注册地和主要生产经营地	浦东新区川沙路955弄10幢224室			
主营业务	嵌入式无线通讯产品的设计开发、生产、销售			
股权结构	股东名称		股权比例	
	百度时代网络技术(北京)有限公司		15.00%	
	谢森		14.66%	
	邱海一		14.66%	
	董钢辉		14.47%	
	陈誓东		14.08%	
	上海枫源投资中心(有限合伙)		14.08%	
	晶丰明源		13.06%	
	合计		100.00%	
主要财务数据 (单位:万元,未经审计)	2016年12月31日		2017年3月31日	
	总资产	4,900.00	总资产	5,540.66
	净资产	3,186.65	净资产	3,225.45
	2016年度		2017年1-3月	
	净利润	327.49	净利润	38.80

## 七、股东及实际控制人的基本情况

### (一) 公司发起人基本情况

1、胡黎强：男，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：33012719760116\*\*\*\*，住所为上海市浦东新区罗山路\*\*\*\*。

2、夏风：男，1968年2月生，中国国籍，拥有中国香港非永久居留权，身份证号码为：43011119680227\*\*\*\*，住所为深圳市福田区锦滨苑\*\*\*\*。

### 3、上海晶哲瑞

上海晶哲瑞的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）		<b>成立时间</b>	2012年5月4日
<b>出资额</b>	70.00万元			
<b>主要经营场所</b>	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层			
<b>主营业务</b>	股权投资			
<b>执行事务合伙人</b>	胡黎强			
<b>出资构成</b>	<b>序号</b>	<b>出资人名称</b>	<b>出资额（万元）</b>	<b>出资比例</b>
	1	胡黎强	0.7000	1.0000%
	2	刘洁茜	30.6562	43.7946%
	3	孙顺根	12.3793	17.6847%
	4	宁波沪蓉杭	8.6086	12.2979%
	5	李宁	7.1145	10.1636%
	6	汪星辰	2.3649	3.3784%
	7	张宜	2.1344	3.0491%
	8	周占荣	1.1824	1.6891%
	9	于得水	1.1269	1.6099%
	10	张富强	0.4838	0.6911%
	11	杨彪	0.4269	0.6098%
	12	张辉	0.4269	0.6098%
	13	毛焜	0.3557	0.5081%
	14	钱志存	0.3557	0.5081%
	15	李辉	0.2134	0.3049%
	16	李阳德	0.1423	0.2033%
	17	高志勇	0.1423	0.2033%
	18	郁炜嘉	0.1187	0.1696%
19	郜小茹	0.1138	0.1626%	

	20	刘秋凤	0.1067	0.1525%
	21	徐雯	0.1067	0.1525%
	22	刘海	0.0854	0.1220%
	23	邱伟	0.0711	0.1016%
	24	易坤	0.0711	0.1016%
	25	祁丰	0.0711	0.1016%
	26	王刚	0.0569	0.0813%
	27	孙曼	0.0569	0.0813%
	28	郭天	0.0569	0.0813%
	29	邹勤谦	0.0569	0.0813%
	30	朱伟巨	0.0569	0.0813%
	31	李鑫	0.0427	0.0610%
	32	陈东	0.0285	0.0407%
	33	黄河	0.0285	0.0407%
	34	张海福	0.0285	0.0407%
	35	刘江	0.0285	0.0407%
	合计		<b>70.0000</b>	<b>100.0000%</b>
主要财务数据 (单位:万元,未经审计)	2016年12月31日		2017年3月31日	
	总资产	259.60	总资产	329.95
	净资产	69.81	净资产	69.85
	2016年度		2017年1-3月	
	净利润	-0.07	净利润	0.04

## （二）持有公司5%以上股份的主要股东的基本情况

持有公司5%以上股份的股东为胡黎强、夏风、上海晶哲瑞，其基本情况介绍详见本节“七、股东及实际控制人的基本情况”之“（一）公司发起人基本情况”。

## （三）实际控制人及其控制的其他企业的基本情况

公司实际控制人为胡黎强、刘洁茜夫妇，其详细情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“（一）董事会成员”。

报告期内，公司实际控制人之一胡黎强除持有公司股份外，还控制上海晶哲瑞、宁波沪蓉杭等2家企业。上海晶哲瑞的基本情况介绍详见本节“七、股东及实际控制人的基本情况”之“（一）公司发起人基本情况”，宁波沪蓉杭的具体情况如下：

企业名称	宁波梅山保税港区沪蓉杭投资管理合伙企业（有限合伙）		成立时间	2016年11月24日
出资额	100.00万元			
主要经营场所	北仑区梅山盐场1号办公楼九号2439室			
主营业务	股权投资			
执行事务合伙人	胡黎强			
出资构成	出资人名称	出资额（万元）	出资比例	
	胡黎强	1.28	1.28%	
	李建华	39.49	39.49%	
	秦岌	19.74	19.74%	
	胡黎琴	19.74	19.74%	
	胡黎瑛	19.74	19.74%	
	合计	100.00	100.00%	
主要财务数据 （单位：万元，未经审计）	2016年12月31日		2017年3月31日	
	总资产	8.86	总资产	8.79
	净资产	8.56	净资产	8.44
	2016年度		2017年1-3月	
	净利润	-0.05	净利润	-0.12

#### （四）实际控制人持有的股份质押或其他有争议的情况

公司实际控制人胡黎强、刘洁茜持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

## 八、公司股本情况

### （一）本次拟发行的股份及发行前后公司股本情况

本次发行前公司总股本为4,620万股，本次拟公开发行不超过1,540万股，发行后总股本不超过6,160万股。按本次发行新股1,540万股计算，发行前后公司的股本结构变化情况如下：

股东名称	发行前		发行后	
	股份数（万股）	比例	股份数（万股）	比例
<b>一、有限售条件股份</b>				
胡黎强	1,656.45	35.85%	1,656.45	26.89%
夏风	1,511.55	32.72%	1,511.55	24.54%
上海晶哲瑞	1,332.00	28.83%	1,332.00	21.62%
苏州奥银	75.00	1.62%	75.00	1.22%
珠海奥拓	45.00	0.97%	45.00	0.73%
<b>二、本次发行股份</b>				
社会公众股股东	-	-	1,540.00	25.00%
<b>合计</b>	<b>4,620.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,160.00</b>	<b>100.00%</b>

## （二）前十名自然人股东

本次发行前，公司前十名自然人股东持股情况及其在公司任职情况如下：

序号	股东名称	持股数量 （万股）	持股比例	职务	股份性质
1	胡黎强	1,656.45	35.85%	董事长、总经理	自然人股
2	夏风	1,511.55	32.72%	董事	自然人股
	<b>合计</b>	<b>3,168.00</b>	<b>68.57%</b>	-	-

## （三）本次发行前各股东间的关联关系及各自持股比例

本次发行前，公司各股东间的关联关系及各自持股比例如下：

股东名称	持股比例	与其他股东的关联关系
胡黎强	35.85%	持有上海晶哲瑞 1.00%的出资额，为其执行事务合伙人；持有苏州奥银 4.41%的出资额；与公司间接股东刘洁茜为夫妻关系，与公司间接股东胡黎瑛、胡黎琴为姐弟、兄妹关系
夏风	32.72%	持有苏州奥银 2.75%的出资额

## （四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份



## 的承诺

### 1、公司实际控制人胡黎强、刘洁茜承诺：

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

（2）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

（3）除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

2、公司实际控制人胡黎强控制的企业宁波沪蓉杭承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

3、公司股东上海晶哲瑞、苏州奥银、珠海奥拓承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

### 4、公司股东夏风承诺：

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

（2）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

(3) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

5、持有公司股份的高级管理人员孙顺根、汪星辰承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

(3) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

6、持有发行人股份的监事张宜、周占荣、李宁承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

(2) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

## 九、发行人历史上的委托持股情况

### （一）委托持股的形成、演变以及解除

#### 1、股权激励形成的委托持股情形

##### （1）委托持股的形成及演变

晶丰有限在发展过程中，为建立有效激励机制、增强公司管理团队和核心员工的凝聚力，对主要管理层及核心员工进行了股权激励。经核查，晶丰有限股权激励期间，共有 54 人参与股权激励，其中：①11 人被授予期权后未实际行权，即未曾持有晶丰有限权益，后因离职而放弃所有未行使的激励期权；②21 人行权后因离职而将所持有的晶丰有限权益转让给公司实际控制人，并终止未到期的激励期权；③22 人行权并持续持有，为公司目前在职员工。

在前述 43 人行权过程中，该等员工委托胡黎强代为持有晶丰有限股权，或者通过委托刘洁茜代为持有上海晶哲瑞出资份额的方式而间接持有晶丰有限股权，委托持股关系因此形成。其中：2 人出资认购并委托胡黎强代为持有晶丰有限股权，41 人出资认购并委托刘洁茜代为持有上海晶哲瑞出资份额。

截至 2017 年 1 月上述 22 名在职员工解除委托持股关系时，晶丰有限的员工累计委托持股情况如下：

单位：万元

序号	姓名	委托持有上海晶哲瑞 出资份额	出资比例	对应晶丰有限出资额	持股比例
1	孙顺根	12.3793	17.6847%	174.00	5.23%
2	李 宁	7.1145	10.1636%	100.00	3.01%
3	汪星辰	2.3649	3.3784%	33.24	1.00%
4	张 宜	2.1344	3.0491%	30.00	0.90%
5	周占荣	1.1824	1.6892%	16.62	0.50%
6	于得水	1.1269	1.6099%	15.84	0.48%
7	杨 彪	0.4269	0.6098%	6.00	0.18%
8	张 辉	0.4269	0.6098%	6.00	0.18%
9	钱志存	0.3557	0.5082%	5.00	0.15%
10	李 辉	0.2134	0.3049%	3.00	0.09%
11	高志勇	0.1423	0.2033%	2.00	0.06%
12	李阳德	0.1423	0.2033%	2.00	0.06%
13	郁炜嘉	0.1187	0.1695%	1.67	0.05%
14	郇小茹	0.1138	0.1626%	1.60	0.05%
15	刘秋凤	0.0783	0.1118%	1.10	0.03%
16	徐 雯	0.0711	0.1016%	1.00	0.03%

17	毛焜	0.0569	0.0813%	0.80	0.02%
18	王刚	0.0569	0.0813%	0.80	0.02%
19	孙曼	0.0569	0.0813%	0.80	0.02%
20	郭天	0.0569	0.0813%	0.80	0.02%
21	刘海	0.0498	0.0711%	0.70	0.02%
22	邱伟	0.0285	0.0407%	0.40	0.01%

## （2）员工委托持股的还原

为规范员工持股，2017年1月，刘洁茜分别与孙顺根等22名被激励员工签署《解除委托持股协议》，约定刘洁茜将其受托持有的上海晶哲瑞出资份额转让给实际出资者，解除委托持股关系。

2017年1月17日，上海晶哲瑞就上述股权还原事宜办理了工商变更登记手续。至此，22名被激励员工与刘洁茜委托持股关系解除。

## 2、其他委托持股情形

### （1）其他委托持股的形成及演变

#### ①秦岌、胡黎琴、李建华、胡黎瑛委托持股情形

2009年1月至3月，秦岌、胡黎琴、李建华分别与胡黎强签署《上海晶丰明源半导体有限公司入股协议》，约定秦岌、胡黎琴、李建华分别出资5万元、5万元、20万元持有晶丰有限0.80%、0.80%、3.20%股权，并委托胡黎强代为持有。其中，胡黎琴系公司实际控制人之一胡黎强之妹妹，李建华系公司实际控制人之一刘洁茜之姨妈，秦岌系晶丰有限设立时之员工。

2012年5月，胡黎强、刘洁茜成立持股平台上海晶哲瑞。秦岌、胡黎琴、李建华终止其与胡黎强的委托持股关系，变更为通过上海晶哲瑞持有晶丰有限股权，并委托刘洁茜代为持有上海晶哲瑞出资份额。

2012年5月，胡黎瑛出资20万元委托刘洁茜代为持有上海晶哲瑞出资份额而间接持有晶丰有限权益。胡黎瑛系公司实际控制人之一胡黎强之姐姐。

2012年11月，李建华将其委托刘洁茜代为持有上海晶哲瑞出资份额中的50%以60万元的价格转让给刘洁茜。

## ②李文强、高峰、廖杨帆、俞信华委托持股情形

2012年10月至2013年5月期间，李文强、高峰、廖杨帆、俞信华等4名外部投资人分别与刘洁茜签署《出资额代持协议》，约定李文强、高峰、廖杨帆、俞信华分别出资20万元、20万元、40万元和30万元，委托刘洁茜代为持有上海晶哲瑞出资份额而间接持有晶丰有限权益。

### （2）其他委托持股的解除

2013年12月至2016年12月期间，俞信华、高峰、李文强、廖杨帆分别将其所认购的上海晶哲瑞出资份额以50万元、124万元、168万元和540万元的价格转让给刘洁茜。至此，李文强、高峰、廖杨帆、俞信华与刘洁茜委托持股关系解除。

2016年12月，刘洁茜分别与秦岷、胡黎琴、胡黎瑛、李建华等4名外部投资人签署《解除委托持股协议》或出具确认文件，约定由刘洁茜将其受托持有的上海晶哲瑞出资份额转让给秦岷、胡黎琴、胡黎瑛、李建华出资设立的宁波沪蓉杭以解除委托持股关系。至此，秦岷、胡黎琴、胡黎瑛、李建华与刘洁茜委托持股关系解除。

## （二）股权确权情况

针对发行人历史上的委托持股情况，保荐机构、发行人律师等中介机构进行了如下股权确权工作：截至本招股说明书签署日，晶丰有限阶段员工股权激励涉及的54人及外部投资委托持股情形涉及的8人中，共有58人接受了保荐机构以及发行人律师的访谈，并对终止股权激励、解除委托持股关系以及持有股权份额事宜进行了书面确认：在员工股权激励执行过程中，被激励员工的权益均由相关协议明确约定，不存在虚假陈述、出资不实、股权管理混乱等情形；解除委托持股后，被激励员工、外部投资人、发行人及相关方对上海晶哲瑞合伙人组成及出资份额、发行人股东及持股比例无异议；发行人股权、发行人股东上海晶哲瑞出资份额，权属明确。

截至本招股说明书签署日，尚有 4 名晶丰有限离职员工暂未取得联系；根据发行人提供的（2017）沪卢证经字第 1965 号、1966 号、1967 号、1968 号《公证书》，发行人已向前述 4 人公证送达告知函，要求核实是否对晶丰有限激励方案及终止存在异议或权利主张。截至本招股说明书签署日，发行人未收到该等人员提出的异议反馈。同时，2017 年 1 月 23 日至 1 月 25 日，发行人连续在《新民晚报》发布公告，通知相关权利人若就上海晶哲瑞、晶丰明源（晶丰有限）设立以来历次出资情况存在异议或权利主张的，应在规定时间内向公司提出。规定时间内，未有任何第三人就前述事宜向发行人提出异议或权利主张。

公司实际控制人胡黎强、刘洁茜已出具了《承诺函》，就历史上的委托持股事宜作出如下承诺：“晶丰明源、上海晶哲瑞过往存在的委托持股（出资）、历次变更及其解除事宜不存在纠纷或潜在纠纷。截至目前，晶丰明源、上海晶哲瑞股权（出资）结构清晰，权属分明，真实确定；若因任何第三方就本公司股权激励、委托持股（出资）事宜提出异议并导致公司遭受损失的，本人将予以全额赔偿。”

发行人律师认为：晶丰有限、上海晶哲瑞过往存在的委托持股（出资）情形不会对发行人本次公开发行股票并上市造成实质性障碍。

保荐机构认为：公司历史上存在的委托持股情形及其变动，未违反法律、法规及规范性文件的禁止性规定，且该等委托持股事宜已得到清理和规范，委托人和受托人之间不存在权属争议或潜在纠纷。因而历史上的委托持股行为对本次发行不构成实质性障碍。

## 十、员工及其社会保障情况

### （一）员工结构

截至2017年3月31日，公司在职员工总数为166人，其专业构成、教育程度和年龄分布如下：

### 1、员工岗位分布情况

岗位情况	人数	占员工总数比例
管理和行政人员	53	31.93%
研发人员	94	56.63%
销售人员	19	11.45%
合计	<b>166</b>	<b>100.00%</b>

### 2、员工受教育程度

学历情况	人数	占员工总数比例
硕士及以上	26	15.66%
本科	85	51.20%
大专	43	25.90%
高中、中专及以下	12	7.23%
合计	<b>166</b>	<b>100.00%</b>

### 3、员工年龄分布

年龄区间	人数	占员工总数比例
50岁及以上	1	0.60%
40~50岁	11	6.63%
30~40岁	92	55.42%
30岁以下	62	37.35%
合计	<b>166</b>	<b>100.00%</b>

## （二）公司执行社会保障制度、住房公积金制度及医疗保险制度情况

公司与员工按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定签订劳动合同，员工根据劳动合同承担义务和享受权利。截至报告期末，公司已按照国家有关政策规定，执行社会保障制度、住房公积金制度与医疗保险制度，为员工缴纳了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。

## 十一、发行人及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的主要股东以及证券服务机构作出的重要承诺及其约束措施和履行情况

### （一）关于股份锁定的承诺

主要股东、董事、监事、高级管理人员均对所持股份流通限制及自愿锁定情况作出了相关承诺，详细情况参见本节“八、公司股本情况”之“（四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”部分。

### （二）实际控制人关于避免同业竞争的承诺

实际控制人胡黎强、刘洁茜分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“一、本人除直接或间接持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。

二、本人今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业。

三、如公司认定本人通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。

四、本人保证不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本人愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。”



### （三）关于稳定股价的承诺

公司承诺：在公司上市后三年内，公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按照《上海晶丰明源半导体股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股份。

公司实际控制人胡黎强、刘洁茜承诺：将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会或股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票；将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

公司全体董事承诺：将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票；将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

公司全体高级管理人员承诺：将根据公司股东大会批准的《上海晶丰明源半导体股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

### （四）持有公司股份 5%以上的重要股东持股意向及减持意向的承诺

持有公司股份5%以上的股东胡黎强、夏风、上海晶哲瑞就持股意向及减持意向承诺：

“1、在承诺的锁定期内，持续持有公司股份。

2、如本人/本机构所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于本次发行价格（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，发行价亦将作相应调整），每年减持数量不超过上一年末本人/本机构所持有公司股份总数

的 20%。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人/本机构拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通知公司并通过公司予以公告，未履行公告程序前不进行减持；本人/本机构减持公司股份将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

如本人/本机构违反相关承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票；如因未履行上述承诺事项而获得收益的，则本人/本机构将在获得收益的 5 个交易日内将前述收益支付给公司指定账户，否则公司有权暂时扣留应支付给本人/本机构现金分红中应该上交公司违规减持所得收益金额相等的现金分红；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的，本人/本机构将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

## **（五）关于直接或间接持有的公司股份是否存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况的承诺**

全体股东胡黎强、夏风、上海晶哲瑞、苏州奥银、珠海奥拓承诺：本人/本机构所持有的发行人的全部股份为本人/本机构实质拥有，不存在代其他人持有的情况；本人/本机构持有发行人的全部股份不存在质押等权利限制或权利瑕疵。

## **（六）关于信息披露违规的承诺**

### **1、发行人相关承诺**

若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司回购价格为二级市场价格且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。

若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

## 2、实际控制人相关承诺

若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，实际控制人胡黎强、刘洁茜将促成公司及时启动依法回购公司首次公开发行的全部新股工作，并启动依法购回本人已转让的原限售股份工作。回购价格为二级市场价格且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。

若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

## 3、公司全体董事、监事、高级管理人员相关承诺

若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

### （七）关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

公司实际控制人胡黎强、刘洁茜根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

## （八）证券服务机构作出的承诺

保荐机构广发证券股份有限公司承诺：因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

发行人律师国浩律师（杭州）事务所承诺：因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

申报会计师、验资机构及验资复核机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

截至本招股说明书签署日，上述承诺人均严格履行相关承诺。

## 十二、公司稳定股价的预案

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司制定了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于稳定公司股价的预案》，具体如下：

### “一、启动稳定股价措施的条件

公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。

### 二、稳定股价的具体措施

#### （一）公司回购

1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

2、公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。

3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

4、公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：

（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额；

（2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元；

（3）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。

5、公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。

#### （二）实际控制人、控股股东增持

1、下列任一条件发生时，公司实际控制人、控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；

（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

（3）公司实际控制人、控股股东承诺按其所持公司股份比例对公司股份进行同比例增持，且单次增持总金额不应少于人民币 500 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

#### （三）董事、高级管理人员增持

1、下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高

级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

（1）控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；

（2）控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的在公司领取薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

3、在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。

4、本公司如有新聘任董事、高级管理人员，本公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。

### 三、稳定股价措施的启动程序

#### （一）公司回购

1、公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出回购股份的决议。

2、公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。

3、公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕；

4、公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

#### （二）控股股东及董事、高级管理人员增持

1、公司董事会应在上述控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告。

2、控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。

#### 四、稳定股价的进一步承诺

在启动条件首次被触发后，公司控股股东及持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期自动延长 6 个月。为避免歧义，此处持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期，是指该等人士根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第四条第（三）款的规定做出的承诺中载明的股份锁定期限。

本预案需经公司股东大会审议通过，公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效，有效期三年。”

## 第六节 业务和技术

### 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况

#### （一）发行人主营业务

公司是国内领先的模拟和混合信号集成电路设计企业之一，主营业务为模拟和混合信号集成电路的研发与销售，主要产品为 LED 照明驱动芯片，包括通用 LED 照明驱动芯片、智能 LED 照明驱动芯片等。

公司是经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国税局、上海市地税局联合认定的“高新技术企业”，荣获“上海市科技小巨人企业”、“2016年上海市集成电路设计企业销售前十”、“中国 LED 首创奖”等荣誉称号。公司自成立以来即注重产品更新、重视技术创新。可控硅调光发光二极管驱动芯片产品荣获中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社联合评选的“第十一届（2016 年度）中国半导体创新产品和技术”荣誉，高性能有源功率因数校正驱动芯片等多项产品被评为上海市高新技术成果转化项目。公司掌握了 LED 照明驱动的多项核心技术，自主研发的 700V 高压集成工艺、LED 恒流的源极驱动技术、LED 驱动芯片的供电技术、LED 电流纹波消除技术、700V 单芯片技术已达到行业领先水平。截至本招股说明书签署日，公司已获得国际专利 2 项，国内专利技术 107 项，集成电路布图设计专有权 61 项。

凭借技术、品牌、产品等综合优势，公司与国内外主要的 LED 照明企业如飞利浦、欧普照明、雷士照明、阳光照明、三雄极光、佛山照明、得邦照明等建立了直接或间接的合作关系，2016 年“中国 LED 照明产品出口十强企业”全部企业均配套应用了发行人 LED 照明驱动芯片。公司已成为国内 LED 照明驱动芯片细分领域的领先企业之一，主要产品 LED 照明驱动芯片市场占有率位于前列，在 LED 照明驱动芯片领域具有较强的竞争优势。

公司自成立以来即专注于模拟和混合信号集成电路的研发与销售，主营业务及主要产品未发生重大变化。

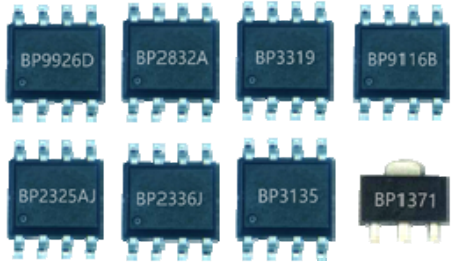
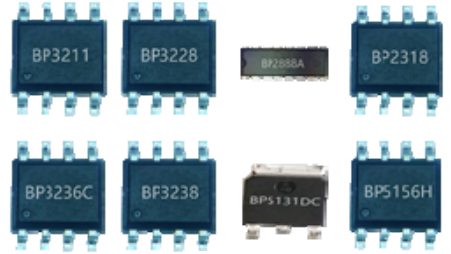


## （二）发行人主要产品

公司主要产品为 LED 照明驱动芯片。LED 照明驱动芯片是一种通过把电源供应转换为特定的电压电流用以驱动 LED 发光的集成电路。与传统的白炽灯不同，LED 照明产品因其敏感特性，无法直接连接交流市电，在应用过程中需要设计复杂的恒流驱动电路对其进行稳定和保护。LED 照明驱动芯片作为驱动电路的核心部件，其有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容等直接决定了 LED 照明产品的性能及寿命，被誉为 LED 照明产品的“心脏”。

根据产品的功能分类，公司 LED 照明驱动芯片产品可以分为通用 LED 照明驱动芯片和智能 LED 照明驱动芯片。其中通用 LED 照明驱动芯片用于驱动日常 LED 照明产品，智能 LED 照明驱动芯片在通用 LED 照明驱动芯片的基础上加入了全自动调光、调色、智能场景转换等功能，用于满足智能家居及物联网发展趋势下 LED 照明产品智能化需求。

公司主要产品为 LED 照明驱动芯片，包括通用 LED 照明驱动芯片、智能 LED 照明驱动芯片，具体情况如下：

产品类别	产品描述	主要产品图示
通用 LED 照明驱动芯片	是驱动 LED 发光或 LED 模块组件正常工作的电源调整芯片，主要应用于日常 LED 照明产品的恒流驱动芯片。	
智能 LED 照明驱动芯片	在通用 LED 照明驱动芯片基础上增加模组、电源、智能控制系统或加载的各项与智能化等有关系统模块已满足智能 LED 照明需要，主要应用于多元化场景。	

公司主要产品 LED 照明驱动芯片主要配套于各类 LED 照明灯具，进而广泛应用于家用及办公照明、城市亮化工程、建筑景观亮化、装饰照明等领域。



### （三）发行人主营业务收入的主要构成

报告期内，公司主要产品的销售收入及占比情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
LED 照明驱动芯片	15,304.96	99.97%	56,749.33	99.41%	35,612.31	99.72%	33,719.34	99.98%
其中：								
通用 LED 照明驱动芯片	12,350.42	80.67%	47,232.06	82.74%	30,857.68	86.41%	33,719.34	99.98%
智能 LED 照明驱动芯片	2,508.51	16.39%	7,909.19	13.85%	3,870.51	10.84%	-	-
其他	446.03	2.91%	1,608.08	2.82%	884.12	2.47%	-	-
<b>主营业务收入</b>	<b>15,304.96</b>	<b>99.97%</b>	<b>56,749.33</b>	<b>99.41%</b>	<b>35,612.31</b>	<b>99.72%</b>	<b>33,719.34</b>	<b>99.98%</b>
<b>营业收入</b>	<b>15,309.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,088.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,712.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,727.01</b>	<b>100.00%</b>

## 二、发行人所处行业的基本情况

公司主营业务为模拟和混合信号芯片的研发与销售，主要产品为 LED 照明驱动芯片，包括通用 LED 照明驱动芯片、智能 LED 照明驱动芯片。

## （一）行业管理体制和行业政策

### 1、行业分类

公司主营业务为模拟和混合信号芯片的研发与销售，公司所处行业属于集成电路设计行业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6550）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。

### 2、行业主管部门及监管体制

公司所处集成电路设计行业的主管部门主要为工信部，行业自律组织为中国半导体行业协会。

工信部主要负责制定行业发展战略、发展规划及产业政策；拟定技术标准，指导行业技术创新和技术进步；组织实施与行业相关的国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

中国半导体行业协会是行业内的指导、协调机构，其主要职能为贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；调查、研究、预测本行业产业与市场，根据授权开展行业统计，及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况调查、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作等。

工信部和中国半导体行业协会构成了集成电路设计行业的管理和自律体系，各集成电路设计企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

### 3、行业主要法律法规及行业政策

公司所处集成电路设计行业受到国家政策的大力支持。自2000年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业的发展，行业主要法律法规及政策如下：

序号	时间	发布单位	颁布的文件名称	与公司所处行业相关内容
----	----	------	---------	-------------

1	2017.01	发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	将集成电路芯片设计及服务列入战略性新兴产业重点产品目录。
2	2016.12	国务院	《“十三五”国家信息化规划》	信息产业生态体系初步形成，重点领域核心技术取得突破。集成电路实现 28 纳米（nm）工艺规模量产，设计水平迈向 16/14nm。
3	2016.07	中共中央办公厅、国务院办公厅	《国家信息化发展战略纲要》	制定国家信息领域核心技术设备发展战略纲要，以体系化思维弥补单点弱势，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。
4	2016.05	财政部、国家税务总局、发改委、工信部	《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》	享受财税〔2012〕27 号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 76 号）规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料。
5	2016.03	十二届全国人大四次会议	《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》	大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点。推广半导体照明等成熟适用技术。
6	2015.05	国务院	《中国制造 2025》	对于集成电路及专用装备，要着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权（IP）核和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力。
7	2014.06	国务院	《国家集成电路产业发展推进纲要》	着力发展集成电路设计业，围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展。
8	2012.08	发改委、工信部、财政部、商务部、国家税务总局	《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》	明确了国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定程序和标准等。
9	2012.04	财政部、国家税务总局	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按 10% 的税率征收企业所得税。

10	2011.01	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	紧紧围绕培育战略性新兴产业的目标，重点支持基础软件、面向新一代信息网络的高端软件、工业软件、数字内容相关软件、高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、关键应用系统的研发以及重要技术标准的制订。
11	2006	国务院	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006年-2020年）》	突破制约信息产业发展的核心技术，掌握集成电路及关键元器件、大型软件、高性能计算、宽带无线移动通信、下一代网络等核心技术，提高自主开发能力和整体技术水平。
12	2006.05	中共中央办公厅、国务院办公厅	《2006-2020年国家信息化发展战略》	在集成电路（特别是中央处理器芯片）、系统软件、关键应用软件、自主可控关键装备等涉及自主发展能力的关键领域，瞄准国际创新前沿，加大投入，重点突破，逐步掌握产业发展的主动权。制定并完善集成电路、软件、基础电子产品、信息安全产品、信息服务业等领域的产业政策。
13	2001.09	国家知识产权局	《集成电路布图设计保护条例实施细则》	保护集成电路布图设计专有权，促进我国集成电路技术的进步与创新。对《集成电路布图设计保护条例》进行了细化。
14	2001.03	国务院	《集成电路布图设计保护条例》	为保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术的创新，促进科学技术的发展，对集成电路布图设计的权利、登记和行使等方面作出了规范。
15	2000.06	国务院	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，继续完善激励措施，明确政策导向。对于优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，具有重要意义。

## （二）行业基本情况

### 1、集成电路设计行业概况

集成电路系采用特种电路设计及加工工艺，集成于半导体晶片上的微型电子电路产品。集成电路相比传统的分立电路，通过降低体积减小材料耗用量，大幅降低了制造成本，同时，其微小的体积及元件的紧密排布提高了信息的切换速度并降低了能耗，使得集成电路比分立电路在成本及效率上均有较大的优势。自1958年第一块集成电路于德州仪器问世以来，集成电路产品发展迅速，广泛用于各种电子产品，成为信息时代中不可或缺的部分。

伴随现代信息技术产业的快速发展，集成电路产业作为现代信息技术产业的基础和核心，已成为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性新兴产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用，是当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志之一。随着国内经济不断发展以及国家对集成电路行业的大力支持，我国集成电路产业快速发展，产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。

完整的集成电路产业链包括设计、芯片制造、封装测试等环节，各环节具有各自独特的技术体系及特点，已分别发展成独立、成熟的子行业。其中，集成电路设计系根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，集成电路设计水平的高低决定了芯片的功能、性能及成本；集成电路制造通过版图文件生产掩膜，并通过光刻、掺杂、溅射、刻蚀等过程，将掩膜上的电路图形复制到晶圆基片上，从而在晶圆基片上形成电路；集成电路封装测试包括封装和测试两个环节，封装是保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤，增强芯片的散热性能，实现电气连接，确保电路正常工作；测试主要是对芯片产品的功能、性能测试等，将功能、性能不符合要求的产品筛选出来。

公司主要业务为集成电路设计，位于集成电路产业链上游。

## 2、集成电路行业产品分类

集成电路产品依其功能，主要可分为模拟芯片（Analog IC）、存储器芯片（Memory IC）、微处理器芯片（Micro IC）、逻辑芯片（Logic IC）。模拟芯片是处理连续性的光、声音、速度、温度等自然模拟信号，按技术类型可分为只处理模拟信号的线性芯片和同时处理模拟与数字信号的混合芯片；按应用分类可分为标准型模拟芯片和特殊应用型模拟芯片。标准型模拟芯片包括放大器、信号界面、数据转换、比较器等产品。特殊应用型模拟芯片主要应用于通信、汽车、电脑周边和消费类电子等领域。模拟芯片作为连接上述各类物理信息与数字电子系统的媒介，同时需要制程、电路设计和半导体组件物理的相互配合，在芯片效能及成本上寻求最优化，由于其决定了产品最终呈现质量，因此更为注重组件的特性如可靠度、稳定度、能源转换效率、电压电流控制能力等。存储器芯片是指利用电

能方式存储信息的半导体介质设备，其存储与读取过程体现为电子的存储或释放。逻辑芯片可分为标准逻辑芯片及特殊应用芯片，标准逻辑芯片提供基本逻辑运算并大量制造，特殊应用芯片是为单一客户及特殊应用而量身定做的芯片，具有定制化、差异化及少量多样等特性。微处理器芯片主要用于自动控制、图像处理、通信技术等领域。

公司主要产品 LED 照明驱动芯片属于模拟芯片。

### 3、行业市场化程度及竞争格局

近年来，随着集成电路设计行业的快速发展，国内集成电路设计企业数量逐渐增长。根据中国半导体行业协会统计，2016 年全国集成电路设计企业有 1,362 家，市场化程度较高。

集成电路设计企业主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，行业内企业围绕各下游细分应用领域展开竞争。公司自成立以来深耕于 LED 照明驱动芯片领域，主要产品包括通用 LED 照明驱动芯片、智能 LED 照明驱动芯片，产品应用于 LED 照明产品。LED 照明驱动芯片领域内的竞争格局可以划分为两个层面：第一层次是市场占有率较高，掌握核心设计技术，具有自主研发能力的企业，主要包括上海晶丰明源半导体股份有限公司、昂宝电子（上海）有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、深圳市明微电子股份有限公司、杭州矽力杰半导体技术有限公司等企业；第二层次主要是数量较多的中小企业，这些企业规模较小、技术创新实力较弱、产品同质化严重，型号较为单一。

### 4、集成电路设计行业市场容量及发展前景

#### （1）全球集成电路设计行业市场容量及发展前景

全球半导体行业在经历了高速增长后，与近年来进入平稳发展的阶段。据世界半导体贸易统计协会统计，2014 年至 2016 年，全球集成电路市场销售规模分别为 2,773 亿美元、2,745 亿美元和 2,767 亿美元，整体保持稳定。同时，在物联网、智能终端、汽车电子等应用领域需求的推动下，预计 2017 年、2018 年全球集成电路行业市场销售规模将增长至 3,116 亿美元和 3,192 亿美元，同比增长 12.6%、2.4%。

## 全球集成电路行业市场规模及增长情况

单位：亿美元

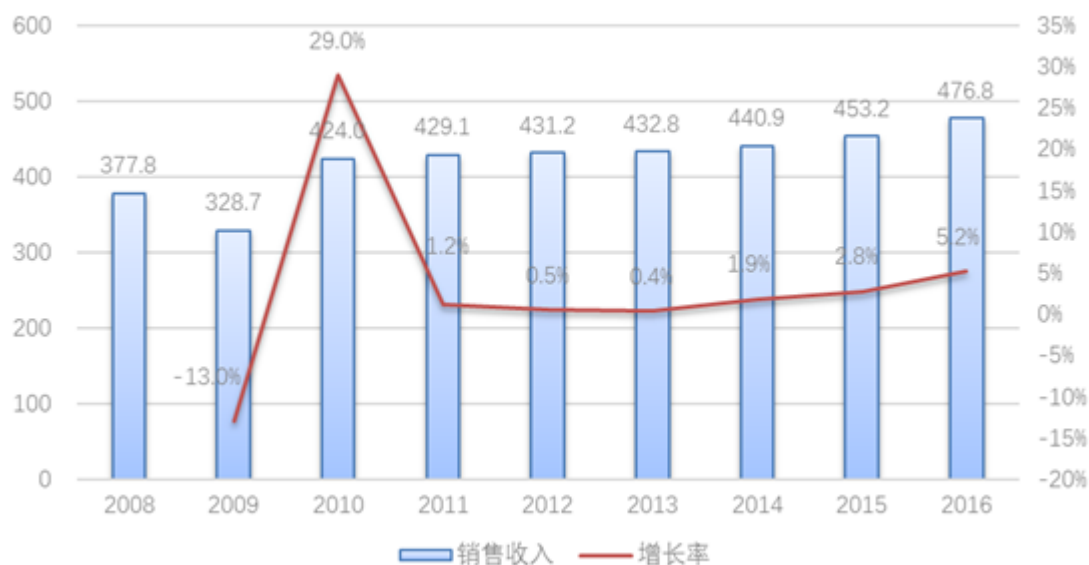


数据来源：WSTS

从细分市场看，模拟芯片2016年市场规模为476亿美元，较2015年同比增长5.2%，保持较高增长。基于终端应用范围广泛的特性，模拟芯片整体市场不易受单一产业景气度变动的影响，因此价格波动较存储芯片和逻辑电路等数字芯片小，市场相对稳定。

## 2008年-2016年全球模拟芯片市场规模与增长情况

单位：亿美元

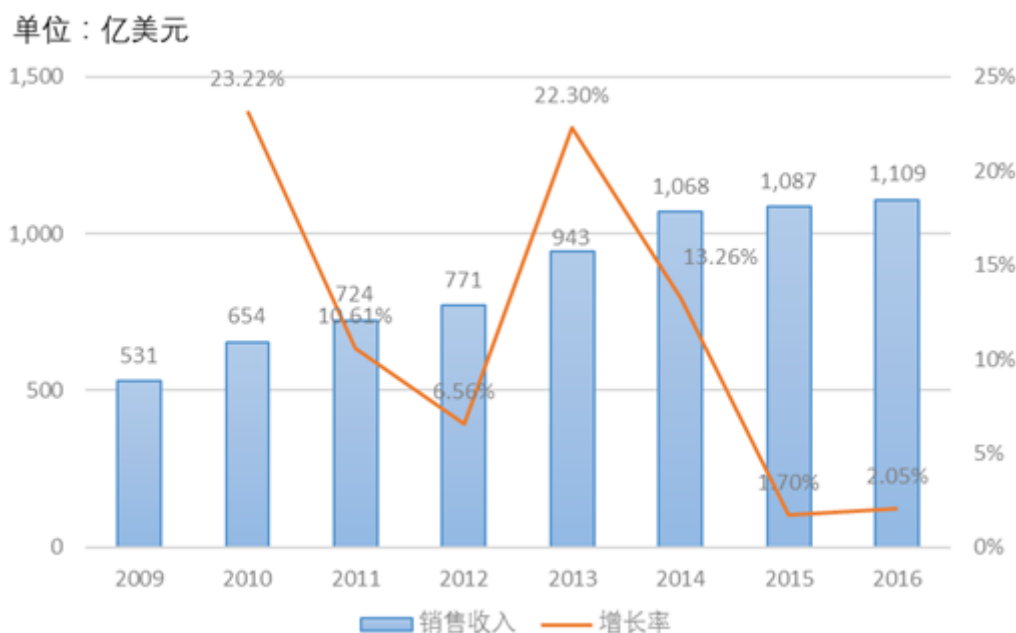


数据来源：赛迪顾问



全球半导体行业技术的发展及集成电路制造工艺日趋成熟为设计和制造分离奠定技术基础。巨额初始投资、后续沉重的资产折旧和运营成本以及制造技术的成熟导致越来越多的集成电路企业逐渐从 IDM 模式转型为 Fabless 模式，推动集成电路设计从制造环节独立成为行业内重要的细分子行业。自 2009 年以来，全球集成电路设计行业呈现持续增长的良好态势。

全球集成电路设计产业市场规模及增长情况



数据来源：赛迪顾问

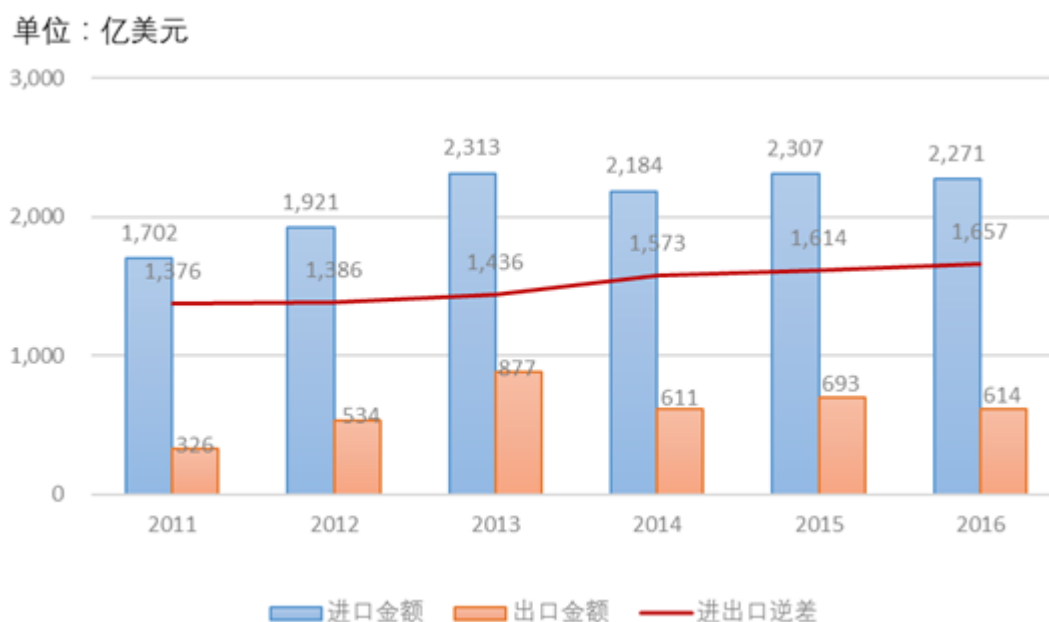
## (2) 国内集成电路设计行业市场容量及发展前景

近年来，凭借着巨大的市场需求、较低的生产成本以及经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件，我国集成电路产业实现了快速发展。根据中国半导体行业协会统计，2013年至2016年，中国集成电路产业年销售额分别为2,508.5亿元、3,015.4亿元、3,609.8亿元和4,335.5亿元，2014年、2015年和2016年的增长率分别为20.21%、19.71%和20.10%，行业规模增速远高于全球平均水平。在行业保持较高增速的同时，随着产业并购渗透学习及与国际领先集成电路企业的持续合作，国内集成电路产业在芯片设计、制造等方面取得了显著进步，国内集成电路企业整体实力持续提升。

我国集成电路产业虽在近年来保持了较快的增长趋势，但集成电路生产制造

与自身消费之间仍存在巨大缺口。作为全球最大的消费电子市场，我国集成电路仍大量依赖于进口，进出口结构不均衡。中国海关、工信部发布的数据显示，2016年中国集成电路进口 3,425.5 亿块，同比增长 9.1%，进口额 2,271 亿美元，连续 4 年超过 2,000 亿美元，而出口金额仅为 614 亿美元，贸易逆差达 1,657 亿美元。集成电路已超过原油，成为我国最大宗进口产品。随着部分细分领域集成电路企业综合实力的提升以及下游用户的成本控制需求的日益显现，兼具质量和成本优势的国内领先企业已经逐步开始替代进口，形成较强的市场竞争力。

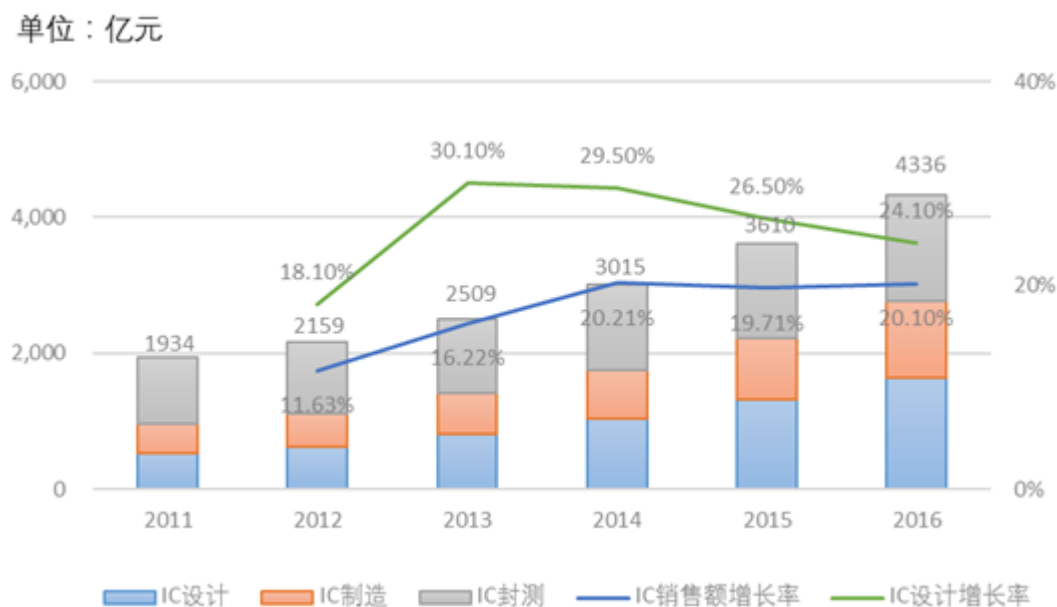
2011 年-2016 年我国集成电路行业进出口情况



数据来源：中国海关、工信部

国内集成电路产业的发展过程中，集成电路设计、芯片制造和封装测试三业的格局也正不断优化，其中集成电路设计业表现尤为突出。总体来看，集成电路设计业所占比重呈逐年上升的趋势。2016 年，我国集成电路设计业销售规模达到 1,644.3 亿元，所占比重达 37.9%，集成电路设计销售增长率为 24.10%，高于集成电路行业整体销售增长率 20.10%。我国集成电路设计业已经超过芯片制造及封装测试业，成为我国集成电路行业链条中最为重要的环节。据集成电路产业“十三五”发展规划总体目标显示，到 2020 年，我国集成电路设计业年销售收入将达到 3,900 亿元，新增 2,600 亿元，年复合增长率达到 25.9%，是国内集成电路产业中最具发展活力的领域。

## 2011年-2016年国内集成电路行业市场规模及增长率

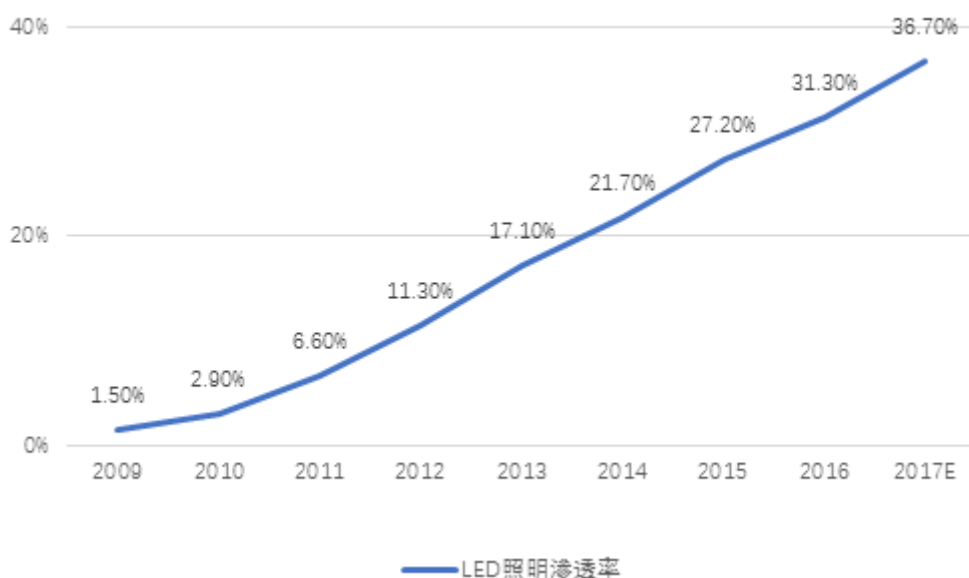


数据来源：中国半导体行业协会

### （三）下游市场需求情况

LED照明产品系利用发光二极管作为光源制造出来的照明器具，具有高效、节能、环保、易维护等显著特点，是实现节能减排的有效途径。在全球能源短缺的背景下，LED照明将逐渐成为照明领域的主流产品，引领照明史上继白炽灯、荧光灯之后的又一场照明光源的革命。近年来，全球LED照明产品价格快速下降，已逐步取代白炽灯、荧光灯等其他照明光源，渗透率持续快速提升，预计2017年全球LED渗透率将达到36.7%，较2016年上升5.40%。

2009年-2016年全球LED照明渗透率



数据来源：Digitimes

LED照明驱动芯片是驱动LED发光或LED模块组件正常工作的电源调整芯片，属于集成电路产品。LED照明驱动芯片在组成电路正常工作后，通过电流检测电阻将电压反馈到芯片上，通过调整电压、电流、功率的方法以适应LED自身特性变化而引起的电流、电压波动，使LED得到的电流保持恒定。LED照明驱动芯片的恒流精度、高效率及可靠性直接决定了LED照明灯具的使用寿命、调光调色等指标，是LED照明产品的核心部件。

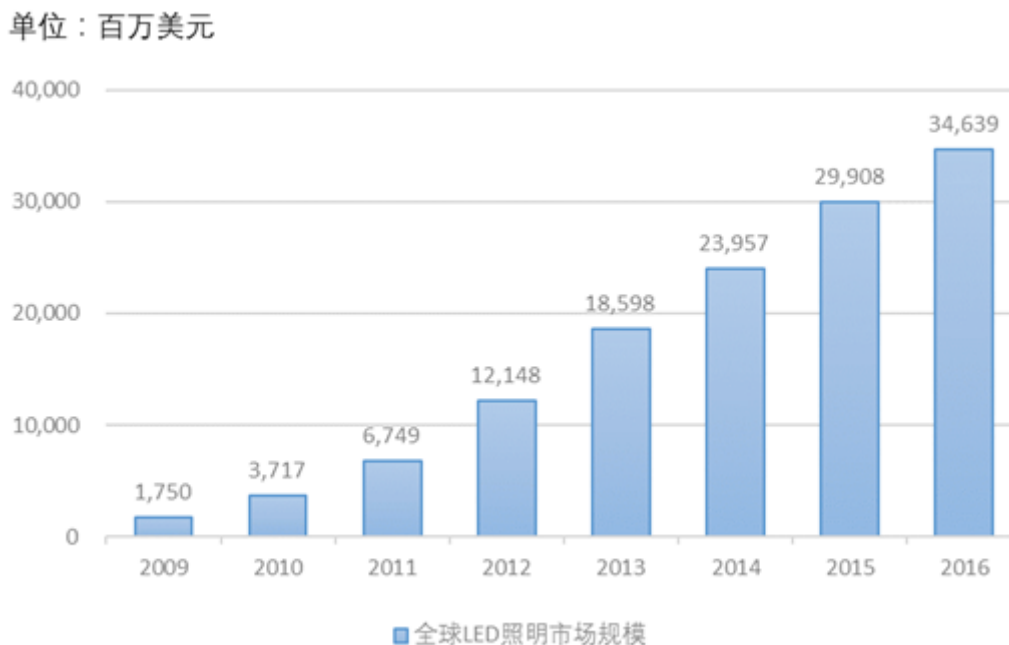
### （1）全球LED照明发展状况及市场规模

为提高能效、保护环境、应对全球气候变化，世界主要国家和地区都陆续发布了淘汰白炽灯计划并大力推广LED照明产品的政策或计划。美国从2000年起投资5亿美元实施“国家半导体照明计划”，欧盟于2000年宣布启动类似的“彩虹计划”。韩国“GaN半导体开发计划”从2000年至2008年，由政府投入4.72亿美元，企业投入7.36亿美元进行。我国科技部在“863”计划的支持下，2003年6月份首次提出发展半导体照明计划。

随着LED照明技术的迅速发展，LED照明产品的稳定性、使用寿命、智能化、显指、光效等性能指标逐步保持稳定，达到客户接受状态，产品市场应用持续提高。根据Digitimes统计，2009年至2015年全球LED照明渗透率（LED照

明产品销售数量/照明产品总销售数量）由 1.5% 上升至 27.2%，预计 2016 年将达到 31.3%。根据 Digitimes 估计，2016 年全球 LED 照明市场规模达到 346 亿美元，同比增长 15.8%。

2009 年-2016 年全球 LED 照明市场规模



数据来源：Digitimes

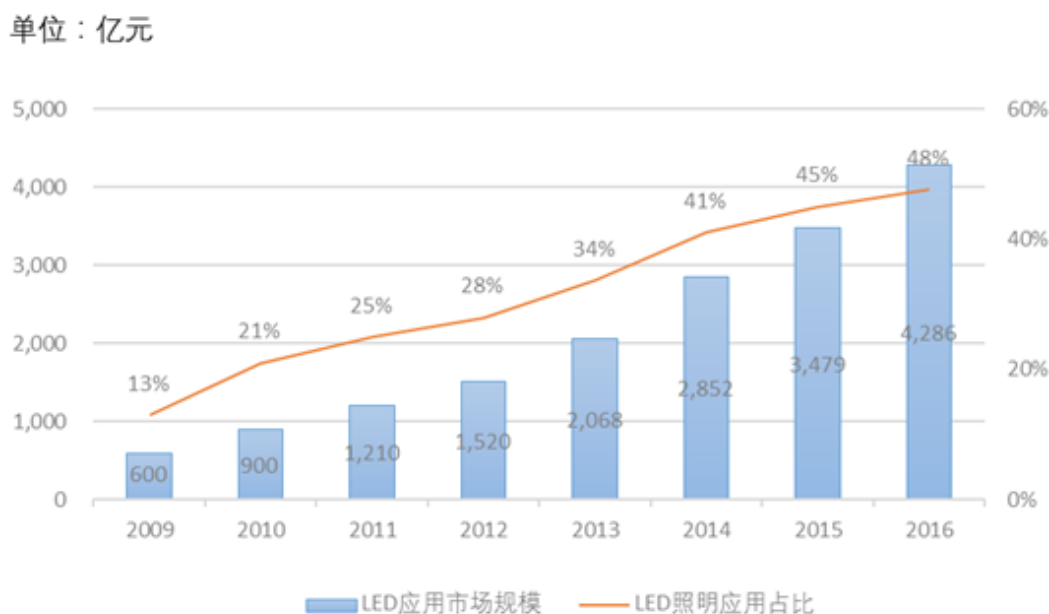
## （2）中国 LED 照明发展状况及市场规模

在全球大力推动节能减排、积极应对气候变化的形势下，“十一五”期间，中国提出了单位 GDP 能耗降低 20%，主要污染物排放减少 10% 的约束性目标。随着国外纷纷出台淘汰白炽灯路线图，我国也逐步加快了淘汰低效照明产品的步伐。2011 年 10 月，国家发改委正式发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，并将 2011 年 10 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日设为过渡期，到 2016 年将全面禁止各种瓦数的白炽灯市面销售。2012 年 7 月，国家科技部编制了《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》，进一步加快推动半导体照明技术和产业创新发展，LED 推广及普及应用迎来巨大的市场机遇。节能减排仍然“十三五”规划的重中之重。LED 照明产品在节能减排中可发挥的重要作用必将受到政府及市场的重视，有利于 LED 照明产业的进一步发展。2016 年，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出“推动智能传感器、电力电子、印刷电子、半导

体照明、惯性导航等领域关键技术研发和产业化”。

根据国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）统计，2014-2016 年国内 LED 照明应用产值分别约为 1,169 亿元、1,566 亿元和 2,040 亿元，增长速度较快，LED 照明产品国内市场渗透率（LED 照明产品国内销售量/照明产品国内总销售量）达到 42%，较 2015 年上升 10%。LED 对传统照明市场的替代效应极大激发了半导体照明市场的需求，国内半导体照明产业有望迎来关键的发展机遇。高工产研 LED 研究所预计，到 2020 年中国 LED 照明市场规模有望超过 4,614 亿元。

#### 2009-2016 年中国 LED 应用市场规模及 LED 照明应用占比情况



数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟

LED 照明市场的需求规模在不断扩大，对产品的要求也在不断升级，个性化、特殊需求不断涌现。LED 照明产品日趋向个性化与智能化方向发展，以满足消费者对调光、调色、远控、互动等多方面的照明需求。在照明产品智能化的过程中，照明技术与智能硬件、互联网、物联网技术实现跨界融合，成为智慧家庭、智慧楼宇、智慧城市的重要组成部分，能够给宏大繁杂的城市管理提供数据化支持。据专业机构 P&S Market Research 预测，全球智能照明设备和控制市场将从 2014 年的 221.1 亿美元增至 2020 年的 591.9 亿美元，复合年增长率为 17.8%。在此背景下，LED 智能照明及相关配套领域将成为行业内企业的必争之地，主

要的国内外 LED 照明厂商纷纷推出智能 LED 照明产品，如欧司朗 Lightify 照明系统、飞利浦 Hue 智能灯泡等。

#### （四）行业进入壁垒

集成电路设计行业属于知识密集型行业，对产业化运作有着很高的要求，在技术、产业整合、客户、人才、资金及规模等方面存在较高的进入壁垒，具体如下：

##### 1、技术壁垒

集成电路设计属于技术密集型行业，以 LED 照明驱动芯片产品为例，设计技术涵盖了数字/模拟集成电路、集成电路 CAD、集成电路测试方法学、微电子封装技术、微机电系统、集成电路与片上系统设计等诸多领域。集成电路设计行业产品高度的复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒，行业内企业核心技术积累都需要专业技术研究团队和产品开发团队长时间探索和不断积累才能获得。

同时，由于集成电路技术及产品的更新速度很快，要求业内企业具备较强的持续创新能力，不断满足多变的市场需求。因此，行业内的后来者往往需要经历一段较长的技术摸索和积累时期，才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡。对新进入者而言，短期内无法突破核心技术壁垒。

①设计工程壁垒。合格的 LED 照明驱动芯片产品不仅需要在稳定性、可靠性等通用电气性能指标上满足市场要求，同时还需要匹配下游市场种类繁多的灯具产品。因此芯片设计公司需具备从芯片、应用电路到 LED 照明等全方位的技术储备及快速设计能力，对设计公司的技术积累和行业经验提出了较高要求。对后进者而言，这种积累和经验构成进入本行业的壁垒。

②可靠性壁垒。芯片本身存在稳定性、可靠性技术影响。一旦出现芯片寿命过短、稳定性出现问题，电子产品将出现系统无法启动、使用寿命有限等故障，对客户带来较大损失。芯片设计公司需要经过多年的技术和市场的经验积累，才能储备大量的修正数据，确保产品可靠性。对新进入厂商而言，客户对其产品的可靠性需要做长时间的验证，产品和技术的可靠性构成其进入的壁垒。

## 2、产业整合壁垒

对于芯片设计企业而言，打通从晶圆厂、封装厂、测试厂、经销商、LED照明制造商等上下游产业链，获得整合能力，是其获得发展的前提。在上游，高端工艺晶圆生产能力不足，为确保产品质量、稳定的产能供应和成本控制，芯片设计企业需要与其主要的晶圆厂、封装及测试厂商建立紧密的合作关系。采用 Fabless 模式的集成电路设计公司需经过较长时间的发展，采购量达到一定的规模后才能与主要晶圆厂、封测厂深入合作，建立起工艺设计与工艺制造的整合能力，进而拥有自主研发的制造工艺，最终确立在产业链上的关键竞争优势。

在下游，为确保产品能顺利推向市场，需要已有客户的支持，也需要不断地拓展新客户和新渠道，积累品牌知名度。对后进者而言，市场先入者已建立的、稳定运营的产业生态链构成其进入壁垒。

## 3、客户壁垒

经过多年发展，在集成电路芯片应用的各细分市场，客户对自己认可的芯片品牌已形成较高的品牌忠诚度。由于集成电路下游客户多为大规模制造型企业，该等客户对集成电路产品可靠性、稳定性要求较高。目前，市场上的主要芯片供应商都是经过多年的积累，在激烈的市场竞争中通过诚信服务、优秀的产品质量逐步积累起公司的品牌和声誉，并且已经与客户形成了长期、互信的合作关系，新进入者通常难以在短期内取得客户认同，无法打破现有市场竞争格局。

## 4、资金和规模壁垒

集成电路设计行业具有投入大、回报周期长、风险高的特点。一方面，前期需要耗费大量资金用于技术研发和产品开发，以及行业研发人员工资水平较高，需要较多的人力成本投入。为保持技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力，集成电路设计企业需进行持续的资本投入。另一方面，芯片产品单位售价相对较低，但芯片研发投入较大，因此企业研发的芯片产品市场销售数量需要高达千万颗甚至上亿颗才能实现盈亏平衡。相应的量级规模对采用 Fabless 模式的集成电路设计企业在自身资金供给、上游晶圆制造及封装测试企业的供应体系配合、下游终端市场运营等方面提出较高的要求。对后进者而言构成了行业资金和规模壁垒。



## 5、人才壁垒

芯片设计行业是知识密集型行业。高素质的经营管理团队、富有技术创新理念的研发队伍和富有经验的产业化人才是企业高速发展、保持竞争力的重要保障。目前，我国芯片设计行业的高端技术人才相对稀缺，而优秀的管理人才和产业化人才通常都集中于行业领先企业，企业之间人才争夺激烈。对于市场新进入者，人才成为重要行业壁垒。

### （五）行业的竞争格局及利润水平

#### 1、行业竞争格局

在 LED 照明行业发展初期，LED 照明驱动芯片设计技术主要掌握在恩智浦半导体（NXP Semiconductor）、艾瓦特（Iwatt）、PI（Power Integrations）等国际大型集成电路企业手中，该企业凭借较强的技术实力及品牌效应，占领了早期的 LED 照明驱动芯片市场。我国 LED 照明驱动芯片设计企业在发展前期主要以吸收模仿国外技术为主，随着国内集成电路芯片设计水平的进步以及 LED 产业链向我国的整体转移，以晶丰明源、士兰微、矽力杰为代表的行业龙头企业突破了境外企业对 LED 照明驱动芯片的技术垄断，通过性价比优势快速占领市场。国外芯片设计企业在此过程中逐步失去市场份额并退出市场竞争，如恩智浦半导体将 LED 驱动业务出售给矽力杰。

#### 2、行业利润水平变动趋势及原因

LED 照明驱动芯片的利润水平受到集成电路行业利润水平及 LED 照明产品行业利润水平波动的双重影响，具体分析如下：

① 集成电路行业利润水平影响：集成电路行业技术发展较快，产品更新换代速度较快。具有一定创新性或技术独占性的新产品在推向市场的初期，往往可以获得较高的定价，产品毛利率水平相对较高。随着竞争对手同类产品或同功能产品的不断推出，技术垄断被逐步突破，产品市场竞争将加剧，厂商往往会选择逐步调价，并最终将产品价格稳定在合理利润水平上。同时，厂商会加快下一代产品的研发及推广，通过不断向市场推出创新产品，维持整体的盈利水平。

② LED 照明产品行业利润水平影响：作为 LED 照明产品的重要元件，LED

照明驱动芯片产品利润水平及波动情况与 LED 照明产品价格具有一定的相关性。LED 照明产品作为消费类电子产品，担负着替代传统光源的重要使命。传统的 LED 照明产品价格随着技术进步及渗透率提升呈现逐步下降的趋势，但具有智能功能的 LED 照明产品价格仍处在较高水平。相对应，通用 LED 照明驱动芯片产品毛利率相对较低，智能 LED 照明驱动芯片产品毛利率相对较高。

## （六）影响行业发展的有利与不利因素

### 1、影响行业发展的有利因素

#### （1）国家产业政策的支持

国家对集成电路设计行业及 LED 照明行业的扶持为 LED 照明驱动芯片产业带来了双重利好，为 LED 照明驱动芯片产业发展提供了有利的外部环境。

集成电路设计行业方面，国家通过出台了一系列财政、税收、知识产权保护等政策，支持和鼓励集成电路设计行业的发展。同时，国家还将高端通用芯片列为 16 个国家中长期重大科技专项之一，与载人航天与探月工程、重大新药创制等具有同等战略意义。国家产业政策的支持促进了集成电路行业的发展、增强了企业的自主研发能力、提高了国内集成电路设计企业的整体竞争力。相关政策及内容具体详见本节“二、发行人所处行业的基本情况”之“（一）行业管理体制和行业政策”之“3、行业主要法律法规及行业政策”。国家产业政策的大力支持为行业的持续快速发展提供有利的外部环境。

LED 照明产业方面，国家陆续出台了一系列政策加大了对 LED 照明产业的扶持力度，具体政策主要如下：国家发改委、科技部、工信部、环保部联合印发的《“十三五”节能环保产业发展规划》提出，要推动半导体照明节能产业发展水平提升，加快大尺寸外延芯片制备、集成封装等关键技术研发，加快硅衬底 LED 技术产业化，支持 LED 智能系统技术发展。国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提到，推动智能传感器、电力电子、印刷电子、半导体照明、惯性导航等领域关键技术研发和产业化，提升新型片式元件、光通信器件、专用电子材料供给保障能力。

#### （2）市场需求的持续增长

现阶段，公司产品主要应用于 LED 照明行业，LED 照明行业的市场容量决定了公司产品的市场需求。近年来全球能源问题的日益加重催生了低碳经济的发展，各国政府纷纷加快淘汰白炽灯的步伐，作为白炽灯替代品的 LED 照明产品市场需求伴随着 LED 渗透率的提高保持了持续增长的良好态势，在通用照明、景观应用等传统替代应用领域稳步增长。此外，LED 照明产品在道路、商业、家居照明等应用领域的拓展速度较快，农业照明、智慧照明等应用市场的兴起亦加速了行业带来了新的增长点。综合上述因素，LED 照明产品市场需求将在未来保持持续增长的良好态势，LED 照明驱动芯片的市场需求将保持旺盛。

### （3）我国集成电路产业链日趋成熟

近年来，全球集成电路产业的制造重心、消费市场及人才在中国快速积聚，产业重心转移趋势明显，产业链日趋成熟。①在制造环节，台积电、中芯国际、通富微电、日月光等全球主要晶圆制造企业、封装测试企业纷纷在我国建立、扩充生产线，国内原有的晶圆代工制造企业的工艺水平也得到显著提升，为采用 Fabless 模式的国内集成电路设计企业提供了产能上的保障。②在消费市场方面，我国人口基数大、电子产品接受程度高、消费需求旺盛。随着国民经济和收入水平的快速增长，中国已成为全球最重要的电子产品消费市场。国内芯片设计企业凭借相似的文化背景，可以与下游厂商乃至终端客户保持顺畅沟通，提供更稳定的供应和更好的服务，充分发挥贴近本土市场的地缘优势。在此背景下，国内集成电路设计、制造、封测等方面的技术取得了明显的进步，原来由国外企业垄断的核心芯片设计技术也逐步被部分国内优秀企业攻克、掌握并成功产业化，对国外技术垄断的打破，使得我国的核心自主创新体系得以有效建立。

## 2、影响行业发展的不利因素

### （1）集成电路产业人才较为缺乏

集成电路设计涉及硬件、软件、电路、工艺等多个方面，需要多个相关学科的专业人才，虽然国内集成电路设计行业已历经一段快速发展时期，但就目前及未来的发展需要而言，人才尤其是高端人才仍相对匮乏。在市场需求增长、政策支持、产业重心转移等利好因素下，产业高端人才是率领企业抓住机遇、发展壮大关键。近年来，一些具备国际知名芯片企业工作背景或海外留学背景的高端

人才也逐步回到国内，为国内集成电路产业发展带来了国际先进的理念和技术。

## （2）行业内企业资金实力不强

芯片设计行业周期长、投入高、工艺技术复杂，面临产品更新落后、研发失败、无法满足目标市场等风险。因此，若要在该行业保持持续的市场竞争力，要求芯片设计企业具备很强的资金实力。同时，国内融资成本较高，社会资本也因芯片制造业投入资金量大、回报周期长、短期收益低而缺乏投入意愿。目前，我国芯片设计企业的规模和资金实力与国际大厂相比差距巨大，成为制约行业发展速度的重要因素之一。

## （七）行业技术水平及技术特点

### 1、技术水平

近年来，在国家产业政策及行业密集投资的双重驱动下，我国集成电路产业技术水平快速提升，技术创新步伐不断加快。在集成电路设计方面，随着国内部分集成电路设计企业的整合并购，我国集成电路设计企业整体实力得到进一步提升。就模拟和混合信号集成电路设计而言，行业内大部分企业已采用 0.50-0.13 $\mu\text{m}$  BCD 制造工艺；在集成电路制造方面，国内中芯国际、上海华力微电子等晶圆生产线陆续达产，芯片制造技术不断提升。近年来，国内芯片制造企业如上海华虹宏力逐步开发出适用于国内消费类电子、智能卡、电源管理、工业控制和 LED 照明等终端芯片应用的特色工艺。在集成电路封测方面，随着近年来长电科技、通富微电等企业产业并购的推进，国内各大封测企业在封装技术和工艺方面又跨出新的一步，部分技术已达到世界封装领域的先进水平。

### 2、技术特点

LED 照明驱动芯片承载着复杂 LED 控制运算功能的集成电路元件，在设计与生产上具有较高的技术规格，是决定 LED 灯长寿命、高节能、无频闪的关键因素。就 LED 照明驱动芯片技术而言，主要技术特点包括各类恒流控制方法，如脉波宽度调制（PWM）输出 LED 照明驱动芯片、准谐振模式驱动 Buck 转换器、线性恒流驱动芯片、低谐波、开关调色等调节方法，满足客户对高性能、高光效、小尺寸和低成本 LED 照明驱动芯片的要求。近年来随着智能照明应用的

逐步推广，LED 光照品质的提升和智慧照明系统集成成为 LED 照明应用的技术发展热点。

## （八）行业特有的经营模式与特征

### 1、行业特有的经营模式

集成电路产业链主要由集成电路设计、制造、封装和测试等环节组成。根据集成电路设计企业是否自建晶圆、封装及测试生产线，集成电路设计企业主要可分为 IDM 模式和 Fabless 模式。具体情况如下：

#### ①IDM 模式

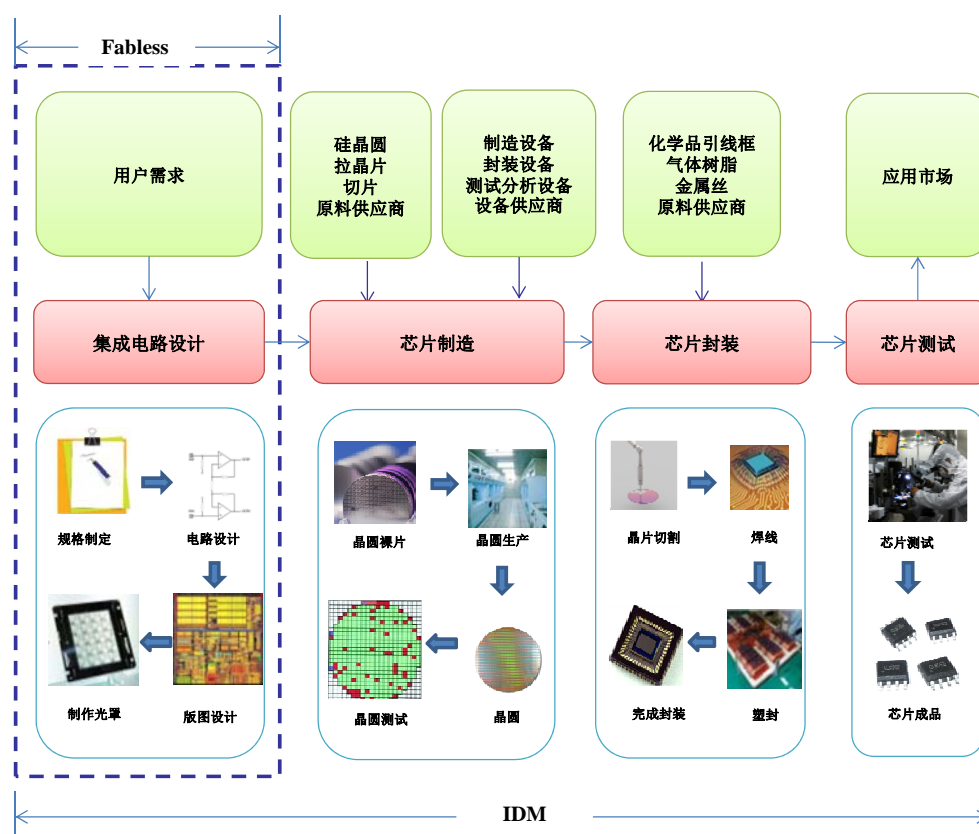
IDM 模式即垂直整合制造模式，是指企业除了进行集成电路设计之外，还拥有自己的晶圆厂、封装厂和测试厂，其业务范围涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装及测试等环节。由于该模式对企业的资金实力、研发力量、工艺水平、组织管理等要求较高，采用 IDM 模式的企业均为技术、资金实力雄厚的全球芯片行业巨头，如 Intel（英特尔）、TI（德州仪器）、Samsung（三星半导体）等。

#### ②Fabless 模式

Fabless 模式即无晶圆生产线集成电路设计模式，与 IDM 相比，指仅仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商的模式。由于无需花费巨额资金建立生产线，Fabless 厂商可以集中资源专注于集成电路的研发设计，具有“资产轻、专业强”的特点。Fabless 模式使得公司能在资金和规模有限的情况下，充分发挥公司的研发能力，集中资源进行集成电路的设计和研发，对公司的快速发展起到了至关重要的作用。当今国际上大量知名集成电路企业采用 Fabless 模式，如高通、AMD、苹果公司、飞思卡尔、联发科技等。国内芯片行业中的领先企业如华为海思、展讯通信、华大半导体、大唐半导体、中兴微电子等，以及国内芯片行业上市公司如全志科技、北京君正、富瀚微等均采用 Fabless 模式，本公司亦采纳此种模式。

传统的半导体厂商集合了设计、生产加工、封装、测试等业务流程。IDM 模式曾经是半导体厂商最主要的商业模式。随着半导体产业技术发展，半导体晶体管密度不断增加，晶圆厂的建设成本也持续提高。近年，建设单个 12 寸晶圆

厂的投资资金已经达到数十亿美元。巨额初始投资、后续沉重的固定资产折旧和运营成本以及晶圆代工技术的成熟导致越来越多的半导体生产企业选择 Fabless 模式。1987 年台积电成立，仅提供晶圆代工服务，促进了 Fabless 模式的形成。晶圆代工厂的发展促进许多芯片公司走向轻资产化，相应生产环节交给台积电、中芯国际、华虹集团等代工厂完成，这些芯片公司将业务集中在产品设计和产品销售上。除了初创企业选择 Fabless 模式外，部分芯片行业巨头也逐渐从 IDM 模式转型为 Fabless 模式。如 2008 年芯片行业巨头 AMD 出售晶圆厂，从 IDM 模式转变为 Fabless 模式。同时，集成电路制造工艺日趋成熟，集成电路加工线可以生产各品种的集成电路产品，为设计和制造分离奠定技术基础。Fabless 模式得到了长足的发展，已成为集成电路产业里一种普遍及重要的模式。



## 2、行业特征

### (1) 周期性

本行业的发展受到集成电路技术发展规律的影响，呈现一定的周期性。集成电路技术发展规律是指芯片性能每隔一段时间提升一倍的摩尔定律。因此，本行业呈现新产品市场规模增长、旧产品市场规模下降的周期性规律。

## （2）区域性

目前，国内集成电路设计企业主要集中于长三角、珠三角及京津环渤海三大区域。上述区域已经形成了相对完善、成熟的产业链。根据工信部《关于通过2014年度年审的集成电路设计企业名单的通知》（工信部电子[2014]477号），通过2014年度审查的413家集成电路设计企业中，珠江三角洲、长江三角洲、京津环渤海三大区域集成电路设计企业数量总和占全国数量的80%以上。

## （3）季节性

报告期内，公司营业收入存在一定的季节性波动，其中二季度、四季度收入占比超过一季度、三季度。主要原因为：下游LED照明行业受年末西方节日因素影响，四季度为销售旺季，出货量及对公司产品采购量相应增加；受年初国内节日放假因素影响，部分LED厂商一季度停工时间较长，部分订单移至二季度安排生产，导致二季度对公司产品采购量相应增加。

## （九）行业与上下游行业之间的关联性

### 1、公司所处行业上下游

集成电路产业链包括为集成电路设计、制造、封装、测试及下游应用产品制造。按照芯片产品的形成过程，集成电路设计行业是集成电路行业的上游。集成电路设计企业负责设计产品方案，并将芯片产成品销售给下游电子设备制造厂商。晶圆代工厂商和封装测试厂商完成芯片的制造和封装测试。

### 2、上下游行业对本行业的影响

公司所处行业为集成电路设计业，是集成电路产业的源头，但由于采用Fabless模式，公司需要委托晶圆制造厂和封装测试厂进行加工生产。因此，晶圆制造厂和封装测试行业成为上游行业。上游行业对本行业的影响主要体现在技术工艺的可实现性、良品率、供货量及交货周期等方面，晶圆制造厂和封装测试的生产成本变动在一定程度上也会影响本行业利润率。公司主要产品为LED照明驱动芯片，下游应用领域主要为LED照明行业。LED照明产品广泛应用于家用照明、景观照明、工业照明等领域。

### 三、发行人在行业中的竞争地位

#### （一）发行人的行业地位

公司是目前国内领先的LED照明驱动芯片设计企业之一，LED照明驱动芯片作为公司核心主营产品，其技术含量、工艺水平等性能指标在行业内处于领先地位，已经达到或接近国际先进水平。公司LED照明驱动芯片产品下游主要客户为LED照明生产厂商。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）统计，2016年我国国内LED照明产品产量约为80亿只，公司2016年LED照明驱动芯片国内销量为23.04亿颗。按照每只LED照明产品通常配套一颗LED照明驱动芯片测算，公司2016年国内LED照明驱动芯片市场占有率约为28.80%，市场占有率较高。

公司与国内外主要的LED照明产品供应商如飞利浦、欧普照明、雷士照明、阳光照明、三雄极光、佛山照明、得邦照明等均建立了长期的合作关系，2016年“中国LED照明产品出口十强企业”均配套应用了公司LED照明驱动芯片。公司在LED照明驱动芯片领域具有较高的行业地位。

#### （二）同行业其他企业情况

公司主要产品为LED照明驱动芯片，LED照明驱动芯片领域其他企业具体情况如下：

企业名称	简要情况
杭州士兰微电子股份有限公司	成立于1997年9月，专业从事集成电路以及半导体微电子相关产品的设计、生产与销售，主要产品包括MCU电路、电源管理电路、LED照明驱动电路、LED显示驱动/控制电路等产品。
矽力杰半导体技术（杭州）有限公司	成立于2008年4月，一家专业从事模拟IC设计公司，主要产品包括照明驱动和控制IC、直流输入LED照明控制IC、升压型LED背光控制IC等。
Dialog Semiconductor	成立于1981年，一家专业从事混合信号集成电路公司，主要产品包括连接器、电源管理、音频器、LED驱动IC等。
深圳市明微电子股份有限公司	成立于2003年10月，专注于LED显示屏、LED照明及电源管理、LED景观亮化等驱动芯片的研发，主要产品包括LED照明驱动类、电源管理类等产品。



## 四、发行人的竞争优势与劣势

### （一）竞争优势

#### 1、技术优势

公司自成立以来一贯重视技术研发，经过多年的研发投入和技术积累，在集成电路设计尤其是 LED 照明驱动细分领域中技术上积累了丰富的经验，根据客户需求累计推出了 500 多种产品型号，自主研发并掌握的 700V 高压集成工艺、LED 恒流的源极驱动技术、LED 驱动芯片的供电技术、LED 电流纹波消除技术、700V 单芯片技术等核心技术具有显著技术优势。截至本招股说明书签署日，已获得国际专利 2 项，国内专利技术 107 项，集成电路布图设计专有权 61 项。拥有自主研发的国内外自主知识产权技术成为公司与国内外领先的 LED 照明生产企业合作的重要技术优势。

公司是经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国税局、上海市地税局联合认定的“高新技术企业”，荣获“上海市科技小巨人企业”、“2016 中国 LED 首创奖”、“上海科技企业创新奖”、“2016 年度浦东新区企业研发机构”、“上海市专利工作试点企业”等荣誉称号。在长期自主研发和创新的过程中，公司积累了丰富的成果。公司获得的市级以上科技成果、奖励及参与的科研攻关项目情况如下所示：

序号	奖励名称	项目名称	项目编号	颁发机构
1	上海市高新技术成果转化项目	LED 恒流 IC (BP2808/BP1361)	201008374	上海市高新技术成果转化项目认定办公室
2		调光 LED 驱动 IC (BP3105/BP3108)	201105208	
3		高效率非隔离 LED 驱动芯片 (BP2812/BP2808B/BP2822)	201301077	
4		高功率因数 LED 驱动芯片 (BP3309/BP2309)	201301078	
5		高压线性恒流 LED 驱动芯片	201302157	
6		智能温控 LED 驱动芯片	201305311	
7		高性能有源功率因数校正驱动芯片	201412632	
8		可控硅调光发光二极管驱动芯片	201412631	

9	创新基金证书	LED 照明驱动电路恒流控制芯片	12C0417	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心
10	第十一届（2016 年度）中国半导体创新产品和技术	可控硅调光发光二极管驱动芯片	-	中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社
11	四川省科学技术进步奖	功率高压 MOS 器件关键技术与应用	2016-J-1-09-D04	四川省人民政府

## 2、品牌优势

依靠卓越的科研能力和优质的产品，公司获得了良好的行业品牌认知度，具有明显的品牌效应，也树立起了国内外领先的行业地位。公司已与国内外主要的 LED 照明厂商建立了长期稳定的合作关系，使公司能够掌握行业、产品最新技术动态，能够及时了解和把握客户的最新需求，准确地进行芯片产品更新升级，确保公司产品在市场竞争中保持先发优势，同时积累产品行业应用经验，完善产品性能，提高产品质量水平。相对于海外竞争对手，公司一方面更加贴近、了解本土市场，能够快速响应客户需求，提供充分的服务支持；另一方面，公司与国内 LED 照明产品厂商在企业文化、市场理念和售后服务等方面更能相互认同，业务合作通畅、高效，形成了密切的且相互依存的产业生态链。

发行人与下游行业内众多大型 LED 照明企业建立了稳定的合作关系，得邦照明、立达信、生辉照明等客户授予公司“特殊贡献奖”、“创新开发奖”、“最佳创新奖”等奖项。大型客户为保持其品牌形象、产品质量和成本优势，在选择供应商时对技术水平、产品品质和供应稳定性等提出了更高的要求，因此能够与大型企业建立长期稳定的合作关系是对公司品牌高度认可的表现，也标志着“晶丰明源”是行业内具有影响力的品牌。

## 3、客户优势

LED 照明驱动芯片作为 LED 照明产品生产的重要部件之一，其下游市场销售与 LED 照明厂商需求直接相关。公司与国内外主要的 LED 照明企业飞利浦、欧普照明、雷士照明、阳光照明、三雄极光、佛山照明、得邦照明等建立了长期的合作关系，2016 年“中国 LED 照明产品出口十强企业”全部企业均配套应用

了发行人 LED 照明驱动芯片。该等 LED 照明厂商对驱动芯片需求量较大，产品市场覆盖全球。公司与该等照明厂商的合作有助于公司 LED 照明驱动芯片销售实现持续的快速增长，并成为行业内重要的供应商。发行人凭借一流的产品和服务，经过多年的市场积累，成功进入一大批客户的供应链，主要客户如下：



#### 4、供应链整合优势

公司非常注重与上游主要的供应商保持稳定、持续的战略合作。公司的主要供应商为华虹宏力、华天科技、长电科技、通富微电，其中华虹宏力为全球领先晶圆代工厂商，华天科技、长电科技、通富微电是全球前列的封装测试厂商。除上述供应商之外，公司已开始与中芯国际、日月光等业内知名的供应商合作。公司积极加强与供应商的资源整合，根据新产品的特殊工艺及封测要求及时与供应商沟通并向其反馈新的市场信息，供应商在提供优质的制造、封测服务的同时，也持续与本公司沟通新工艺、新技术的更新情况，定期进行技术交流，形成了通畅的互馈平台。

## 5、人才优势

芯片设计行业是知识密集型行业，人才是此类公司发展不可或缺的关键因素。公司创始人之一胡黎强先生是国内 LED 照明驱动芯片领域的开拓者，曾获得“上海市领军人才”、“上海科技企业家创新奖”等荣誉称号。通过多年的集成电路设计和产品研发实践，公司组建了高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队，核心成员也均由行业资深专家组成，拥有在行业内多年的工作和管理经验。公司核心管理团队长期致力于企业管理和市场拓展，具备丰富的管理经验和敏锐的市场眼光。公司核心技术团队长期致力于 LED 照明驱动芯片研发设计、产品解决方案开发，具备业界领先的技术能力。公司同时吸纳行业内的高端、专业人才加盟，形成了面向长远的人才梯队。集成电路设计行业人才竞争激烈，依赖于优秀的企业文化，公司主要核心技术团队和核心管理团队保持高度稳定，为公司未来的快速发展奠定了良好的人才基础。

## 6、轻资产模式的优势

对 IDM 企业而言，随着芯片工艺水平不断提升，晶圆制造所需的设备投入资金量越来越大，IDM 企业的价值数十亿美元的晶圆生产线、封装测试线均为自建，若不能维持高速增长和较高的市场规模，高价值设备带来的巨额维护费用和折旧将形成沉重的财务负担。同时 IDM 企业缺乏灵活性，一旦技术进步超过目前的生产工艺水平，新建生产线成本巨大，导致竞争力下降。相反，公司采用 Fabless 生产模式，轻资产模式下灵活度较高，可以充分利用国内完整的半导体产业链，从而公司可以把主要精力集中于芯片的设计、开发与销售，确保在激烈的市场竞争中能够快速调整、快速发展。

## （二）竞争劣势

### 1、融资渠道较为单一

公司发展过程中主要依靠经营积累解决业务发展带来的资金需求，融资渠道较为单一。而随着下游市场的稳定发展，公司需要拓展产品种类、优化产品结构，顺应行业发展方向，通过技术升级推动产品结构升级，由此将带来较大的资金需求压力，因此公司亟需拓展融资渠道以进一步提高盈利能力和可持续发展能力。

## 2、产品种类不足

公司自成立以来即深耕于 LED 照明驱动芯片领域，尽管突出了该领域的专业化，但应用于其他领域的芯片产品种类相对不足。目前公司已逐步开展电机驱动芯片产品研发与销售。未来进一步拓展公司产品种类，成为公司重要的发展战略之一。

## 五、发行人的主营业务情况

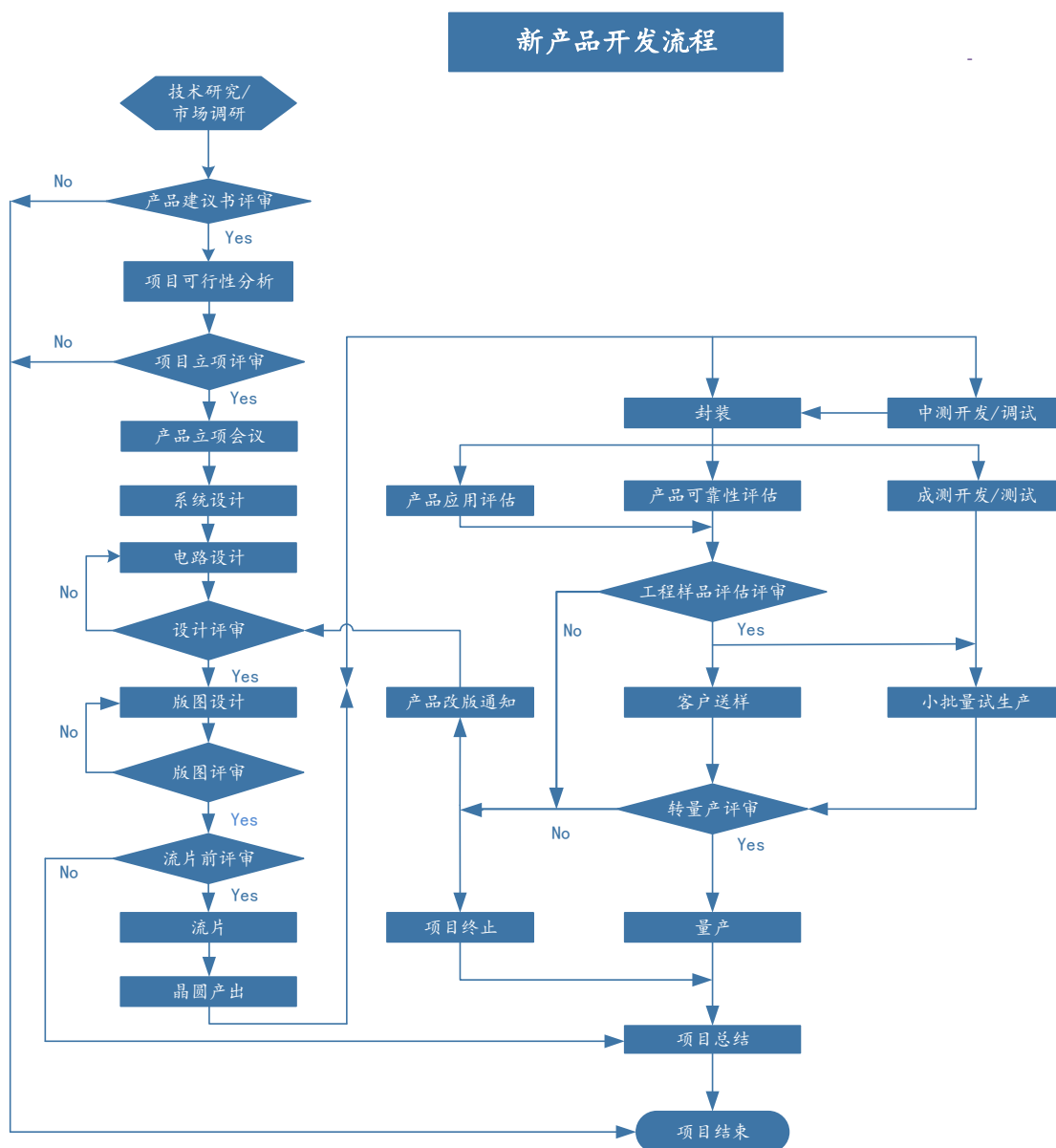
### （一）主要产品及用途

公司主要产品为 LED 照明驱动芯片，包括通用 LED 照明驱动芯片、智能 LED 照明驱动芯片，具体如下：

产品类别	产品描述	产品主要应用领域
通用 LED 照明驱动芯片	LED 照明产品的核心部件，是驱动 LED 发光或 LED 模块组件正常工作的电源调整芯片，主要应用于日常 LED 照明产品的恒流驱动芯片。	LED 蜡烛灯、LED 球泡灯、车载 LED 灯、LED 舞台灯、太阳能 LED 灯、LED 信号灯和 LED 路灯等不同类型的 LED 灯
智能 LED 照明驱动芯片	在通用 LED 照明驱动芯片基础上增加模组、电源、智能控制系统或加载的各项与智能化等有关系统模块已满足智能 LED 照明需要，主要应用于多元化场景。	

### （二）主要产品的研发流程

公司的产品研发流程如下：



公司对产品开发实行严格的流程管理，涵盖了从产品项目可行性研究、评审、实施、产品投片到工程验证和质量验证以及量产等重要环节，以确保产品开发的全过程得到有效的监控并达到预期目标。

### （三）主要经营模式

#### 1、研发模式

公司坚持以“创享绿色芯生活，助力全球芯智造”为使命，努力通过芯片技术的创新为客户提供高质量和高性价比的 LED 照明驱动芯片。公司以客户为中心，坚持技术的先进性、研发的独创性、团队的专业性，以细致周到的客户服务与顶尖的产品质量满足客户需求。

公司依据《产品开发和设计流程》和《产品封装设计规则》及配套管理文件进行产品和技术研发管理。为了保证公司能够持续推出技术领先、符合市场需求、具有市场竞争力的创新产品，公司采用“预研—研发—试产—量产”流水式研发策略，保证公司的成熟产品在量产及稳定出货的同时，有引领当前市场的新产品处于研制阶段，并有符合市场发展趋势的未来产品进入预研阶段。

## 2、采购/生产模式

公司采用集成电路设计行业典型的 Fabless 经营模式，主要负责芯片的设计、生产工艺技术的开发及产品质量管控，晶圆制造、封装、测试等生产制造环节均通过委托第三方加工的方式完成。公司产品在自主完成集成电路版图设计后，向晶圆代工厂下达晶圆加工订单。晶圆代工厂完成晶圆加工后，将晶圆转到集成电路封装测试企业。封装测试企业完成芯片的封装、测试作业，形成芯片成品。

公司秉承“不断创新、卓越品质、一流服务”的原则，制定了《供应商管理规定》、《采购控制管理规定》、《生产计划控制程序》、《物料仓储管理规定》、《商务管理规范》及配套管理文件，详细规定了供应商的选择、稽核、委托加工、质量管控等流程，对采购和生产过程进行标准化和制度化管理，以保证生产效率、成本控制和产品质量。

公司采购的具体实施步骤如下：

（1）在产品研发初期即可行性研究和立项阶段，公司研发人员与供应链管理人员组成晶圆代工厂商评估团队，对晶圆代工厂商进行专业评估，综合从工艺水平、品质、价格、产能、供货及时性、物流服务等方面对供应商进行评价，并确定合格晶圆代工厂商名单。确定晶圆代工厂商后，公司使用自主研发的工艺技​​术或者导入供应商工艺技术支持体系，进行芯片的研发。公司对芯片及模块产品封装和测试服务供应商的选定与晶圆代工厂商遴选方式类似。

（2）在产品试产阶段，在产品测试（晶圆测试和成品测试）和良品率提高方面，公司需要与晶圆代工厂商、封装测试厂商进行紧密技术合作。封装测试厂商根据​​公司需求，建立相应的生产过程，组织生产所使用的工装和治具；公司提供验证产品设计的测试程序，由封装测试工厂商完成测试，公司根据测试结果进一步优化测试程序；根据公司不断提高的产品质量和交付周期要求，晶圆代工和

封装测试厂商持续改进生产设备，改善工艺流程，提高生产效率。

（3）在产品量产阶段，通常根据市场需求规划确定晶圆采购量，由公司向晶圆代工厂商下达订单，晶圆代工厂商安排生产。一般情况下，晶圆的生产周期为 6-8 周。生产过程中，公司向晶圆代工厂商获取生产进度情况报告，跟踪生产进度。晶圆加工完毕并经质量检验合格及中测后，晶圆代工厂商将晶圆发送到指定的测试和封装厂商。

（4）在封装和测试阶段，封装和测试厂商完成芯片封装和测试，并将经过封装并测试合格的芯片产品入库或发往指定的交货地点。

### 3、销售模式

#### （1）境内销售模式

针对境内市场的特点，公司采取以“经销为主、直销为辅”的销售模式。

公司已建立了成熟完善的经销商管理制度。通过比较信誉、资金实力、市场影响力、客户服务水平等因素，公司择优选择优质经销商。经销商通常会定期向公司提供客户的采购数量、产品使用情况等相关市场统计资料。为加强对经销商的管理，公司会不定期对经销商进行实地拜访和核实。公司的经销模式均为买断式经销。

对于部分规模较大、重要性程度较高的客户，公司采用直销模式实现销售，缩短销售环节，提高对客户需求的响应速度。

#### （2）境外销售模式

公司设立了晶丰香港作为境外销售管理平台。晶丰香港获取境外订单后，根据订单要求向公司采购，并委托公司将货物报关运送到经销商指定的境外交货地点。

### （四）发行人主营产品的产销情况

#### 1、发行人报告期主要产品的产量及销量情况

2017年1-3月产量及销量			
产品	产量（万粒）	销量（万粒）	产销率
通用 LED 驱动芯片	61,565.65	55,386.26	89.96%



智能 LED 驱动芯片	7,884.83	7,127.97	90.40%
<b>2016 年产量及销量</b>			
<b>产品</b>	<b>产量（万粒）</b>	<b>销量（万粒）</b>	<b>产销率</b>
通用 LED 驱动芯片	212,769.89	214,548.01	100.84%
智能 LED 驱动芯片	21,347.07	20,951.17	98.15%
<b>2015 年产量及销量</b>			
<b>产品</b>	<b>产量（万粒）</b>	<b>销量（万粒）</b>	<b>产销率</b>
通用 LED 驱动芯片	115,180.03	110,388.38	95.84%
智能 LED 驱动芯片	11,492.98	10,108.81	87.96%
<b>2014 年产量及销量</b>			
<b>产品</b>	<b>产量（万粒）</b>	<b>销量（万粒）</b>	<b>产销率</b>
通用 LED 驱动芯片	87,851.53	82,794.83	94.24%
智能 LED 驱动芯片	-	-	-

## 2、产品销售量与销售价格变动情况

项目	2017 年 1-3 月		2016 年		2015 年		2014 年	
	销量 (万粒)	平均价格 (元/粒)	销量 (万粒)	平均价格 (元/粒)	销量 (万粒)	平均价格 (元/粒)	销量 (万粒)	平均价格 (元/粒)
通用 LED 驱动芯片	55,386.26	0.22	214,548.01	0.22	110,388.38	0.28	82,794.83	0.41
智能 LED 驱动芯片	7,127.97	0.35	20,951.17	0.38	10,108.81	0.38	-	-

## 3、公司前五名客户情况

报告期内，公司对前五名销售客户销售额及其占当期营业收入比例如下表所示：

单位：万元

2017 年 1-3 月			
序号	客户名称	销售金额	占营业收入比重
1	广州晶丰电子科技有限公司	1,831.76	11.97%
2	深圳市弘雷电子有限公司	1,539.96	10.06%
3	上海迎霄电子有限公司	1,400.54	9.15%
4	厦门欣友联电子科技有限公司	1,187.47	7.76%
5	深圳市怡海能达有限公司	1,161.11	7.58%

	合计	7,120.83	46.51%
<b>2016 年</b>			
序号	客户名称	销售金额	占营业收入比重
1	广州晶丰电子科技有限公司	6,482.76	11.36%
2	厦门欣友联电子科技有限公司	5,052.93	8.85%
3	深圳市怡海能达有限公司	4,383.34	7.68%
4	深圳市暗能量电源有限公司	4,382.13	7.68%
5	中山市苏电科技电子有限公司	4,135.04	7.24%
	合计	24,436.20	42.80%
<b>2015 年</b>			
序号	客户名称	销售金额	占营业收入比重
1	厦门欣友联电子科技有限公司	4,746.13	13.29%
2	广州晶丰电子科技有限公司	4,433.71	12.42%
3	上海元捷电子科技有限公司	3,230.48	9.05%
4	中山市苏电科技电子有限公司	2,772.06	7.76%
5	深圳市暗能量电源有限公司	2,644.87	7.41%
	合计	17,827.27	49.92%
<b>2014 年</b>			
序号	客户名称	销售金额	占营业收入比重
1	广州晶丰电子科技有限公司	5,552.68	16.46%
2	深圳市暗能量电源有限公司	4,248.19	12.60%
3	中山市苏电科技电子有限公司	2,867.89	8.50%
4	厦门欣友联电子科技有限公司	2,590.33	7.68%
5	上海元捷电子科技有限公司	2,376.66	7.05%
	合计	17,635.75	52.29%

报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过总额 50%的情况，不存在公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方和持有 5%以上股份的股东在上述客户中占有权益的情况。

## （五）发行人采购与主要供应商情况

### 1、主要采购及能源供应情况

公司采用Fabless经营模式，不直接从事芯片的生产和加工，对外采购原材料

主要为晶圆、MOS（副芯片），对外采购服务主要为封装测试服务。公司能源需求主要为办公用水、电，消耗金额较小，其价格波动对公司盈利能力不构成重大影响。

## 2、主要采购情况

### （1）主要原材料及委外加工采购情况

报告期内，公司晶圆、封装测试、MOS（副芯片）的采购情况具体如下：

2017年1-3月			
序号	采购类别	金额（万元）	占总采购额比重
1	晶圆	5,399.68	39.55%
2	MOS（副芯片）	3,050.54	22.34%
3	封装及测试	4,984.78	36.51%
合计		<b>13,435.00</b>	<b>98.39%</b>
2016年			
序号	采购类别	金额（万元）	占总采购额比重
1	晶圆	17,647.49	39.15%
2	MOS（副芯片）	9,463.59	20.99%
3	封装及测试	17,166.00	38.08%
合计		<b>44,277.08</b>	<b>98.22%</b>
2015年			
序号	采购类别	金额（万元）	占总采购额比重
1	晶圆	9,771.57	34.27%
2	MOS（副芯片）	6,655.93	23.34%
3	封装及测试	11,573.91	40.59%
合计		<b>28,001.42</b>	<b>98.20%</b>
2014年			
序号	采购类别	金额（万元）	占总采购额比重
1	晶圆	5,792.79	23.97%
2	MOS（副芯片）	7,563.11	31.29%
3	封装及测试	10,483.27	43.38%
合计		<b>23,839.18</b>	<b>98.64%</b>

### （2）主要采购价格变动情况

报告期内，公司主要原材料及服务采购单价波动情况如下：

项目	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
晶圆（元/片）	1,626.26	1,773.31	1,957.52	2,227.74
MOS（元/粒）	0.07	0.07	0.08	0.09
封装测试（元/粒）	0.07	0.07	0.09	0.12

### 3、前五大供应商情况

报告期内，公司前五大供应商的采购金额及比例如下所示：

单位：万元

2017年1-3月				
序号	供应商名称	采购内容	采购金额	占采购总额比重
1	上海华虹宏力半导体制造有限公司	晶圆	4,348.55	31.75%
2	天水华天科技股份有限公司	封测	2,054.89	15.00%
3	吉林华微电子股份有限公司	MOS	1,659.13	12.11%
4	无锡华润上华科技有限公司 <sup>注</sup>	晶圆、MOS	1,354.38	9.89%
5	江苏长电科技股份有限公司	封测	1,206.08	8.81%
合计			<b>10,623.03</b>	<b>77.55%</b>
2016年				
序号	供应商名称	采购内容	采购金额	占采购总额比重
1	上海华虹宏力半导体制造有限公司	晶圆	16,841.33	37.36%
2	天水华天科技股份有限公司	封测	7,647.24	16.96%
3	江苏长电科技股份有限公司	封测	5,659.92	12.56%
4	吉林华微电子股份有限公司	MOS	5,054.60	11.21%
5	无锡华润上华科技有限公司 <sup>注</sup>	晶圆、MOS	3,510.37	7.79%
合计			<b>38,713.46</b>	<b>85.88%</b>
2015年				
序号	供应商名称	采购内容	采购金额	占采购总额比重
1	上海华虹宏力半导体制造有限公司	晶圆	8,849.08	31.03%
2	天水华天科技股份有限公司	封测	5,337.22	18.72%
3	江苏长电科技股份有限公司	封测	4,917.82	17.25%

4	吉林华微电子股份有限公司	MOS	4,139.93	14.52%
5	无锡华润上华科技有限公司 <sup>注</sup>	晶圆、MOS	2,148.05	7.53%
合计			<b>25,392.11</b>	<b>89.05%</b>
<b>2014 年</b>				
序号	供应商名称	采购内容	采购金额	占采购总额 比重
1	吉林华微电子股份有限公司	MOS	7,494.04	31.01%
2	江苏长电科技股份有限公司	封测	5,909.17	24.45%
3	上海华虹宏力半导体制造有限公司	晶圆	5,570.52	23.05%
4	天水华天科技股份有限公司	封测	4,058.07	16.79%
5	上海纪元微科电子有限公司	封测	260.06	1.08%
合计			<b>23,291.87</b>	<b>96.37%</b>

注：无锡华润上华科技有限公司合并金额包含无锡华润上华半导体有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司、华润赛美科微电子（深圳）有限公司，该四家公司受同一控制，故合并计算。

报告期内，公司不存在向单个供应商采购比例超过采购总额 50%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方和持有 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

## 六、发行人主要固定资产及无形资产

### （一）主要固定资产情况

公司主要固定资产为办公设备、机器设备、电子设备、运输设备等，截至 2017 年 3 月 31 日，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元

固定资产	资产原值	累计折旧	资产净值	成新率
办公设备	115.61	43.39	72.22	62.47%
机器设备	341.94	186.26	155.68	45.53%
电子设备	112.35	51.87	60.47	53.83%
运输设备	180.84	19.14	161.70	89.42%
总计	750.73	300.66	450.07	59.95%

#### 1、租赁房产

目前，公司所使用的办公场所均为租赁房产，截至 2017 年 3 月 31 日，公司租赁房产具体情况如下：

序号	出租方	用途	租赁期限	面积 (m <sup>2</sup> )	地址
1	上海盛锦软件开发有限公司	办公场所	2016.6.1-2019.5.31	1,796.00	上海市浦东新区张衡路 666 弄 2 号 5 层
2	上海凯尔汽车内饰有限公司	办公仓储	2015.3.15-2018.3.14	1,497.50	上海市浦东新区川沙路 159 弄 88 号 108 室
3	中山市万旗灯饰广场有限公司	办公场所	2017.4.1-2020.3.31	350.00	广东省中山市古镇镇同兴路 59 号中山市万维 LED 灯饰广场商业中心 5 楼 501 室
4	深圳市龙兴世纪投资有限公司	办公场所	2017.5.11-2018.5.31	274.74	深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路交界七星商业广场
5	成都华茂兴蓉置业有限公司	办公场所	2016.3.1-2019.2.28	148.95	成都市成华区二环路东二段 508 号万科华茂广场项目办公楼 16 层

## （二）主要无形资产

### 1、专利权

#### （1）国内专利

截至本招股说明书签署日，公司拥有专利 107 项，其中发明专利 35 项、实用新型 72 项。该等专利均为有效状态，公司已取得相关专利证书。具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日期	专利权人	取得方式
1	一种改善 LED 调光性能的控制电路、控制方法以及 LED 驱动系统	发明专利	ZL201610221479.0	2016.04.11	晶丰明源	原始取得
2	调光电路、调光芯片、调光系统及其调光方法	发明专利	ZL201510982454.8	2015.12.24	晶丰明源	原始取得
3	软开关控制模块以及直流无刷电机驱动系统	发明专利	ZL201510236520.7	2015.05.11	晶丰明源	原始取得
4	纹波抑制 LED 驱动电路	发明专利	ZL201410686190.7	2014.11.26	晶丰明源	受让取得
5	LED 驱动电路	发明专利	ZL201410686211.5	2014.11.26	晶丰明源	受让取得
6	发光二极管驱动电路	发明专利	ZL201410686259.6	2014.11.26	晶丰明源	受让取得
7	LED 快速启动电路	发明专利	ZL201410686288.2	2014.11.26	晶丰明源	受让取得

8	可调亮度模块及可调亮度的LED驱动系统	发明专利	ZL201410416750.7	2014.08.22	晶丰明源	原始取得
9	退磁检测控制模块以及退磁检测系统	发明专利	ZL201410405352.5	2014.08.18	晶丰明源	原始取得
10	供电模块、开关电源芯片以及开关电源系统	发明专利	ZL201410352096.8	2014.07.23	晶丰明源	原始取得
11	无刷电机相位超前角上限设定的方法、装置和控制系统	发明专利	ZL201410308676.7	2014.06.30	晶丰明源	受让取得
12	无刷电机相位超前角优化的方法、装置和控制系统	发明专利	ZL201410308679.0	2014.06.30	晶丰明源	受让取得
13	电机转子位置信号的自适应处理方法、装置和控制系统	发明专利	ZL201410309975.2	2014.06.30	晶丰明源	受让取得
14	可调色温模块、可调色温的LED驱动电路及系统	发明专利	ZL201410248427.3	2014.06.06	晶丰明源	原始取得
15	泄放控制模块、可控硅调光LED驱动电路及系统	发明专利	ZL201410077775.9	2014.03.05	晶丰明源	原始取得
16	最大亮度提升模块、可控硅调光LED驱动电路及系统	发明专利	ZL201410046299.4	2014.02.10	晶丰明源	原始取得
17	开关电源功率管过载检测电路	发明专利	ZL201310621416.0	2013.11.30	晶丰明源	受让取得
18	可检测占空比的可变基准电源	发明专利	ZL201310621621.7	2013.11.30	晶丰明源	受让取得
19	恒流控制电路	发明专利	ZL201310621622.1	2013.11.30	晶丰明源	受让取得
20	直流转换开关降压开关电源	发明专利	ZL201310621624.0	2013.11.30	晶丰明源	受让取得
21	原边控制供电电路	发明专利	ZL201310621625.5	2013.11.30	晶丰明源	受让取得
22	负载调整补偿开关电源	发明专利	ZL201310621626.X	2013.11.30	晶丰明源	受让取得
23	高精度基准电压积分采样电路	发明专利	ZL201310612504.4	2013.11.28	晶丰明源	受让取得
24	一种时间倍乘信号生成电路	发明专利	ZL201310612587.7	2013.11.28	晶丰明源	受让取得
25	一种开关电源LED控制电路	发明专利	ZL201310612768.X	2013.11.28	晶丰明源	受让取得
26	采用原边控制的反激拓扑结构电路	发明专利	ZL201310613120.4	2013.11.28	晶丰明源	受让取得
27	一种可控硅调光LED驱动电路	发明专利	ZL201310257527.8	2013.06.26	晶丰明源	原始取得
28	一种LED电流纹波消除驱动电路	发明专利	ZL201310218482.3	2013.06.04	晶丰明源	原始取得

29	一种LED驱动电源中的过压保护电路及LED驱动电源	发明专利	ZL201310139467.X	2013.04.22	晶丰明源	原始取得
30	线输入电压补偿电路	发明专利	ZL201310120749.5	2013.04.09	晶丰明源	受让取得
31	一种电感电流全周期采样的LED驱动电路	发明专利	ZL201310073418.0	2013.03.08	晶丰明源	原始取得
32	一种兼容可控硅调光器调光的LED照明驱动电路和方法	发明专利	ZL201010146645.8	2010.04.14	晶丰明源	原始取得
33	输出电压及电感量变化保持恒流的源级驱动LED驱动电路	发明专利	ZL200910246151.4	2009.11.27	晶丰明源	原始取得
34	一种低成本高可靠性LED开路保护电路	发明专利	ZL200910057695.6	2009.08.03	晶丰明源	原始取得
35	高效率恒流LED驱动电路及驱动方法	发明专利	ZL200910057090.7	2009.04.17	晶丰明源	原始取得
36	开关调色温控制器、控制芯片及LED恒流驱动系统	实用新型	ZL201720005544.6	2017.01.04	晶丰明源	原始取得
37	数字电平转换电路、半桥预驱动器、半桥预驱动芯片及无刷直流电机控制系统	实用新型	ZL201621441898.7	2016.12.27	晶丰明源	原始取得
38	照明装置、控制芯片及线性调光系统	实用新型	ZL201621300929.7	2016.11.30	晶丰明源	原始取得
39	供电电路、开关电源控制芯片及开关电源系统	实用新型	ZL201621252653.X	2016.11.22	晶丰明源	原始取得
40	自适应采样电路、控制器及电源转换装置	实用新型	ZL201621188378.X	2016.11.04	晶丰明源	原始取得
41	高压LDMOS器件	实用新型	ZL201621154133.5	2016.10.31	晶丰明源	原始取得
42	发光电路及其应用的控制器	实用新型	ZL201621124669.2	2016.10.14	晶丰明源	原始取得
43	复合型场效应晶体管及控制器	实用新型	ZL201621109938.8	2016.10.10	晶丰明源	原始取得
44	控制器以及采用该控制器的开关电源	实用新型	ZL201621111462.1	2016.10.10	晶丰明源	原始取得
45	调光控制电路及可控硅调光LED驱动电源	实用新型	ZL201620918381.6	2016.08.22	晶丰明源	原始取得
46	一种脉冲宽度调制控制信号调光控制电路及LED驱动系统	实用新型	ZL201620623194.5	2016.06.22	晶丰明源	原始取得
47	温度检测模块及具有温度控制功能的驱动电源系统	实用新型	ZL201620504694.7	2016.05.30	晶丰明源	原始取得



48	一种输出短路保护电路和负载驱动系统	实用新型	ZL201620466294.1	2016.05.20	晶丰明源	原始取得
49	供电电路、控制芯片、开关电源系统	实用新型	ZL201620343916.1	2016.04.22	晶丰明源	原始取得
50	一种模拟调节基准电路及其开关电源	实用新型	ZL201620306773.7	2016.04.13	晶丰明源	原始取得
51	一种线电压补偿过流保护点的电路、装置及开关电源系统	实用新型	ZL201620212924.2	2016.03.18	晶丰明源	原始取得
52	一种 LED 驱动系统	实用新型	ZL201620124621.5	2016.02.17	晶丰明源	原始取得
53	一种可控硅调光电路	实用新型	ZL201620062310.0	2016.01.22	晶丰明源	原始取得
54	一种直流无刷电机驱动系统	实用新型	ZL201620034865.4	2016.01.14	晶丰明源	原始取得
55	控制电路、LED 驱动芯片及 LED 恒流驱动控制电路	实用新型	ZL201521005427.7	2015.12.07	晶丰明源	原始取得
56	驱动芯片及 LED 恒流驱动控制电路	实用新型	ZL201521001947.0	2015.12.04	晶丰明源	原始取得
57	双路电压转换控制芯片、双路电压转换器和电子式电能表	实用新型	ZL201520965577.6	2015.11.27	晶丰明源	原始取得
58	自适应采样电路、印刷电路板、原边反馈恒压系统及开关电源系统	实用新型	ZL201520953354.8	2015.11.25	晶丰明源	原始取得
59	芯片的启动电路、LED 驱动器及 LED 驱动电路	实用新型	ZL201520858108.4	2015.10.30	晶丰明源	原始取得
60	总谐波失真优化电路	实用新型	ZL201520799051.5	2015.10.16	晶丰明源	原始取得
61	无刷直流电机的模拟闭环调速装置	实用新型	ZL201520787970.0	2015.10.12	晶丰明源	原始取得
62	无刷直流电机霍尔信号同步波形控制电路	实用新型	ZL201520734590.0	2015.09.22	晶丰明源	原始取得
63	无刷直流电机相位控制电路	实用新型	ZL201520736842.3	2015.09.22	晶丰明源	原始取得
64	一种无刷电机无位置传感器控制装置	实用新型	ZL201520588367.X	2015.08.06	晶丰明源	受让取得
65	软开关控制模块以及直流无刷电机驱动系统	实用新型	ZL201520301229.9	2015.05.11	晶丰明源	原始取得
66	时钟移相电路	实用新型	ZL201520234657.4	2015.04.20	晶丰明源	受让取得
67	驱动级电源选择电路	实用新型	ZL201520234659.3	2015.04.20	晶丰明源	受让取得
68	差分放大器	实用新型	ZL201520234732.7	2015.04.20	晶丰明源	受让取得
69	反激式开关电源同步整流电路	实用新型	ZL201520234733.1	2015.04.20	晶丰明源	受让取得

70	恒流启动转换器	实用新型	ZL201520234735.0	2015.04.20	晶丰明源	受让取得
71	升压型 LED 驱动电路	实用新型	ZL201520235554.X	2015.04.20	晶丰明源	受让取得
72	输入前馈 LED 驱动电路	实用新型	ZL201520236611.6	2015.04.20	晶丰明源	受让取得
73	一种直流无刷电机的驱动装置及其驱动系统	实用新型	ZL201520195913.3	2015.04.02	晶丰明源	受让取得
74	具备启动检测功能的发光二极管驱动电路	实用新型	ZL201420716180.9	2014.11.26	晶丰明源	受让取得
75	退磁检测控制模块以及退磁检测系统	实用新型	ZL201420464827.3	2014.08.18	晶丰明源	原始取得
76	供电模块、开关电源芯片以及开关电源系统	实用新型	ZL201420408221.8	2014.07.23	晶丰明源	原始取得
77	无刷电机相位超前角优化电路	实用新型	ZL201420359468.5	2014.06.30	晶丰明源	受让取得
78	电机转子位置信号的自适应处理装置	实用新型	ZL201420360896.X	2014.06.30	晶丰明源	受让取得
79	应用于环路检测的反馈检测电路	实用新型	ZL201320795934.X	2013.12.03	晶丰明源	受让取得
80	反激式隔离型开关电源	实用新型	ZL201320769075.7	2013.11.30	晶丰明源	受让取得
81	基于准谐振 LED 恒流开关电源的负载调整率补偿电路	实用新型	ZL201320769107.3	2013.11.30	晶丰明源	受让取得
82	AC-DC 原边转换 LED 控制电路	实用新型	ZL201320769132.1	2013.11.30	晶丰明源	受让取得
83	降压开关电源功率管过零检测电路	实用新型	ZL201320769133.6	2013.11.30	晶丰明源	受让取得
84	降压开关电源	实用新型	ZL201320769161.8	2013.11.30	晶丰明源	受让取得
85	一种用于 AC-DC 原边控制芯片中的供电电路	实用新型	ZL201320769162.2	2013.11.30	晶丰明源	受让取得
86	可变基准电压源	实用新型	ZL201320769163.7	2013.11.30	晶丰明源	受让取得
87	开关电源功率 NMOS 管电流过零和谐振波谷检测电路	实用新型	ZL201320769206.1	2013.11.30	晶丰明源	受让取得
88	原边控制的反激拓扑结构电路	实用新型	ZL201320760756.7	2013.11.28	晶丰明源	受让取得
89	基准电压积分采样电路	实用新型	ZL201320760821.6	2013.11.28	晶丰明源	受让取得
90	时间倍乘信号生成电路	实用新型	ZL201320760977.4	2013.11.28	晶丰明源	受让取得
91	一种基于三极管的 LED 电流纹波消除驱动电路	实用新型	ZL201320671015.1	2013.10.29	晶丰明源	原始取得
92	一种可控硅调光 LED 驱动电路	实用新型	ZL201320369790.1	2013.06.26	晶丰明源	原始取得

93	一种LED电流纹波消除驱动电路	实用新型	ZL201320317911.8	2013.06.04	晶丰明源	原始取得
94	一种LED驱动电源中的过压保护电路及LED驱动电源	实用新型	ZL201320204139.9	2013.04.22	晶丰明源	原始取得
95	一种电感电流全周期采样的LED驱动电路	实用新型	ZL201320105231.X	2013.03.08	晶丰明源	原始取得
96	一种内置线电压补偿电路的开关电源恒流控制电路	实用新型	ZL201320022351.3	2013.01.16	晶丰明源	原始取得
97	一种平均线性LED驱动电路	实用新型	ZL201220534167.2	2012.10.18	晶丰明源	原始取得
98	一种发光二极管驱动电源控制电路	实用新型	ZL201220449921.2	2012.09.06	晶丰明源	原始取得
99	无需辅助绕组的LED驱动电路	实用新型	ZL201220309174.2	2012.06.28	晶丰明源	原始取得
100	适用于可控硅调光器的LED线性驱动电路	实用新型	ZL201220152765.3	2012.04.12	晶丰明源	原始取得
101	一种LED线性电流控制电路及LED线性电路	实用新型	ZL201220024627.7	2012.01.19	晶丰明源	原始取得
102	一种LED线性恒流控制电路及LED线性电路	实用新型	ZL201120458571.1	2011.11.18	晶丰明源	原始取得
103	一种LED驱动电源快速启动装置	实用新型	ZL201120414032.8	2011.10.27	晶丰明源	原始取得
104	一种具有输入电压采样及补偿的LED恒流控制电路	实用新型	ZL201120334429.6	2011.09.07	晶丰明源	原始取得
105	一种兼容可控硅调光器调光的LED照明驱动电路	实用新型	ZL201020159328.5	2010.04.14	晶丰明源	原始取得
106	输出电压及电感量变化保持恒流的源级驱动LED驱动电路	实用新型	ZL200920273139.8	2009.11.27	晶丰明源	原始取得
107	改善峰值电流控制LED恒流驱动中电流精度的电路	实用新型	ZL200920073796.8	2009.04.17	晶丰明源	原始取得

## （2）境外发明专利

截至本招股说明书签署日，公司拥有境外发明专利2项。该等专利均为有效状态，公司已取得相关专利证书。具体情况如下：

序号	国际专利名称	专利号	申请日	申请人
1	Current Ripple Canceling LED Driver	US9107260B2	2013.09.27	晶丰明源
2	Triac Dimmable LED Driver Circuit	US9271347B2	2013.08.20	晶丰明源

## 2、商标权

### （1）境内商标

截至本招股说明书签署日，公司拥有的境内注册商标情况如下表所示：

序号	注册商标	注册证号	核定类别	权利人	注册时间	有效期至	发证机关
1		11409966	第9类	晶丰明源	2014.7.21	2024.7.20	国家商标局
2		11409967	第9类	晶丰明源	2014.4.28	2024.4.27	国家商标局
3	晶丰明源	11927207	第9类	晶丰明源	2014.6.7	2024.6.6	国家商标局
4	晶丰明源	20248418	第42类	晶丰明源	2017.7.28	2027.7.27	国家商标局

### （2）境外商标

截至本招股说明书签署日，公司拥有的境外注册商标情况如下表所示：

序号	注册商标	注册证号	核定类别	权利人	注册时间	有效期至	发证机关
1		303956419	第9、42类	晶丰明源	2016.11.8	2026.11.7	香港商标注册处
2	 晶丰明源 High Power Semiconductor	303956400	第9、42类	晶丰明源	2016.11.8	2026.11.7	香港商标注册处
3	BPSemi	303956428	第9、42类	晶丰明源	2016.11.8	2026.11.7	香港商标注册处

## 3、集成电路布图设计

截至本招股说明书签署日，公司已取得61项集成电路布图设计登记证书，具体情况如下：

编号	登记号	名称	权利人	申请日	首次投入商业利用日	取得方式
1	BS.10500873.7	BP3108	发行人	2010.12.01	2010.11.05	原始取得
2	BS.10500874.5	BP2808	发行人	2010.12.01	2009.05.01	原始取得
3	BS.12500582.2	BP3309/BP3308/BP2309/BP2308	发行人	2012.05.06	2011.10.28	原始取得
4	BS.12500583.0	BP3122	发行人	2012.05.06	2012.03.20	原始取得
5	BS.12500584.9	BP5108	发行人	2012.05.06	2011.12.21	原始取得
6	BS.12500585.7	BP2818/BP2822/BP2808B/BP2812	发行人	2012.05.06	2011.06.22	原始取得

7	BS.12501731.6	BP5118	发行人	2012.12.18	2012.08.13	原始取得
8	BS.12501732.4	BP2318/BP3318	发行人	2012.12.18	2012.12.01	原始取得
9	BS.135004063	BP2325/BP2326/BP2327/BP2329	发行人	2013.04.27	2013.04.15	原始取得
10	BS.135004071	BP2831/BP2832/BP2833/BP2836	发行人	2013.04.27	2013.04.06	原始取得
11	BS.13500408X	BP3131/BP3132/BP3133	发行人	2013.04.27	2013.04.06	原始取得
12	BS.135015499	BP3201/BP3206/BP3208	发行人	2013.09.04	2013.08.17	原始取得
13	BS.135016134	BP5122/BP5129	发行人	2013.12.26	2013.12.07	原始取得
14	BS.135016177	BP3211/BP3218	发行人	2013.12.26	2013.12.04	原始取得
15	BS.135016150	BP2836D/BP9833A/BP9833D	发行人	2013.12.26	2013.10.09	原始取得
16	BS.135016193	BP3135D/BP3136D	发行人	2013.12.26	2013.11.22	原始取得
17	BS.145007790	BP2851/2852/2853D/2857D	发行人	2014.08.21	2014.06.04	原始取得
18	BS.145007812	BP5901	发行人	2014.08.21	2014.07.07	原始取得
19	BS.145007782	BP3398	发行人	2014.08.21	2014.05.04	原始取得
20	BS.145007804	BP5136H	发行人	2014.08.21	2014.07.07	原始取得
21	BS.145007820	BP2333/BP2335/BP2338/BP2339	发行人	2014.08.21	2014.04.04	原始取得
22	BS.145007987	UR5402	发行人	2014.08.25	2014.07.20	受让取得
23	BS.145007995	UR4311	发行人	2014.08.25	2014.07.20	受让取得
24	BS.145008029	UR3311	发行人	2014.08.25	2014.07.20	受让取得
25	BS.145008002	UR4301	发行人	2014.08.25	2014.07.20	受让取得
26	BS.145008010	UR4205	发行人	2014.08.25	2014.07.20	受让取得
27	BS.155001264	BP3198	发行人	2015.01.28	2014.11.25	原始取得
28	BS.155001248	BP5609	发行人	2015.01.28	2014.09.08	原始取得
29	BS.155001272	BP9912	发行人	2015.01.28	2014.11.08	原始取得
30	BS.155001256	BP1808	发行人	2015.01.28	2015.01.01	原始取得

31	BS.155005170	BP9912C/BP9913C/BP9918C	发行人	2015.06.11	2015.03.22	原始取得
32	BS.155005146	BP2519/BP2515G/BP2516F	发行人	2015.06.11	2015.03.02	原始取得
33	BS.155005197	BP2831AJ/BP2832AJ/BP2865C/BP2865E	发行人	2015.06.11	2015.04.24	原始取得
34	BS.155005138	BP9112AT	发行人	2015.06.11	2015.05.26	原始取得
35	BS.15500512X	BP9112B	发行人	2015.06.11	2015.05.26	原始取得
36	BS.155005154	BP9912A/BP9913A/BP9918A	发行人	2015.06.11	2015.03.22	原始取得
37	BS.155005162	BP9912B/BP9913B/BP9918B	发行人	2015.06.11	2015.03.22	原始取得
38	BS.165512555	BP1808	发行人	2016.05.11	2015.09.24	原始取得
39	BS.165512571	BP2325A/BP2328D/BP9329A/BP2327A	发行人	2016.05.11	2015.06.03	原始取得
40	BS.16551258X	BP2325AJ/2327AJ/2328AJ/2329AJ/BP2325AK/2327AK/2328AK/2329AK/BP2328DK	发行人	2016.05.11	2015.12.30	原始取得
41	BS.165512598	BP2833K/BP2831A	发行人	2016.05.11	2015.07.07	原始取得
42	BS.165512563	BP2850	发行人	2016.05.11	2015.01.10	原始取得
43	BS.165512725	BP6108	发行人	2016.05.19	—	原始取得
44	BS.165512733	BP6118	发行人	2016.05.19	2016.01.08	原始取得
45	BS.165512741	BP6308/BP6309	发行人	2016.05.19	2015.10.22	原始取得
46	BS.165512989	BP3122A/BP3122C	发行人	2016.06.14	2014.09.23	原始取得
47	BS.165513004	BP3135	发行人	2016.06.14	2015.10.24	原始取得
48	BS.165513012	BP3228/BP3216/BP3212/BP3218/BP3221/BP3222/BP3211	发行人	2016.06.14	2015.08.02	原始取得
49	BS.165513020	ZQ007/ZQ012/BP3316	发行人	2016.06.14	2015.11.17	原始取得
50	BS.165514485	BP3527F/BP3517F/BP3526C	发行人	2016.07.22	2015.12.22	原始取得
51	BS.165514507	BP5131D/BP5131S/BP5132H	发行人	2016.07.22	2015.11.28	原始取得
52	BS.165514515	BP5131K	发行人	2016.07.22	2015.11.28	原始取得

53	BS.16551454X	BP9912A/BP9916A/BP9916B	发行人	2016.07.22	2015.09.27	原始取得
54	BS.165514558	BP9716B/BP9715B/BP9712B	发行人	2016.07.22	2016.01.05	原始取得
55	BS.165514566	BP9912E/BP9922E/BP9912F/BP9922F/BP9916F/BP9919E/BP9929E	发行人	2016.07.22	2015.8.19	原始取得
56	BS.165514574	BP9916C/BP9913C/BP2831KT	发行人	2016.07.22	2015.07.15	原始取得
57	BS.165514582	BP9916E/BP9926E/BP9927E	发行人	2016.07.22	2015.12.02	原始取得
58	BS.165514604	BP9918D/BP9928D/BP9912D/BP9913D/BP9916D/BP9922D/BP9929D/BP9927D/BP9926D	发行人	2016.07.22	2015.08.19	原始取得
59	BS.165514612	BP9918S/BP9728A/BP9913A	发行人	2016.07.22	2015.07.20	原始取得
60	BS.165514620	BP9919F/BP9929F/BP9926F/BP9926G/BP9927G/BP9927F	发行人	2016.07.22	2015.08.19	原始取得
61	BS.165514639	UR6202	发行人	2016.07.22	2015.08.03	受让取得

### （三）发行人获得的部分荣誉和资质

截至本招股说明书签署日，公司获得的部分荣誉和资质情况如下表所示：

序号	证书名称	证书编号/注册编码	颁发时间	颁发机构
1	2016年度上海市集成电路设计业销售前十名	-	2017.04	上海市集成电路行业协会
2	上海科技企业创新奖	-	2016.09	上海市科技企业联合会
	2014-2016年度浦东新区集成电路设计业亮点企业（成长性）	-	2016.09	上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心
3	质量管理体系认证证书	00116Q34018R2M/3100	2016.05	中国质量认证中心
4	2016中国LED首创奖	-	2016.04	中国照明学会、半导体照明技术应用专业委员会
5	高新技术企业	GF201531000545	2015.10	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国税局、上海市地税局
6	上海市专利工作试点企业	2015B企83	2015.06	上海市知识产权局
7	上海市科技小巨人企业	-	2015	上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会

## （四）发行人产品获得的主要荣誉

### 1、上海市高新技术成果转化项目

序号	项目名称	项目编号	颁发机构	颁发日期	有效期
1	LED 恒流 IC (BP2808/BP1361)	201008374	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	2010.08	2015.08
2	调光 LED 驱动 IC (BP3105/BP3108)	201105208	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	2011.06	2016.06
3	高效率非隔离 LED 驱动芯片 (BP2812/BP2808B/BP2822)	201301077	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	2013.01	2018.01
4	高功率因数 LED 驱动芯片 (BP3309/BP2309)	201301078	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	2013.01	2018.01
5	高压线性恒流 LED 驱动芯片	201302157	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	2013.03	2018.03
6	智能温控 LED 驱动芯片	201305311	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	2013.07	2018.07
7	高性能有源功率因数校正驱动芯片	201412632	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	2015.01	2020.01
8	可控硅调光发光二极管驱动芯片	201412631	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	2015.01	2020.01

### 2、其他产品奖项

序号	奖励名称	项目名称	项目编号	颁发机构	颁发日期
1	创新基金证书	LED照明驱动电路恒流控制芯片	12C0417	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心	2010.08
2	第十一届（2016年度）中国半导体创新产品和技术	可控硅调光发光二极管驱动芯片	-	中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社	2017.03
3	四川省科学技术进步奖	功率高压 MOS 器件关键技术与应用	2016-J-1-09-D04	四川省人民政府	2017.04

## 七、主要技术及研发情况

### （一）主要产品的技术水平及所处阶段

目前公司技术水平先进、工艺节点成熟，并拥有多项专利和专有技术，多项



核心技术处于国际或国内先进水平。公司现阶段所掌握的主要核心技术如下：

序号	核心技术名称	用途	来源	技术水平
1	LED 恒流的源极驱动技术	LED 恒流的源极驱动技术通过检测电感电流，当电感电流过零时，开关管导通；且当电流采样电阻两端的电压大于等于参考电压时，开关管关闭。该技术使得 LED 输出电流不受电感量和输出电压的影响，提高了 LED 驱动系统稳定性，降低了电路的复杂性及成本。	自主研发	国际先进
2	LED 驱动的过温调节技术	LED 驱动的过温调节技术通过检测 LED 驱动电源温度，当 LED 驱动电源的温度升高到一设定值时，过热调节电路降低变压器或电感的电流，使 LED 驱动电源的输出功率减小，使系统温度得到控制。该技术可以使得系统温度得到控制，以消除 LED 灯交替性点亮与熄灭的状况。	自主研发	国际先进
3	LED 驱动芯片的供电技术	LED 驱动芯片的供电技术通过供电模块实现在快速启动同时给芯片电源供电，所述供电模块的所有元器件适合集成在开关电源芯片内部，减少了外围元器件，利于开关电源系统的小型化以及简单化。	自主研发	国际先进
4	LED 电流纹波消除技术	LED 电流纹波消除技术通过比较该采样电阻上的电压信号和一动态基准电压信号，控制开关管使 LED 负载上的电压为一近似无纹波的直流电压，LED 负载电流为一近似无纹波的直流电流，达到 LED 电流纹波消除的目的。	自主研发	国际先进
5	700V 高压集成工艺	700V 高压集成工艺是一个包括低压，中压，高压到超高压的元器件的工艺集成，在中压、高压、超高压的元器件主要包括 MOS 晶体管，LDMOS 晶体管，JFET 晶体管以及 LDMOS+JFET 的复合管。工艺技术可以降低芯片生产的成本、提高芯片的性能。	自主研发	国内先进
6	可控硅调光技术	可控硅调光技术通过泄放控制模块，智能的控制泄放开关 MOS 晶体管上的电流，使 LED 驱动电路的输入电流满足可控硅调光器维持电流的需求，实现了简单有效且兼容性良好的可控硅调光 LED 驱动电路。	自主研发	国内先进
7	LED 可调色温技术	LED 可调色温技术通过采样单元采样供电信号或输出电压信号，通过可调色温模块控制不同色温的 LED 灯的导通与关闭，达到色温选择的目的，使 LED 灯通过普通墙壁开关的控制，可以实现多种色温的选择。	自主研发	国内先进
8	LED 驱动电源中的	LED 驱动电源中的过压保护技术通过比较退磁	自主研发	国内

	过压保护技术	时间和退磁基准时间, 当该退磁时间小于等于该退磁基准时间时, 关断该 LED 驱动电源的功率开关管。采用该技术的 LED 驱动电源体积小, 可以降低成本。		先进
--	--------	---	--	----

## （二）核心技术保护措施

公司的核心技术保护工作贯穿于产品定义、产品研发、产品生产、产品测试、产品上市的整个过程, 核心技术的保护主要包括如下措施: 采取专利申请保护与专有技术相结合的方式, 做好核心技术的知识产权保护; 与供应商、客户签署保密协议, 确保公司的保密信息处于保密状态; 与核心技术人员签署保密协议和竞业禁止协议, 确保公司的保密信息处于保密状态; 制定《商业秘密管理办法》规范企业的商业秘密管理、使用, 员工在公司服务器上进行产品设计、产品研发, 将核心技术加密存放在公司服务器, 根据人员的性质设定读、写、修改权限。通过申请布图设计登记对公司的产品布图信息进行保护。

## （三）研究开发情况

### 1、正在从事的研发项目情况

截至 2017 年 3 月 31 日, 公司正在从事的主要研发项目如下:

序号	项目名称	简介	进展情况
1	开关调光兼容无极调光 LED 驱动	开关调光兼容无极调光 LED 驱动是一款高精度降压型的 LED 恒流驱动控制芯片, 集成电流采样电路及 700V 功率开关, 采用新型退磁检测技术和高压供电技术, 无需辅助绕组的检测和供电。具有优异的线电压调整率及负载调整率、外围器件精简, 系统成本和体积优化等优势。	研发阶段
2	高性能集成 JFET 启动可控硅调光 LED 驱动	高性能集成 JFET 启动可控硅调光 LED 驱动是一款高效率可控硅调光 LED 驱动芯片, 集成 JFET 启动的高压供电技术, 输入线电压补偿, 使用单电阻设置开路电压及最大导通时间等技术。具有调光深度优, 降低小导通角供电不足导致闪烁的风险, 提高光通量系统设计灵活, 芯片外围成本低等优势。	研发阶段
3	高精度 OTP 线性恒流 LED 驱动	高精度 OTP 线性恒流 LED 驱动是一款高精度温度控制线性恒流 LED 驱动芯片, 集成了高压整流管和高压供电模块、工作在线性模式,	研发阶段

		可实现当输入电压过高导致芯片温度升高时准确检测芯片温度，降低输出电流，实现保护芯片、驱灯和驱动系统等功能。具有散热低、体积小、寿命长、降低灯珠成本等优势。	
4	600V 高压半桥栅驱动器	600V 高压半桥栅驱动器是一款高电压高速功率 MOSFET 和 IGBT 半桥驱动芯片，上通道和下通道独立输入，内置死区时间防止直通。上下两个通道均有欠压保护功能。具有芯片成本低，耐负压能力强，可靠性高等优势。	研发阶段
5	0-10V 智能调光 LED 控制芯片	0-10V 智能调光 LED 控制芯片是一款调光接口转换芯片，能够将调光器输出的 0-10V 电压信号、以及外接电阻阻值产生的电压信号转换为 PWM 信号并用于控制后级 LED 驱动芯片，实现 0-10V 智能调光，调节 LED 输出电流。具有多种 0-10V 调光器兼容性等优势。	研发阶段
6	高集成度开关调色温 LED 驱动芯片	高集成度开关调色温 LED 驱动芯片是开关调色温的专用芯片，通过内置高压功率管检测墙壁开关状态，实现冷、暖、混色三种开关状态切换。具有简化外围原件、电源设计便利性等优势。	研发阶段
7	调光 LED 纹波电流消除芯片	调光 LED 纹波电流消除芯片是一款高度集成、适合调光应用的去纹波驱动器，通过驱动内置 MOSFET，滤除前级 LED 驱动器的低频纹波，能够实现效率损失和去纹波效果的平衡。具有良好的动态特性，支持快速调光，还具有短路、开路保护、热保护等功能。	研发阶段
8	两级大功率智能调光 LED 驱动芯片	两级大功率智能调光 LED 驱动芯片是一款单芯片上实现高功率因数和非隔离或者隔离恒流组合控制的芯片，在全电压范围内实现恒流输出，采用独有的退磁检测以及先进的恒流算法，集成调光接口，调光深度低至5%且低端可关断。具有储能元件设计和系统成本优化，优异的线性调整率和负载调整率，实现无频闪照明，具有调光功能等优势。	研发阶段
9	APFC 升压高效率 LED 驱动芯片	APFC 升压高效率 LED 驱动芯片是一款高功率因数的 LED 恒流驱动 IC，带有单级功率因数校正功能，采用临界连续模式，独有的单绕组 Boost 电感实现谷底检测，采用源极驱动的方式。具有应用功率等级高、外置功率开关损耗小，外围元器件和设计成本低、系统高效等优势。	测试验证阶段
10	线性可控硅调光 LED 驱动芯片	线性可控硅调光 LED 驱动芯片是一款实现高功率因数兼容可控硅调光器的单段线性恒流芯片，集成了输出去频闪线路，集成主动 Bleeder	研发阶段

		线路和可控硅调光器检测电路。该芯片具有高效率，无音频噪声的优势。而且生产简单，成本低，性能可靠。	
11	700V 高压集成工艺	700V 高压集成工艺是一个包括低压，中压，高压到超高压的元器件的工艺集成，电压范围涵盖7.5V 到700V。在中压、高压、超高压的元器件主要包括 MOS 晶体管，LDMOS 晶体管，JFET 晶体管以及 LDMOS+JFET 的复合管。低压下开发的元器件，除 MOS 晶体管外还包括三极管，电阻，电容。具有降低芯片生产的成本、提高芯片的性能等优势。	研发/生产阶段

## 2、研发费用占比

报告期内，公司研发费用占营业收入比例如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年	合计
研发费用	1,022.86	4,571.88	2,887.78	2,373.63	10,856.15
营业收入	15,309.16	57,088.11	35,712.04	33,727.01	141,836.32
占比	6.68%	8.01%	8.09%	7.04%	7.65%

## 3、研发机构设置

公司研究机构目前包括设计部、工艺开发部，各研究机构具体职责如下：

部门	职能内容
设计部	负责协助参与新产品定义和系统结构设计、仿真，进行可行性分析，提供产品成本分析；组建产品设计团队，制定从产品开始设计到客户送样的开发进度表，并负责保证产品开发能按时达到各项目阶段，最终确保产品能按时送样并投产；提供封装示意图和老化原理图；监督产品开发过程，确保产品开发按照公司产品开发流程进行；完成从电路图到版图的研发工作，提高电路性能；提供标准格式的中测、成测规范；提供详细的系统应用测试计划；根据测试评估结果，决定产品是否可以送样或需改版；如需改版则需制定改版方案和时间表；产品转为批量生产后，需完成项目开发总结供后续参考
工艺开发部	负责建立工艺模拟平台开发新工艺，在晶圆制造厂建立工艺流程，完成流片并提取模型，获取自主工艺产能；根据市场需求，确定关键器件及要求，提出新结构、新工艺，以达到优化质量与成本的效果

## 4、主要研发人员情况

公司拥有一支结构合理、业务素质高的技术队伍。公司研发人员专业技术涵

盖 LED 驱动电源系统设计、芯片设计、芯片封装技术开发、芯片制造工艺开发、芯片应用开发、芯片测试、芯片可靠性验证等技术领域，具有较强的研发能力。核心技术人员具体情况详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“（四）核心技术人员”。

#### （四）公司保持技术创新的机制和能力

公司主要采取以下措施来促进技术创新：（1）公司建立以客户需求为基础的研究开发理念，满足多样化的客户需求。公司业务部门对国内外市场进行广泛的调研，深入了解行业动向及客户需求状况形成调研意见，公司研发部及产品部根据业务部门的调研意见制定立项报告并完成产品的研发。（2）公司在持续加大引进人才力度的同时，不断强化对公司现有技术人员的培养，有计划、有步骤地开展岗位技术培训，提高技术人员的研发水平。（3）公司对研发机构进行不断地建设与完善，持续优化资源配置，制定有效的研发运行及管理机制。公司在项目管理中设立项目产品开发责任制，制定和完善科技创新绩效考核办法，从人员、制度上保证创新工作的开展。

### 八、主要产品的质量控制情况

#### （一）质量控制体系

公司遵循“不断创新、卓越品质、一流服务”的质量管理方针，自成立以来即高度重视质量管理工作，通过制定严格的质量管理标准、科学的产品质量管理度。公司质量管理体系覆盖范围包括集成电路的研发与服务，建立形成了质量管理体系并坚持持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性，并通过了 ISO9001 管理体系认证。

#### （二）质量控制标准

公司结合自身产品特点和实际管理需要，由管理者代表组织编制了公司的《质量手册》。手册阐明了公司的质量方针等目标，描述了公司的质量管理体系，并对公司所有质量管理体系的过程顺序和相互作用做了明确的规定，同时手册规

定公司的全体员工必须认真学习、严格贯彻执行，以达到持续改进、提高公司业绩、对外实现使顾客满意的目的。

### （三）质量管理措施

公司结合行业和企业自身特点，由运营、行政、研发、销售、市场等部门联合制定了质量管理全套规范文件，分为4个层次共200多个包括手册、程序、规范管理制度及各项活动实时记录文件等，对本公司产品设计、产品流转、市场管理以及运营管理的全过程实行全面有效的控制，努力提高公司设计质量、产品质量。公司同时高度关注客户反馈，定期跟踪、动态反馈客户提出的问题和建议，从而达到持续改进质量的目的。

公司设立了设计部及下属系统应用部、运营部及下属质量部、测试部、工程部等部门，从机构、人员、流程、操作规范上保证研发质量管理、外包生产质量管理、内部质量控制等方面有序进行，最终使得产品定义、方案确定、项目立项、芯片设计、委外代工、流片及测试、最终量产、售后服务全部过程得到有效控制并不断改进，从而保证了公司产品的质量。

### （四）质量纠纷情况

报告期内，公司未发生重大产品质量纠纷。

## 第七节 同业竞争与关联交易

### 一、发行人在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性情况

公司设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与公司股东完全分开，具有独立完整的资产和业务及面向市场自主开发经营的能力，具备独立的供应、生产和销售系统。具体情况如下：

#### （一）资产独立

公司是由晶丰有限整体变更而来，依法承继了原有限公司的所有资产及业务。整体变更后，股份公司依法办理了相关资产的产权变更登记手续，具有开展生产经营所必备的独立、完整的资产。报告期内，公司资产权属清晰、完整，不存在对实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况。

#### （二）人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司的董事、监事及高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情形。

公司建立了独立的人事档案制度，建立了人事聘用、任免与考核奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障制度。

#### （三）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况建立了独立、完整的财务核算体系，制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

#### （四）机构独立

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，拥有独立的经营和办公场所，各机构、部门在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，与实际控制人控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东干预公司机构设置和运行的情况。

#### （五）业务独立

公司主要从事模拟和混合信号集成电路的研发与销售。公司拥有从事上述业务完整、独立的采购、研发、生产、销售体系，不存在对股东和其他关联方的依赖，具备独立面向市场、独立承担责任和风险的能力。公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业，与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

综上所述，公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与股东及其关联方相互独立，拥有独立完整的业务体系，具有面向市场的独立经营能力。

保荐机构认为：公司已按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司上述内容真实、准确、完整，公司已达到发行监管对公司独立性的基本要求。

## 二、同业竞争情况

（一）公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争



公司实际控制人胡黎强、刘洁茜未从事任何与公司相同、相似的业务或活动，与公司之间不存在同业竞争。公司实际控制人除直接和间接持有晶丰明源48.89%股权并在公司任职外，未从事任何与公司相同、相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。

## （二）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司实际控制人胡黎强、刘洁茜向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。相关情况参见“第五节 发行人基本情况”之“十一、发行人及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的主要股东以及证券服务机构作出的重要承诺及其约束措施和履行情况”之“（二）实际控制人关于避免同业竞争的承诺”。

## 三、关联交易情况

### （一）关联方与关联关系

#### 1、公司目前的关联方

##### （1）实际控制人

序号	关联方	关联关系	备注
1	胡黎强	实际控制人之一、董事长、总经理	直接持有公司 35.85%股份， 间接持有公司 0.41%股份
2	刘洁茜	实际控制人之一、董事、副总经理	间接持有公司 12.63%股份

##### （2）控股子公司与参股公司

序号	关联方	关联关系	备注
1	晶丰香港	控股子公司	公司持有 100.00%股权
2	上海汉枫	参股公司	公司持有 13.06%股权

##### （3）其他关联方

序号	关联方	关联关系	备注
1	夏风	持有公司 5%以上股份的主要股东	直接持有公司 32.72%股份， 间接持有公司 0.04%股份，董事
2	上海晶哲瑞	持有公司 5%以上股份的主	持有公司 28.83%股份、胡黎强

		要股东、实际控制人控制的其他企业	持有该企业 1% 出资比例，并担任执行事务合伙人
3	宁波沪蓉杭	实际控制人控制的其他企业	胡黎强持有该企业 1.28% 出资比例，并担任执行事务合伙人
4	苏仁宏	其他关键管理人员	董事
5	冯震远		独立董事
6	孙文秋		独立董事
7	应俊		独立董事
8	张宜		监事会主席
9	周占荣		监事
10	李宁		监事
11	孙顺根		副总经理
12	汪星辰		财务负责人、董事会秘书

除上述关联方外，公司关联方还包括公司董事、监事、高级管理人员控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的企业，公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的自然人股东关系密切的家庭成员，以及公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的自然人股东或该等人员关系密切的家庭成员控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业。

## 2、近三年历史关联方

序号	名称	曾经存在的关联关系	备注
1	上海兴工微	参股公司	2016 年 2 月 24 日，公司转让其持有的该公司全部股权
2	苏州浩瀚		2017 年 3 月 30 日，公司转让其持有的该公司全部股权
3	上海巨微		2017 年 4 月 23 日，公司转让其持有的该公司全部股权
4	付利军	持有公司 5% 以上股份的主要股东、董事	2015 年 8 月 9 日，付利军转让其持有的公司股权，不再担任公司董事
5	郑蓓	关键管理人员	2015 年 6 月，郑蓓辞去财务负责人职务
6	赵立新		2016 年 12 月，赵立新辞去监事职务

## （二）报告期内的关联交易

## 1、经常性关联交易

### （1）销售商品

报告期内，公司与关联方发生的销售商品情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2017年1-3月		2016年度		2015年度		2014年度	
		金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
上海巨微	销售商品	-	-	-	-	10.42	0.0292%	-	-
上海汉枫	销售商品	-	-	-	-	1.22	0.0034%	-	-

2015年，上海巨微以市场价格向公司采购少量晶圆用于研发。2015年，上海汉枫以市场价格向公司采购少量LED照明驱动芯片产品用于物联网集成系统研发。报告期内，公司与上海汉枫及上海巨微发生的交易金额较小，该等交易对发行人利润及经营业绩影响较小。

### （2）关键管理人员薪酬

报告期内，公司关键管理人员的薪酬情况如下：

单位：万元

项目名称	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
关键管理人员薪酬	107.59	230.21	202.11	70.24

## 2、偶发性关联交易

### （1）关联担保

报告期内，公司的关联担保情况具体如下：

单位：万元

序号	担保合同编号	签订日期	担保方式	担保方	被担保方	主债权人	担保金额	担保事项	是否履行完毕
1	ZB971620130000021	2013.11.19	最高额保证	胡黎强、刘洁茜	晶丰有限	上海浦东发展银行股份有限公司张江支行	4,300.00	晶丰有限与主债权人在2013年11月19日至2016年11月18日期间内发生的在担保最高本金限额下的所有债权	是
	ZB971620130000021之补充/变更合同	2014.5.21							

2	ZD971620140000010	2014.12.15	最高额抵押	胡黎强、刘洁茜	晶丰有限	上海浦东发展银行股份有限公司张江支行	2,780.00	晶丰有限与主债权人在2014年12月15日至2017年12月14日期间内发生的在担保最高本金限额下的所有债权	否
3	ZB971620160000027	2016.12.9	最高额保证	胡黎强、刘洁茜	晶丰有限	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	5,000.00	晶丰有限与主债权人在2016年12月9日至2019年12月9日期间内发生的在保证最高本金限额下的所有债权	否

## （2）关联方应收应付款项

报告期各期末，公司与关联方的其他应收应付款余额情况如下表：

单位：万元

项目	关联方名称	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
其他应收款项	刘洁茜	-	-	-	1,700.00
	胡黎强	-	-	2,247.48	1,165.10
	夏风	-	-	2,058.12	1,067.50
	上海晶哲瑞	-	-	1,545.11	847.62
	付利军	-	-	-	146.40
	谢森 <sup>注</sup>	-	-	-	100.00
	孙顺根	-	-	-	19.50
	汪星辰	3.90	0.50	-	-
其他应付款	胡黎强	696.00	696.00	-	0.80
	夏风	232.00	232.00	-	-

注：谢森系发行人参股公司上海汉枫的实际控制人，因此，其与公司资金往来参照关联交易披露。

报告期各期末，公司与关联方向其他应收款项余额主要为公司与关联方向资金往来余额，公司与关联方向资金往来情况详见本节之“三、关联交易情况”之“（二）报告期内的关联交易”之“1、经常性关联交易”之“（4）关联方资金往来”。其他应付款余额系公司对持有上海湖杉20%的出资份额转让给关联方，因报告期末转让尚未完成，将关联方支付的股权转让款列入“其他应付款”科目核算。

## （3）向关联方转让所持上海湖杉股权

2016 年末，公司为集中力量发展核心业务，对发展战略及对外投资进行了调整，将所持上海湖杉股权转让给胡黎强、夏风，具体情况如下：

2016 年 12 月 13 日，公司与胡黎强签署《财产转让协议》，约定公司将其持有的上海湖杉 12% 的出资份额（对应出资额 600 万）以 696 万元的价格予以转让；2016 年 12 月 15 日，公司与夏风签署《财产转让协议》，约定公司将其持有的上海湖杉 4% 的出资份额（对应出资额 200 万）以 232 万元的价格予以转让。转让具体情况如下：

受让方	受让出资额（万元）	受让价款（万元）
胡黎强	600.00	696.00
夏风	200.00	232.00

因上海湖杉成立时间较短且尚未实现盈利，本次转让价格系以公司投资上海湖杉时的定价为基础协商确定。公司已于 2016 年 12 月收到上述转让价款。

#### （4）关联方资金往来

##### 1、股东/实际控制人资金拆借情况

报告期内，公司存在股东/实际控制人向公司资金拆借的情形，截至 2016 年 12 月 31 日，上述股东/实际控制人占用公司资金已全部偿还。该等资金拆借具体情况如下：

##### ① 公司股东/实际控制人向公司同比例资金拆借

报告期内，公司业务规模发展较快，对流动资金的需求存在一定的不可预测性，为保障公司业务扩张所需的资金，避免分红后公司流动资金不足，同时兼顾公司股东个人资金需求，经公司各股东一致同意，在当年未进行分红且公司流动资金充裕的情况下，按照基准日股东持股比例，由公司向股东提供无偿借款。按照上述约定，公司在报告期内共 6 次向股东按基准日持股比例提供了无息借款，具体情况如下：

单位：万元

序号	借款时间及基准日	借款人	基准日持股比例	借款金额	还款时间
1	2013 年 5 月	胡黎强	38.20%	382.00	2014.4.21

	(以 2012.12.31 为基准日)	夏风	35.00%	350.00	2014.4.21
		上海晶哲瑞	22.00%	220.00	2014.4.21
		付利军	4.80%	48.00	2014.4.21
		合计	100.00%	1,000.00	-
2	2013 月 6 日 (以 2012.12.31 为基准日)	胡黎强	38.20%	248.30	2015.6.30
		夏风	35.00%	227.50	2015.6.29
		上海晶哲瑞	22.00%	143.00	2015.6.30
		付利军	4.80%	31.20	2015.6.26
		合计	100.00%	650.00	-
3	2014 月 4 日 (以 2013.12.31 为基准日)	胡黎强	36.29%	916.80	2016.4.27
		夏风	33.25%	840.00	2016.4.27
		上海晶哲瑞	25.90%	654.32	2016.4.27
		付利军	4.56%	115.20	2015.6.30
		合计	100.00%	2,526.32	-
4	2015 月 2 日 (以 2014.12.31 为基准日)	胡黎强	36.29%	916.80	2016.4.27
		夏风	33.25%	840.00	2016.4.27
		上海晶哲瑞	25.90%	654.32	2016.4.27
		付利军	4.56%	115.20	2015.6.30
		合计	100.00%	2,526.32	-
5	2015 月 6 日 (以 2015 年 8 月 9 日为基准日 <sup>注</sup> )	胡黎强	36.81%	293.64	2016.4.27
		夏风	33.59%	267.95	2016.4.27
		上海晶哲瑞	29.60%	236.18	2016.4.27
		合计	100.00%	797.77	-
6	2016 月 3 日 (以 2015.12.31 为基准日)	胡黎强	36.81%	195.80	2016.11.30
		夏风	33.59%	178.67	2016.11.30
		上海晶哲瑞	29.60%	157.40	2016.11.30
		合计	100.00%	531.87	-

注：2015 年 6 月 20 日，公司股东会通过决议，同意付利军所持股份转让给胡黎强和夏风。本次股东等比例借款按照付利军股权转让后公司股权比例计算并实施。

## ②公司股东、实际控制人因个人资金需求向公司进行资金拆借

除上述等比例借款部分外，报告期内，公司股东胡黎强、夏风、上海晶哲瑞及实际控制人刘洁茜因个人对外投资、临时资金周转等资金需要，与公司间发生了资金拆借行为，日均借款余额如下表所示：

单位：万元

关联方	期间	日均余额	同期银行基准利率	资金占用补偿
胡黎强	2014 年度	2,363.21	5.60%	132.34
	2015 年度	745.76	4.85%~5.6%	38.52
	2016 年度	526.49	4.35%	22.90
夏风	2014 年度	-	-	-
	2015 年度	54.93	4.85%~5.6%	2.66
	2016 年度	35.31	4.35%	1.54
上海晶哲瑞	2014 年度	41.20	5.60%	2.31
	2015 年度	25.09	4.85%~5.6%	1.34
	2016 年度	0.49	4.35%	0.02
刘洁茜	2014 年度	2,644.11	5.60%	148.07
	2015 年度	846.58	4.85%~5.6%	42.30
	2016 年度	380.00	4.35%	16.53

截至 2016 年 12 月 31 日，上述股东/实际控制人占用公司资金已全部偿还。

股东/实际控制人资金拆借行为中，借款人均未向公司支付资金占用费。根据公司 2017 年 9 月 15 日 2017 年第三次临时股东大会决议：上述资金拆借行为中股东等比例资金拆借行为系过往全体股东的共同决定，为无息借款，不再向资金拆入方收取资金占用费。非按照股东持股比例的资金拆借部分，参照借款期间中国人民银行发布的一年期贷款利率，按照实际拆出资金金额及占用天数计算，由资金拆入方向公司支付相应的利息补偿。经核算，胡黎强、夏风、上海晶哲瑞和刘洁茜分别应向公司补偿资金占用费 193.77 万元、4.20 万元、3.66 万元和 206.90 万元。截至本招股书签署之日，胡黎强、夏风、上海晶哲瑞和刘洁茜已向公司足额支付了资金占用补偿款。

## 2、其他关联方资金拆借情况

关联方	借款日期	借款金额 (万元)	还款日期	还款金额 (万元)	期限及利息约定	备注
上海汉枫	2014.6.13	100.00	2014.8.27	100.00	不超过 4 个月，免息	-
谢森	2014.5.22	300.00	2014.12.31	200.00	不超过 1 年，免息	系谢森将所持汉枫电子股权转让给公司的条件之一
			2015.3.20	100.00		
上海兴工微	2015.5.20	60.00	2015.5.25	60.00	5 天，免息	-

上海巨微	2016.8.19	150.00	2016.11.25	150.00	1 年期，年利率 12%	-
------	-----------	--------	------------	--------	--------------	---

#### ①公司向谢森及上海汉枫提供借款

2014 年 5 月，公司与上海汉枫签署《投资框架协议》，计划通过受让股权及增资方式投资上海汉枫。作为吸收公司成为上海汉枫股东的条件，双方在《投资框架协议》中约定，由公司借给谢森 300 万元，用于上海汉枫原股东完成股权整合。同时，公司向上海汉枫提供 100 万元无息借款，借款期限 3 个月，用于解决上海汉枫资金周转问题。

根据上述约定，公司分别于 2014 年 5 月向谢森拆出资金 300 万元，于 2014 年 6 月向上海汉枫拆出资金 100 万元。2014 年 8 月，上海汉枫偿还了向公司的借款 100 万元。2014 年 12 月及 2015 年 3 月，谢森分两次偿还了向公司的借款 300 万元。

#### ②公司向上海兴工微、上海巨微提供借款

2015 年 5 月，由于流动资金需求，公司参股公司上海兴工微向公司借款 60 万元，并于 2015 年 5 月 25 日足额偿还。由于该笔借款金额较小，借款期限较短，公司未向上海兴工微收取资金占用费。

2016 年 8 月，由于流动资金需求，公司参股公司上海巨微向公司借款 150 万元，双方签署了借款协议，约定借款期限为一年，年利率 12%。2016 年 11 月，上海巨微向公司提前还款 150 万元并支付实际资金占用期间利息 4.83 万元。

### 3、关联方资金拆借所履行的程序

报告期内，发行人与关联方之间资金拆借行为均已履行了其时必要的审议批准程序。2017 年 9 月 15 日，公司 2017 年第三次临时股东大会对上述关联方资金拆借事项进行了审议，全体股东就上述事项进行了补充确认，并明确了应当由借款方补偿资金占用费的范围及金额。

发行人独立董事对报告期内的关联方资金占用情况发表意见如下：“关联方已经及时、足额向公司归还了所占用相关资金，公司目前已不存在关联方占用公司资金的情况，且公司已经通过制定《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的方式针对关联交易建立了完善的决策程序。”



公司实际控制人胡黎强、刘洁茜出具了声明与承诺，如因上述历史资金占用问题导致公司利益受损，胡黎强、刘洁茜自愿就公司因此发生和遭受的一切费用和损失承担连带赔偿责任。

### （三）关联交易的制度安排

公司在《公司章程》、《关联交易管理办法》中对有关关联交易的决策权力和程序做出了严格规定，股东大会、董事会表决关联交易事项时，关联股东、关联董事对关联交易应执行回避制度，以保证关联交易决策的公允性。

#### 1、《公司章程》的有关规定

“第三十六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元人民币。

第七十条 董事个人或者所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

第七十一条 董事会在审议表决有关联关系的事项时，董事长或会议主持人应明确向出席会议的董事告知该事项为有关联关系的事项，有关联关系的董事应

予回避。在有关联关系的董事向董事会披露其有关联的具体情况后，该董事应暂离会议场所，不得参与该关联事项的投票表决，董事会会议记录应予记载。

未出席董事会会议的有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代为表决。”

## 2、《关联交易管理办法》的有关规定

“第十四条 公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：

（一）任何个人只能代表一方签署协议；

（二）关联方不得以任何方式干预公司的决定；

（三）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

1、交易对方；

2、在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方能直接或间接控制的法人单位任职的；

3、拥有交易对方的直接或间接控制权的；

4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条第四项的规定为准）；

5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条第四项的规定为准）；

6、中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

（四）股东大会审议关联交易事项时，具有下列情形之一的股东应当回避表决：

1、交易对方；

2、拥有交易对方直接或间接控制权的；

- 3、被交易对方直接或间接控制的；
- 4、与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
- 5、在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或者间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；
- 6、因与交易对方或者其关联方存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；
- 7、中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

第十五条 董事会下设的审计委员会或关联交易控制委员会履行上市公司关联交易控制和日常管理的职责。

公司拟与关联人发生重大关联交易的，应取得独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

公司审计委员会或关联交易控制委员会应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委员会或关联交易控制委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

第十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

第十七条 公司与关联自然人发生的金额在 30 万元以上的关联交易由董事会批准。

第十八条 公司与关联法人发生的金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易由董事会批准。

第十九条 公司与关联方发生的金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，或与关联自然人的交易金额在 300 万元以上的关联交易，由公司股东大会批准。

第二十条 独立董事对公司拟与关联方达成的金额在 300 万元以上，或占公司最近经审计净资产绝对值的 5% 以上的关联交易发表单独意见。

第二十一条 需股东大会批准的公司与关联法人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。

公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

第二十二条 非由董事会或股东大会批准范围内的关联交易事项由总经理批准。

第二十三条 监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

第二十四条 董事会对关联交易事项作出决议时，至少需审核下列文件：

- （一）关联交易发生的背景说明；
- （二）关联方的主体资格证明（法人营业执照或自然人身份证明）；
- （三）与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排；
- （四）关联交易定价的依据性文件、材料；
- （五）关联交易对公司和非关联股东合法权益的影响说明；
- （六）中介机构报告（如有）；
- （七）董事会要求的其他材料。

第二十五条 股东大会对关联交易事项作出决议时，除审核第二十四条所列文件外，还需审核下列文件：

- （一）独立董事就该等交易发表的意见；
- （二）公司监事会就该等交易所作决议。

第二十六条 股东大会、董事会、董事长依据《公司章程》和议事规则的规定，在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决，并遵守有关回避制度的规定。

第二十七条 需董事会或股东大会批准的关联交易原则上应获得董事会或股东大会的事前批准。如因特殊原因，关联交易未能获得董事会或股东大会事前批准既已开始执行，公司应在获知有关事实之日起六十日内履行批准程序，对该等关联交易予以确认。

第二十八条 关联交易未按《公司章程》和本制度规定的程序获得批准或确认的，不得执行；已经执行但未获批准或确认的关联交易，公司有权终止。

第二十九条 公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。”

#### **（四）公司报告期关联交易的执行情况**

公司分别召开董事会、监事会和股东大会，对公司报告期内的关联交易事项予以确认。独立董事对关联交易履行审议程序的合法性及交易价格的公允性发表了意见。独立董事认为：公司近三年的关联交易均按市场原则进行，定价合理公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司已建立了必要的关联交易管理制度，设置了合法合规的关联交易的批准程序。

#### **（五）公司减少关联交易的措施**

公司依照《公司法》等法律、法规建立了规范、健全的法人治理结构，公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等规章制度，对关联交易决策权力和程序作出了详细的规定，有利于公司规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正。此外，公司建立健全了规范的独立董事制度；董事会成员中有 3 位独立董事，有利于公司董事会的独立性和公司治理机制的完善。公司的独立董事将在规范和减少关联交易方面发挥重要作用，积极保护公司和中小投资者的利益。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

### 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历

#### （一）董事会成员

公司董事会共设7名董事，其中独立董事3名。各位董事简历如下：

**胡黎强**先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任力通微电子（上海）有限公司设计工程师，安森美半导体（上海）有限公司设计工程师，龙鼎微电子（上海）有限公司设计工程师，华润矽威科技（上海）有限公司设计经理，晶丰有限董事长、总经理。曾荣获“上海市领军人才”、“第八届上海科技企业创新奖”等荣誉。现任公司董事长、总经理，晶丰香港董事，上海晶哲瑞执行事务合伙人，宁波沪蓉杭执行事务合伙人。其担任公司董事的任期为2017年1月至2020年1月。

**刘洁茜**女士，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任通用电气（上海）研发中心有限公司实验室工程师，科孚德机电（上海）有限公司采购专员，晶丰有限董事、人力资源总监。现任公司董事、副总经理。其担任公司董事的任期为2017年1月至2020年1月。

**夏风**先生，1968年2月出生，中国国籍，拥有中国香港非永久居留权，本科学历，高级工程师。历任株洲市中南无线电厂技术员、助理工程师，株洲市氧化锌避雷器厂副厂长，深圳市族兴实业有限公司副总经理。现任长沙族兴新材料股份有限公司副董事长、技术总监，Keenway International Limited 董事，公司董事。其担任公司董事的任期为2017年1月至2020年1月。

**苏仁宏**先生，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。历任中兴通讯股份有限公司 WCDMA 系统部项目经理，华为技术有限公司 WCDMA 基站研发部专家组长，Semtech 市场部经理，苏州元禾控股有限公司投资经理，华登国际投资总监。现任苏州奥银执行事务合伙人委派代表，上海湖杉投资管理有限公司总经理，奥银湖杉（苏州）投资管理有限公司执行董事兼总经理，上海元趣信息技术有限公司董事，苏州敏芯微电子技术股份有限公

司董事，上海智位机器人股份有限公司董事，上海大不自多信息科技有限公司董事，深圳市艾森智能技术有限公司董事，深圳天博智科技有限公司董事，Nitronic Holding Limited 董事，公司董事。其担任公司董事的任期为 2017 年 1 月至 2020 年 1 月。

**冯震远**先生，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，一级律师。历任桐乡市法律顾问处律师、副主任，浙江新澳纺织股份有限公司独立董事，恒锋工具股份有限公司独立董事。现任浙江百家律师事务所主任，中华全国律师协会理事，嘉兴市律师协会会长，浙江省律师协会副会长，公司独立董事。其担任公司独立董事的任期为 2017 年 1 月至 2020 年 1 月。

**孙文秋**先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。历任南京兵工物资学校教师，上海财经大学教师，上海东方明珠（集团）股份有限公司总会计师、副总裁，上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总经理，财通基金管理有限公司董事，上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事，上海新农饲料股份有限公司独立董事，公司独立董事。其担任公司独立董事的任期为 2017 年 1 月至 2020 年 1 月。

**应俊**女士，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。现任重庆邮电大学光电工程学院副教授，公司独立董事。其担任公司独立董事的任期为 2017 年 1 月至 2020 年 1 月。

## （二）监事会成员

公司监事会共有 3 名监事，各位监事简历如下：

**张宜**先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任新加坡特许半导体制造有限公司工艺集成经理，上海华虹 NEC 电子有限公司研发部工艺集成经理，艾萨华科技（上海）有限公司代工厂管理部经理，晶丰有限工艺开发总监。现任公司监事会主席、工艺开发总监。其担任公司监事会主席的任期为 2017 年 1 月至 2020 年 1 月。



周占荣先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任三星电机有限公司销售工程师，恩智浦半导体（上海）有限公司销售经理，晶丰有限运营总监。现任公司监事、运营总监。其担任公司监事的任期为2017年1月至2020年1月。

李宁先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任德州仪器半导体技术（上海）有限公司销售经理，晶丰有限销售总监。现任公司监事、销售总监。其担任公司监事的任期为2017年1月至2020年1月。

### （三）高级管理人员

胡黎强先生，公司董事长兼总经理，简历参见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“（一）董事会成员”。

刘洁茜女士，公司董事兼副总经理，简历参见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“（一）董事会成员”。

孙顺根先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任意法半导体（深圳）有限公司芯片设计工程师，杭州士康射频技术有限公司高级设计工程师，杭州茂力半导体技术有限公司高级设计工程师，晶丰有限首席技术官。现任公司副总经理。

汪星辰先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任通用电气中国有限公司财务分析经理，科勒中国财务总监，铁姆肯（中国）投资有限公司亚太区业务开发经理、亚太区财务经理、全球轴承业务财务总监及亚太区司库及税务经理，晶丰有限首席财务官。现任公司财务负责人、董事会秘书，上海汉枫董事。

### （四）核心技术人员

胡黎强先生，公司董事长兼总经理，简历参见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“（一）董事会成员”。

孙顺根先生，公司副总经理，简历参见本节本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“（三）高级管理人员”。

张宜先生，公司监事会主席，简历参见本节本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“（二）监事会成员”。

### （五）公司董事、监事及高级管理人员的选聘情况

2017年1月21日，公司召开创立大会暨首次股东大会，选举胡黎强、刘洁茜、夏风、苏仁宏为公司第一届董事会董事，选举冯震远、孙文秋、应俊为公司第一届董事会独立董事；选举李宁、周占荣为公司第一届监事会非职工代表监事，和经职工代表大会选举的职工代表监事张宜共同组成公司第一届监事会。

2017年1月21日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举张宜为公司第一届监事会主席。

2017年1月21日，公司第一届董事会第一次会议决议选举胡黎强为公司第一届董事会董事长；聘任胡黎强为总经理，刘洁茜、孙顺根为副总经理，汪星辰为财务负责人兼董事会秘书。

### （六）董事、监事、高级管理人员的任职资格

上述公司董事、监事及高级管理人员均符合《公司法》及国家有关法律法規规定的任职资格条件。

### （七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的近亲属关系

公司董事胡黎强、刘洁茜为配偶关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在近亲属关系。

### （八）公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的协议

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了聘任合同。

## 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况

### （一）直接持有本公司股份情况

报告期末，全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股权不存在质押或冻结情况，具体情况如下：

姓名	职务或亲属关系	持股比例			
		2017.3.31	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
胡黎强	董事长、总经理	35.85%	36.81%	36.81%	36.29%
夏风	董事	32.72%	33.59%	33.59%	33.25%

### （二）间接持有本公司股份情况

报告期末，全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股权不存在质押或冻结情况，具体情况如下：

姓名	职务或亲属关系	间接持股比例
胡黎强	董事长、总经理	0.41%
刘洁茜	董事、副总经理	12.63%
夏风	董事	0.04%
苏仁宏	董事	0.01%
张宜	监事会主席	0.88%
周占荣	监事	0.49%
李宁	监事	2.93%
孙顺根	副总经理	5.10%
汪星辰	财务负责人、董事会秘书	0.97%
胡黎瑛	胡黎强之姐	0.70%
胡黎琴	胡黎强之妹	0.70%

## 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资

截止本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员对外投资情况如下：

姓名	职务	对外投资单位名称	持股比例
胡黎强	董事长、总经理	上海晶哲瑞	1.00%
		宁波沪蓉杭	1.28%
		苏州奥银	4.41%
		上海湖杉	12.00%
		北京惠泰企业管理中心（有限合伙）	15.00%
刘洁茜	董事、副总经理	上海晶哲瑞	43.79%
		上海海言投资中心（有限合伙）	8.45%
夏风	董事	苏州奥银	2.75%
		上海湖杉	24.00%
		深圳市族兴实业有限公司	49.00%
		长沙族兴新材料股份有限公司	23.89%
		深圳娃娃亲亲科技有限公司	15.00%
		深圳市微纳科学技术有限公司	4.00%
		深圳市点睛创视技术有限公司	0.98%
		Keenway International Limited	100.00%
苏仁宏	董事	上海湖杉	2.50%
		奥银湖杉（苏州）投资管理有限公司	47.00%
		上海湖杉投资管理有限公司	15.00%
		上海脉聘网络科技有限公司	5.82%
		深圳英察技术有限公司	1.51%
		PerceptIn, Inc.	0.70%
冯震远	独立董事	浙江百家律师事务所	35.00%

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资行为与公司均不存在利益冲突。

#### 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况

公司现有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2016 年度领取的薪酬情况如下表：

单位：万元

姓名	职务	2016 年度薪酬
胡黎强	董事长、总经理	80.98

刘洁茜	董事、副总经理	44.40
夏风	董事	-
苏仁宏	董事	-
冯震远	独立董事	-
孙文秋	独立董事	-
应俊	独立董事	-
张宜	监事会主席	64.78
周占荣	监事	81.50
李宁	监事	78.65
孙顺根	副总经理	105.97
汪星辰	财务负责人、董事会秘书	84.05

注：公司董事苏仁宏和夏风未在公司领取薪酬；独立董事冯震远、孙文秋、应俊自 2017 年 1 月起在本公司领取独立董事津贴。

## 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况

姓名	职务	其他单位兼职情况	所兼职单位与发行人的关联关系
胡黎强	董事长、总经理	晶丰香港董事	控股子公司
		上海晶哲瑞执行事务合伙人	公司股东、实际控制人控制的其他企业
		宁波沪蓉杭执行事务合伙人	实际控制人控制的其他企业
刘洁茜	董事、副总经理	未在其他单位兼职	
夏风	董事	长沙族兴新材料股份有限公司副董事长、技术总监	主要股东控制或施加重大影响的企业
		Keenway International Limited 董事	
苏仁宏	董事	苏州奥银执行事务合伙人委派代表	关键管理人员控制或施加重大影响的企业及担任其董事、高级管理人员的企业
		上海湖杉投资管理有限公司总经理	
		奥银湖杉（苏州）投资管理有限公司执行董事兼总经理	
		上海元趣信息技术有限公司董事	
		苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事	
		上海智位机器人股份有限公司董事	
		上海大不自多信息科技有限公司董事	
		深圳市艾森智能技术有限公司董事	
深圳天博智科技有限公司董事			

		Nitetronic Holding Limited 董事	
冯震远	独立董事	浙江百家律师事务所主任	关键管理人员控制或施加重大影响的企业
		中华全国律师协会理事	无关联关系
		嘉兴市律师协会会长	
		浙江省律师协会副会长	
孙文秋	独立董事	浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总经理	关键管理人员担任其董事、高级管理人员的企业
		财通基金管理有限公司董事	
		上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事	
		上海新农饲料股份有限公司独立董事	
应俊	独立董事	重庆邮电大学教师	无关联关系
张宜	监事会主席	未在其他单位兼职	
周占荣	监事		
李宁	监事		
孙顺根	副总经理		
汪星辰	财务负责人、董事会秘书	上海汉枫董事	参股公司

## 六、公司董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

职务	报告期期初 (2014年1月)	第一次变动 (2015年6月)	第二次变动 (2016年12月)	第三次变动 (2017年1月)
董事会成员	胡黎强、夏风、付利军	胡黎强、夏风、刘洁茜	未变化	胡黎强、刘洁茜、夏风、苏仁宏、冯震远、孙文秋、应俊
监事会成员	赵立新	未变化	张宜	张宜、李宁、周占荣
董事长	胡黎强	未变化	未变化	未变化
监事会主席	无	无	无	张宜
总经理	胡黎强	未变化	未变化	未变化
副总经理	无	无	无	刘洁茜、孙顺根
财务负责人	郑蓓	汪星辰	未变化	未变化
董事会秘书	无	无	无	汪星辰

1、2015年6月，公司股东会作出决议，同意付利军因个人原因辞去董事职务，选举刘洁茜为董事；

2、2015年6月，郑蓓因个人原因辞去财务负责人职务，公司董事会聘任汪星辰为财务负责人；

3、2016年12月，公司股东会作出决议，同意赵立新因个人原因辞去监事职务，选举张宜为监事；

4、2017年1月，公司召开创立大会，选举胡黎强、夏风、刘洁茜、苏仁宏、冯震远、孙文秋、应俊等7人为公司董事，其中冯震远、孙文秋、应俊为公司独立董事；选举李宁、周占荣为公司第一届监事会非职工代表监事，和经职工代表大会选举的职工代表监事张宜共同组成公司第一届监事会。2017年1月，公司召开第一届董事会第一次会议，选举胡黎强为公司第一届董事会董事长；聘任胡黎强为总经理，刘洁茜、孙顺根为副总经理，汪星辰为财务负责人兼董事会秘书。

上述董事、监事及高级管理人员变动是正常的工作变动，公司核心管理层始终保持稳定。上述人员变动对公司日常管理不构成重大影响，不影响公司的持续经营。截至本招股说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员均未发生变动。

## 第九节 公司治理

### 一、公司股东大会制度的建立健全及运行机制

#### （一）股东大会制度的建立健全

2017年1月21日，公司召开了创立大会，并根据《公司法》及有关规定，制定了《股东大会议事规则》。

##### 1、股东的权利和义务

公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。股东按其所持有的股份，享有同等权利，承担同种义务。

公司股东享有下列权利：（1）按照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加股东大会；（3）依照其所持有的股份份额行使表决权；（4）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）依照法律、行政法规及公司章程的规定查阅有关公司文件，获得公司有关信息；（7）公司终止或清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；（2）依其所认购的股份和公司章程规定的出资方式、出资时间，按期足额缴纳股金；（3）除法律、行政法规规定的情形外，不得退股；（4）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

##### 2、股东大会的职权和规则

《公司章程》规定股东大会是公司权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议



批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（10）修改公司章程；（11）审议批准本公司章程第三十六条规定的担保事项；（12）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（13）审批公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（14）审议法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其其他机构和个人代为行使。

《公司章程》规定的股东大会会议事规则主要有：股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会年会每年召开 1 次，并于上一会计年度完结之后的 6 个月内举行。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## （二）股东大会制度的运行情况

公司股东大会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有的作用。

## 二、公司董事会制度的建立健全及运行情况

### （一）董事会制度的建立健全

2017 年 1 月 21 日，公司召开了创立大会，并根据《公司法》及有关规定，制定了《董事会议事规则》。

#### 1、董事会构成

公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事；董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。

#### 2、董事会的职权和议事规则

《公司章程》规定董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、变更公司形式、解散和清算方案；（8）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）选举或更换董事长，聘任或者解聘公司高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订公司章程的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换会计师事务所；（15）听取公司高级管理人员的工作汇报并检查公司高级管理人员的工作；（16）法律、行政法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

《公司章程》规定的董事会议事规则主要有：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日以前通知全体董事和监事。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：代表 1/10 以上表决权的股东提议时；1/3 以上的董事提议时；监事会提议时。董事长应当自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

## （二）董事会制度的运行情况

公司董事会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规规范运行，决策科学、严格高效，发挥了应有的作用。

## 三、公司监事会制度的建立健全及运行情况

### （一）监事会制度的建立健全

2017 年 1 月 21 日，公司召开了创立大会，并根据《公司法》及有关政策规定，制定了《监事会议事规则》。

#### 1、监事会的构成

《公司章程》规定监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事由股东代表和公司职工代表担任。每届监事会中职工代表的比例由股东大会决定，职工代表担任的监事不得少于监事人数的 1/3。职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换。监事每届任期三年，连选可以连任。

## 2、监事会的职权和议事规则

《公司章程》规定监事会行使下列职权：（1）检查公司的财务；（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；（4）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；（5）向股东大会会议提出提案；（6）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（7）列席董事会会议；（8）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

《公司章程》规定的监事会议事规则主要有：监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

## （二）监事会制度的运行情况

公司监事会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规规范运行、严格监督，有效地维护了股东的利益，发挥了应有的作用。

# 四、公司独立董事制度的建立健全及运行情况

## （一）独立董事制度的建立健全

2017 年 1 月 21 日，公司召开了创立大会，并根据《公司法》及有关政策规定，制定了《独立董事工作细则》。

### 1、独立董事的构成

公司董事会中应当至少包括 1/3 的独立董事。独立董事中至少包括 1 名会计专业人员。独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名，并经股东大会选举决定。

## 2、独立董事的职权

独立董事可行使以下职权：重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额 300 万元以上或本公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易）应由独立董事发表意见，经独立董事认可后，提交董事会讨论，独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；向董事会提请召开临时股东大会；提议召开董事会；独立聘请外部审计机构和咨询机构；可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；适用的法律、行政法规、规章和《公司章程》规定的其他职权。

独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项以书面形式发表独立意见：交易总额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上的关联交易；重大购买或出售资产；吸收合并；股份回购；公司董事、高级管理人员的薪酬及其他形式的报酬；董事会存在重大分歧的事项；独立董事认为可能损害中小股东合法权益的事项；提名、任免董事；聘任或解聘高级管理人员；公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额 300 万元以上且公司最近经审计净资产值 0.5%以上的借款或其它资金往来，及公司是否采取有效措施回收欠款；证券监管部门或证券交易所要求独立董事发表意见的事项；《公司章程》规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

## （二）独立董事制度的运行情况

公司独立董事制度自建立伊始，保持规范、有序运行，保障了董事会决策的科学性，维护了广大中小股东的利益，发挥了应有的作用。独立董事制度将对公司重大事项和关联交易事项的决策，对公司法人治理结构的完善起到积极

的作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德将在董事会制定公司发展战略、发展计划和生产经营决策等方面发挥良好的作用，将有力地保障公司经营决策的科学性和公正性。

## 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

### （一）董事会秘书制度的建立情况

2017年3月2日，经公司第一届董事会第二次会议审议通过了《董事会秘书工作细则》。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系管理等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

### （二）董事会秘书制度的运行情况

公司董事会秘书制度自建立伊始，始终保持规范、有序运行，保障了董事会各项工作的顺利开展，发挥了应有的作用。

## 六、专门委员会的设置情况

2017年3月2日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于成立上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会专业委员会的议案》，决定设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，并审议通过了《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会议事规则》。

战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；其成员由胡黎强、夏风、苏仁宏、刘洁茜、应俊组成，其中胡黎强为召集人。审计委员会主要职责是公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；其成员由孙文秋、冯震远、胡黎强组成，其中孙文秋为召集人。薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，其主要职责是制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核以及制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；其成员由冯震远、孙文秋、刘洁茜组成，其中冯震远为召集人。提名委员会主要职责是制定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对高级

管理人员人选进行选择并提出建议；其成员由应俊、冯震远、胡黎强组成，其中应俊为召集人。

## 七、公司近三年的规范运作情况

近三年来，公司遵守国家的有关法律与法规，合法经营，不存在重大违法违规的行为。

## 八、公司近三年资金占用和违规担保情况

截至报告期末，公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金及对外提供担保的情况。在报告期内，公司与关联方之间的资金往来详情参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易情况”之“（二）报告期内的关联交易”。

## 九、公司内部控制制度的情况简述

### （一）公司管理层对内部控制制度的自我评价

公司董事会对公司的内部控制进行了自查和评估后认为：“公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

### （二）注册会计师的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了专项审核，出具了《内部控制鉴证报告》，报告的结论性意见为：“我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 3 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

## 第十节 财务会计信息

以下引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自立信会计师事务所审计的财务报告。本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-3 月经审计的财务报表及附注的主要内容。

公司提醒投资者关注本招股说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

### 一、财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元

资产	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
流动资产：				
货币资金	46,256,398.82	39,361,022.00	45,383,035.37	108,840,856.79
结算备付金				
拆出资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	42,406,950.81	46,886,415.32	24,460,418.15	3,738,330.39
应收账款	97,652,125.63	81,557,831.14	65,061,738.60	27,308,682.30
预付款项	10,158,952.77	2,700,244.32	4,119,837.39	1,262,260.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,631,944.33	3,820,082.57	59,421,091.65	53,140,154.55
买入返售金融资产				
存货	55,605,454.79	38,698,491.84	41,770,804.24	44,847,469.68
划分为持有待售的资				

产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	14,731,603.16	25,471,698.11		
流动资产合计	273,443,430.31	238,495,785.30	240,216,925.40	239,137,754.52
非流动资产：				
发放贷款和垫款				
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	18,625,001.79	18,866,844.61	18,792,555.59	12,730,821.01
投资性房地产				
固定资产	4,500,743.32	3,545,732.96	3,865,714.58	3,541,826.03
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,275,172.46	2,953,600.78	30,688.33	52,350.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,520,700.26	2,136,082.58	2,725,644.40	2,013,199.75
其他非流动资产		1,583,578.76		
非流动资产合计	40,921,617.83	39,085,839.69	35,414,602.90	18,338,197.64
资产总计	314,365,048.14	277,581,624.99	275,631,528.30	257,475,952.16

## 合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				



吸收存款及同业存放				
拆入资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	27,579,237.14	45,411,913.05	13,750,000.00	28,171,872.41
应付账款	115,975,712.31	92,628,188.30	43,826,354.80	32,352,913.21
预收款项	1,628,079.19	2,548,545.74	2,839,271.53	3,708,497.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,318,551.20	7,222,957.60	3,266,548.20	1,798,334.93
应交税费	1,375,755.86	9,435,136.74	7,068,148.52	13,181,268.36
应付利息				
应付股利				
其他应付款	13,382,723.10	14,029,051.70	1,785,614.84	1,696,489.34
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债		258,333.38	309,999.96	
其他流动负债				
流动负债合计	163,260,058.80	171,534,126.51	72,845,937.85	80,909,375.41
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款			258,333.38	
长期应付职工薪酬				
专项应付款				

预计负债	8,943,603.75	6,156,310.71	3,509,690.44	2,222,119.05
递延收益	4,208,000.00	520,000.00	700,000.00	1,380,000.00
递延所得税负债	77,160.20	41,471.40		
其他非流动负债				
非流动负债合计	13,228,763.95	6,717,782.11	4,468,023.82	3,602,119.05
负债合计	176,488,822.75	178,251,908.62	77,313,961.67	84,511,494.46
所有者权益：				
股本	46,200,000.00	33,240,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	85,068,514.04	33,121,162.16	18,207,379.41	13,099,340.59
减：库存股				
其他综合收益	3,038.39	23,897.60		
专项储备				
盈余公积	2,962,573.31	8,816,801.84	5,854,228.53	5,854,228.53
一般风险准备				
未分配利润	3,642,099.65	24,127,854.77	163,255,958.69	144,010,888.58
归属于母公司所有者权益合计	137,876,225.39	99,329,716.37	198,317,566.63	172,964,457.70
少数股东权益				
所有者权益合计	137,876,225.39	99,329,716.37	198,317,566.63	172,964,457.70
负债和所有者权益总计	314,365,048.14	277,581,624.99	275,631,528.30	257,475,952.16

## （二）合并利润表

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	153,091,575.68	570,881,118.12	357,120,365.76	337,270,136.64
其中：营业收入	153,091,575.68	570,881,118.12	357,120,365.76	337,270,136.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	139,911,219.08	546,056,846.83	347,903,120.47	269,245,774.65

其中：营业成本	119,717,733.84	452,244,866.51	284,668,183.41	220,586,209.08
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	309,538.50	1,782,772.33	705,689.98	841,595.68
销售费用	2,970,904.70	12,099,573.87	9,147,506.14	8,404,502.55
管理费用	16,522,873.15	79,584,744.61	51,852,932.29	38,764,185.78
财务费用	114,294.55	-415,133.11	-239,326.81	-203,704.13
资产减值损失	275,874.34	760,022.62	1,768,135.46	852,985.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-57,884.35	1,059,585.94	-439,852.95	726,828.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-241,842.82	-496,716.93	-938,265.42	-399,360.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,122,472.25	25,883,857.23	8,777,392.34	68,751,190.33
加：营业外收入	101,992.16	9,002,135.94	11,102,196.74	7,791,280.55
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		345,328.99	138,490.12	85,239.76
其中：非流动资产处置损失		95,378.26	98,490.12	85,239.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,224,464.41	34,540,664.18	19,741,098.96	76,457,231.12
减：所得税费用	1,322,096.18	4,625,402.54	496,028.85	9,567,800.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,902,368.23	29,915,261.64	19,245,070.11	66,889,430.31
归属于母公司所有者的净利润	11,902,368.23	29,915,261.64	19,245,070.11	66,889,430.31
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	-20,859.21	23,897.60		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,859.21	23,897.60		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,859.21	23,897.60		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-20,859.21	23,897.60		
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	11,881,509.02	29,939,159.24	19,245,070.11	66,889,430.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,881,509.02	29,939,159.24	19,245,070.11	66,889,430.31
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.26	0.90	1.80	6.69
（二）稀释每股收益（元/股）	0.26	0.90	1.80	6.69

### （三）合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	95,621,531.32	470,019,774.70	236,313,742.12	255,717,702.69
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	264,534.73	666,454.83	674,966.17	337,358.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,224,359.28	10,187,630.11	11,623,021.32	8,363,255.71
经营活动现金流入小计	100,110,425.33	480,873,859.64	248,611,729.61	264,418,317.24
购买商品、接受劳务支付的现金	84,180,211.10	299,987,561.06	193,712,773.66	147,568,153.10
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职	17,602,788.89	46,691,676.20	36,741,446.27	25,523,670.65

工支付的现金				
支付的各项税费	10,625,321.54	22,209,690.37	18,591,980.83	23,805,940.88
支付其他与经营活动有关的现金	6,036,966.37	32,251,977.28	22,224,050.29	20,532,971.75
经营活动现金流出小计	118,445,287.90	401,140,904.91	271,270,251.05	217,430,736.38
经营活动产生的现金流量净额	-18,334,862.56	79,732,954.73	-22,658,521.44	46,987,580.86
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金		11,410,000.00		
取得投资收益收到的现金	183,958.47	2,832,994.20	498,412.47	1,126,188.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	91,000,000.00	638,500,000.00	236,904,000.00	789,500,000.00
投资活动现金流入小计	91,183,958.47	652,743,294.20	237,402,412.47	790,626,188.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,497,933.29	6,133,746.06	1,090,515.95	1,862,961.19
投资支付的现金	-		17,000,000.00	10,410,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	79,000,000.00	668,820,719.00	245,144,836.90	789,565,157.90
投资活动现金流出小计	81,497,933.29	674,954,465.06	263,235,352.85	801,838,119.09
投资活动产生的现金流量净额	9,686,025.18	-22,211,170.86	-25,832,940.38	-11,211,930.23
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	26,665,000.00		1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			10,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动				

有关的现金				
筹资活动现金流入小计	26,665,000.00		11,000,000.00	
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,451,747.53	566,278.61	1,977,962.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	849,056.61	471,698.11		
筹资活动现金流出小计	849,056.61	81,923,445.64	10,566,278.61	1,977,962.45
筹资活动产生的现金流量净额	25,815,943.39	-81,923,445.64	433,721.39	-1,977,962.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,103.57	1,235,347.11	161,791.42	2,452.84
五、现金及现金等价物净增加额	17,026,002.44	-23,166,314.66	-47,895,949.01	33,800,141.02
加：期初现金及现金等价物余额	14,856,720.71	38,023,035.37	85,918,984.38	52,118,843.36
六、期末现金及现金等价物余额	31,882,723.15	14,856,720.71	38,023,035.37	85,918,984.38

#### （四）母公司资产负债表

单位：元

资产	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
流动资产：				
货币资金	42,743,255.67	37,446,747.35	45,383,035.37	108,840,856.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	42,406,950.81	46,886,415.32	24,460,418.15	3,738,330.39
应收账款	98,094,917.63	81,871,594.86	65,061,738.60	27,308,682.30
预付款项	10,144,484.94	2,700,244.32	4,119,837.39	1,262,260.81
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,621,226.2	3,809,305.87	59,421,091.65	53,140,154.55
存货	55,605,454.79	38,698,491.84	41,770,804.24	44,847,469.68

划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	14,731,603.16	25,471,698.11		
流动资产合计	270,347,893.20	236,884,497.67	240,216,925.40	239,137,754.52
非流动资产：				
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	18,955,976.79	19,197,819.61	18,792,555.59	12,730,821.01
投资性房地产				
固定资产	4,500,743.32	3,545,732.96	3,865,714.58	3,541,826.03
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,275,172.46	2,953,600.78	30,688.33	52,350.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,516,514.73	2,135,629.66	2,725,644.40	2,013,199.75
其他非流动资产		1,583,578.76		
非流动资产合计	41,248,407.30	39,416,361.77	35,414,602.90	18,338,197.64
资产总计	311,596,300.50	276,300,859.44	275,631,528.30	257,475,952.16

### 母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
流动负债：				
短期借款				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				



衍生金融负债				
应付票据	27,579,237.14	45,411,913.05	13,750,000.00	28,171,872.41
应付账款	115,975,712.31	92,628,188.3	43,826,354.80	32,352,913.21
预收款项	197,484.91	1,585,823.82	2,839,271.53	3,708,497.16
应付职工薪酬	3,318,551.20	7,222,957.60	3,266,548.20	1,798,334.93
应交税费	1,238,650.28	9,430,519.26	7,068,148.52	13,181,268.36
应付利息				
应付股利				
其他应付款	13,382,723.10	14,029,051.70	1,785,614.84	1,696,489.34
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债		258,333.38	309,999.96	
其他流动负债				
流动负债合计	161,692,358.94	170,566,787.11	72,845,937.85	80,909,375.41
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款			258,333.38	
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债	8,943,603.75	6,156,310.71	3,509,690.44	2,222,119.05
递延收益	4,208,000.00	520,000.00	700,000.00	1,380,000.00
递延所得税负债	77,160.20	41,471.40		
其他非流动负债				
非流动负债合计	13,228,763.95	6,717,782.11	4,468,023.82	3,602,119.05
负债合计	174,921,122.89	177,284,569.22	77,313,961.67	84,511,494.46
所有者权益：				
股本	46,200,000.00	33,240,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	85,068,514.04	33,121,162.16	18,207,379.41	13,099,340.59

减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	2,962,573.31	8,816,801.84	5,854,228.53	5,854,228.53
未分配利润	2,444,090.26	23,838,326.22	163,255,958.69	144,010,888.58
所有者权益合计	136,675,177.61	99,016,290.22	198,317,566.63	172,964,457.70
负债和所有者权益总计	311,596,300.50	276,300,859.44	275,631,528.30	257,475,952.16

## （五）母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	151,992,915.38	570,441,313.05	357,120,365.76	337,270,136.64
减：营业成本	119,717,733.84	452,244,866.51	284,668,183.41	220,586,209.08
税金及附加	309,538.50	1,782,772.33	705,689.98	841,595.68
销售费用	2,960,769.54	11,978,875.12	9,147,506.14	8,404,502.55
管理费用	16,498,514.86	79,584,744.61	51,852,932.29	38,764,185.78
财务费用	110,361.00	-437,896.54	-239,326.81	-203,704.13
资产减值损失	253,252.78	757,277.56	1,768,135.46	852,985.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-57,884.35	1,059,585.94	-439,852.95	726,828.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-241,842.82	-496,716.93	-938,265.42	-399,360.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,084,860.51	25,590,259.40	8,777,392.34	68,751,190.33
加：营业外收入	101,992.16	9,002,135.94	11,102,196.74	7,791,280.55
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		345,328.99	138,490.12	85,239.76
其中：非流动资产处置损失		95,378.26	98,490.12	85,239.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,186,852.67	34,247,066.35	19,741,098.96	76,457,231.12

减：所得税费用	1,192,965.28	4,621,333.26	496,028.85	9,567,800.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,993,887.39	29,625,733.09	19,245,070.11	66,889,430.31
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	10,993,887.39	29,625,733.09	19,245,070.11	66,889,430.31
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.24	0.89	1.80	6.69
（二）稀释每股收益（元/股）	0.24	0.89	1.80	6.69

**（六）母公司现金流量表**

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	93,954,928.58	468,334,228.63	236,313,742.12	255,717,702.69
收到的税费返还	264,534.73	666,454.83	674,966.17	337,358.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,224,359.28	10,187,623.13	11,623,021.32	8,363,255.71
经营活动现金流入小计	98,443,822.59	479,188,306.59	248,611,729.61	264,418,317.24
购买商品、接受劳务支付的现金	84,180,211.10	299,987,561.06	193,712,773.66	147,568,153.10
支付给职工以及为职工支付的现金	17,602,788.89	46,691,676.20	36,741,446.27	25,523,670.65
支付的各项税费	10,625,321.54	22,209,690.37	18,591,980.83	23,805,940.88
支付其他与经营活动有关的现金	5,984,032.28	32,097,979.10	22,224,050.29	20,532,971.75
经营活动现金流出小计	118,392,353.81	400,986,906.73	271,270,251.05	217,430,736.38
经营活动产生的现金流量净额	-19,948,531.22	78,201,399.86	-22,658,521.44	46,987,580.86
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金		11,410,000.00		
取得投资收益收到的现金	183,958.47	2,832,994.20	498,412.47	1,126,188.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	91,000,000.00	638,500,000.00	236,904,000.00	789,500,000.00
投资活动现金流入小计	91,183,958.47	652,743,294.20	237,402,412.47	790,626,188.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,497,933.29	6,133,746.06	1,090,515.95	1,862,961.19
投资支付的现金		330,975.00	17,000,000.00	10,410,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

额				
支付其他与投资活动有关的现金	79,000,000.00	668,820,719.00	245,144,836.90	789,565,157.90
投资活动现金流出小计	81,497,933.29	675,285,440.06	263,235,352.85	801,838,119.09
投资活动产生的现金流量净额	9,686,025.18	-22,542,145.86	-25,832,940.38	-11,211,930.23
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	26,665,000.00		1,000,000.00	
取得借款收到的现金			10,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	26,665,000.00		11,000,000.00	
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,451,747.53	566,278.61	1,977,962.45
支付其他与筹资活动有关的现金	849,056.61	471,698.11		
筹资活动现金流出小计	849,056.61	81,923,445.64	10,566,278.61	1,977,962.45
筹资活动产生的现金流量净额	25,815,943.39	-81,923,445.64	433,721.39	-1,977,962.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,303.41	1,183,602.33	161,791.42	2,452.84
五、现金及现金等价物净增加额	15,427,133.94	-25,080,589.31	-47,895,949.01	33,800,141.02
加：期初现金及现金等价物余额	12,942,446.06	38,023,035.37	85,918,984.38	52,118,843.36
六、期末现金及现金等价物余额	28,369,580.00	12,942,446.06	38,023,035.37	85,918,984.38

## 二、审计意见

立信会计师事务所接受公司委托，审计了公司 2017 年 3 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2017 年 1-3 月、2016 年度、2015 年度、2014 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。审计意见摘录如下：

“我们认为，晶丰明源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晶丰明源 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 3 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-3 月的合并及公司经营成果和现金流量。”

### 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

#### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### （二）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### （三）合并报表范围及其变化

截至 2017 年 3 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围			
	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
晶丰香港	是	是	否	否

2016 年 5 月公司独资设立晶丰香港，公司持有其 100% 的股权，故将其纳入合并范围。

### 四、主要会计政策和会计估计

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## （一）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本次申报期间为2014年1月1日至2017年3月31日。

## （二）营业周期

本公司营业周期为12个月。

## （三）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## （四）合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益

总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法



在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## （六）外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## （七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **4、金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分

的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （八）应收款项坏账准备

### 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

## 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款外（注：合并范围内的各公司之间内部往来款不计提坏账准备），公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 3	合并范围内的各公司之间内部往来款不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合 1	帐龄分析法
组合 2	个别认定法
组合 3	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款比例（%）
六个月以内	1
六个月至一年以内	5
一至二年	20
二至三年	50
三年以上	100

## 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：单项金额虽不重大，但由于应收款项发生了特殊减值的情况，故对该类应收款项进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## （九）存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、发出商品、产成品等。

### 2、存货发出的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## （十）长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准



共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## （十一）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	5	5	19
机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## （十二）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### （十三）无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5 年	预计通常使用年限

专用技术	5年	预计通常使用年限
专利权	5-10年	预计通常使用年限
其他	5年	预计通常使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本报告期无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### （十四）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。



## （十五）职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## （十六）预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

## （十七）股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以员工持股平台的股份期权进行股份支付，员工认购的股权来源于实际控制人持有的员工持股平台股权。公司按照授予日持股平台股份期权对应的公司权益的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## （十八）收入

### 1、销售商品收入确认的一般原则

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、具体原则

### (1) 国内销售

公司与客户签订销售合同或订单，业务人员根据销售合同或订单向仓储部发出发货指令，仓储部门将产品交付运输，客户在收到产品时签收产品。公司在发出产品并由客户签收后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认销售收入。

### (2) 国外销售

公司与客户签订销售合同或订单，业务人员根据销售合同或订单向仓储部发出发货指令，仓储部门将产品交付运输并办理产品出口手续。公司在发出产品并办理出口报关手续，且获海关批准后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认销售收入。

## (十九) 政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据实际补助对象划分。

## 2、确认时点

对于国家统一标准定额或者定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的政府补助均在实际收到时予以计量确认。

## 3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （二十）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （二十一）租赁

### 1、经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

### 2、融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

## （二十二）重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

（1）执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加2016年度金额587,801.77元，调减管理费用2016年度金额587,801.77元；调增税金及附加2017年1-3月金额130,902.98元，调减管理费用2017年1-3月金额130,902.98元。
（3）将“应交税费”科目下的“未交增值税”科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产2017年3月31日余额410,848.44元，调增应交税费2017年3月31日余额410,848.44元。

## 2、重要会计估计变更

本报告期未发生重大会计估计变更事项。

## 五、税项

### 1、主要税种和税率

税种	计税依据	税率			
		2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%	17%、6%	17%	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1%	1%	1%	1%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%	3%	3%	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%	2%	2%	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.50%	15%、16.50%	10%	12.50%

### 2、公司及所属子公司执行的所得税税率

纳税主体名称	所得税税率			
	2017年 1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
上海晶丰明源半导体股份有限公司	15%	15%	10%	12.50%
Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited	16.50%	16.50%	-	-

### 3、税收优惠

(1) 公司于 2012 年 11 月 18 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业证书，并于 2015 年 10 月 30 日通过了高新技术企业复审，取得了《高新技术企业证书》，证书号：GR201531000545。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），本公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2016 年度、2017 年 1-3 月企业所得税实际执行税率为 15%。

(2) 根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号），公司 2015 年度符合国家规划布局内重点集成电路设计企业有关企业所得税税收优惠条件，2015 年度公司按照 10% 的优惠税率缴纳企业所得税。

(3) 根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）和《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）的规定，公司享受软件企业自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至五年减半征收企业所得税。根据《企业所得税优惠事先备案结果通知书》（浦税十五所备（2012）第 036X 号），公司 2011-2012 年免征所得税，2013-2015 年减半征收，税率为 12.5%。2014 年度公司企业所得税按应纳税所得额的 12.5% 计缴。

## 六、非经常性损益

报告期内，公司的非经常性损益如下表所示：

单位：万元

项目	2017年 1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益	-	36.89	-9.85	-8.52

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.91	884.60	1,094.00	771.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	4.25	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	18.40	109.20	49.84	112.62
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	26.00	4.80	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9.29	-9.38	12.22	7.81



其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-1,325.61	-510.80	-303.95
所得税影响额	-4.29	41.11	-64.02	-72.41
少数股东权益影响额	-	-	-	-
合计	24.31	-232.94	576.19	506.86

## 七、最近一期末主要资产情况

### （一）应收账款

公司 2017 年 3 月 31 日应收账款余额及计提坏账准备情况如下：

单位：万元

账龄	账面余额	比例	坏账准备	净值
半年以内	9,849.20	99.85%	98.49	9,750.71
半年至一年以内	15.27	0.15%	0.76	14.50
合计	9,864.47	100.00%	99.25	9,765.21

截至 2017 年 3 月 31 日，无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项。

### （二）存货

公司 2017 年 3 月 31 日存货情况如下：

单位：万元

项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	633.85	0.10	633.75
委托加工物资	3,139.20	7.21	3,131.99
产成品	1,140.51	32.69	1,107.83
发出商品	686.97	-	686.97
合计	5,600.54	39.99	5,560.55

公司 2017 年 3 月 31 日存货跌价准备情况如下：

单位：万元

存货种类	2016 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少		2017 年 3 月 31 日
			转销或 转回	其他	

原材料	2.94	0.10	2.94	-	0.10
委托加工物资	24.83	6.22	23.84	-	7.21
产成品	26.37	8.28	1.96	-	32.69
合计	54.14	14.60	52.34	-	39.99

### （三）固定资产

公司 2017 年 3 月 31 日固定资产情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	减值准备	净值
办公设备	115.61	43.39	-	72.22
机器设备	341.94	186.26	-	155.68
电子设备	112.35	51.87	-	60.47
运输设备	180.84	19.14	-	161.70
合计	750.73	300.66	-	450.07

### （四）无形资产

公司 2017 年 3 月 31 日无形资产情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计摊销	净值
软件使用权	324.54	34.07	290.47
专用技术	9.60	1.92	7.68
专利权	253.50	36.85	216.65
其他	15.90	3.18	12.72
合计	603.54	76.02	527.52

## 八、最近一期末主要债项

### （一）短期借款

截至 2017 年 3 月 31 日，公司不存在短期借款。

### （二）应付票据

截至 2017 年 3 月 31 日，公司应付票据余额为 2,757.92 万元，全部为银行

承兑汇票，无已到期未支付的应付票据。

### （三）应付账款

截至 2017 年 3 月 31 日，公司应付账款余额为 11,597.57 万元，账龄均为一年以内。

### （四）应付职工薪酬

公司 2017 年 3 月 31 日应付职工薪酬明细如下：

单位：万元

项目	金额
工资、奖金、津贴和补贴	269.26
社会保险费	16.62
住房公积金	15.77
离职后福利-设定提存计划	30.20
合计	331.86

## 九、所有者权益变动情况

报告期内，公司股东权益情况如下：

单位：万元

股东权益	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
股本	4,620.00	3,324.00	1,100.00	1,000.00
资本公积	8,506.85	3,312.12	1,820.74	1,309.93
盈余公积	296.26	881.68	585.42	585.42
未分配利润	364.21	2,412.79	16,325.60	14,401.09
归属于母公司股东权益合计	13,787.62	9,932.97	19,831.76	17,296.45
股东权益合计	13,787.62	9,932.97	19,831.76	17,296.45

## 十、现金流量

报告期内，公司现金流量明细情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,833.49	7,973.30	-2,265.85	4,698.76
投资活动产生的现金流量净额	968.60	-2,221.12	-2,583.29	-1,121.19
筹资活动产生的现金流量净额	2,581.59	-8,192.34	43.37	-197.80
汇率变动对现金的影响	-14.11	123.53	16.18	0.25
现金及现金等价物净增加额	1,702.60	-2,316.63	-4,789.59	3,380.01

## 十一、报告期内的主要财务指标

### （一）主要财务指标

项目	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
流动比率	1.67	1.39	3.30	2.96
速动比率	1.33	1.16	2.72	2.40
资产负债率（母公司）	56.14%	64.16%	28.05%	32.82%
每股净资产（元）	2.98	2.99	18.03	17.30
无形资产占净资产比例 （扣除土地使用权）	3.83%	2.97%	0.02%	0.03%
项目	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
存货周转率（次）	2.54	11.24	6.57	6.20
应收账款周转率（次）	1.71	7.79	7.73	13.28
息税折旧摊销前利润（万元）	1,377.11	3,696.59	2,128.48	7,703.86
归属于发行人股东的净利润（万元）	1,190.24	2,991.53	1,924.51	6,688.94
归属于发行人股东扣除非经常性 损益后的净利润（万元）	1,165.93	3,224.47	1,348.32	6,182.08
利息保障倍数	-	40.09	35.86	2,735.28
每股净现金流量（元）	0.51	-0.70	-1.44	1.02
每股经营活动产生的现金流量净 额（元）	-0.55	2.40	-0.68	1.41

### （二）近三年及一期净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

期间	报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益(元)	
			基本	稀释
2017年 1-3月	归属于普通股股东的净利润	11.31	0.26	0.26
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	11.07	0.26	0.26
2016年	归属于普通股股东的净利润	19.08	0.90	0.90
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	20.57	0.97	0.97
2015年	归属于普通股股东的净利润	10.50	1.80	1.80
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	7.36	1.26	1.26
2014年	归属于普通股股东的净利润	47.80	6.69	6.69
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	44.18	6.18	6.18

## 十二、资产评估情况

晶丰有限整体变更为股份有限公司进行了资产评估,根据银信资产评估有限公司于2017年1月6日出具的《资产评估报告》(银信评报字[2016]沪第1286号),截至2016年11月30日(评估基准日)晶丰有限净资产评估值为11,387.57万元,评估增值1,092.98万元,增值率为10.62%,具体如下:

单位:万元

项目	账面价值	评估值	增减值	增减率(%)
流动资产	31,073.46	31,484.55	411.09	1.32
非流动资产	3,575.90	4,213.59	637.69	17.83
<b>资产合计</b>	<b>34,649.36</b>	<b>35,698.14</b>	<b>1,048.78</b>	<b>3.03</b>
流动负债	24,301.69	24,301.69	-	-
非流动负债	53.08	8.88	-44.20	-83.27
<b>负债合计</b>	<b>24,354.77</b>	<b>24,310.57</b>	<b>-44.20</b>	<b>-0.18</b>
<b>净资产</b>	<b>10,294.59</b>	<b>11,387.57</b>	<b>1,092.98</b>	<b>10.62</b>

公司非流动负债评估减值44.20万元,主要原因系公司非流动负债主要为计入递延收益的政府补助,递延收益实质为无需支付的应付款,评估值为零。

## 十三、公司设立时验资情况

详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性”。

## 第十一节 管理层讨论与分析

公司根据报告期内经审计的财务报告，分析公司财务状况、经营成果和现金流量。非经特别说明，所有数据均引自经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的近三年及一期财务报告或根据其中相关数据计算得出。

### 一、财务状况分析

#### （一）资产结构及变动情况

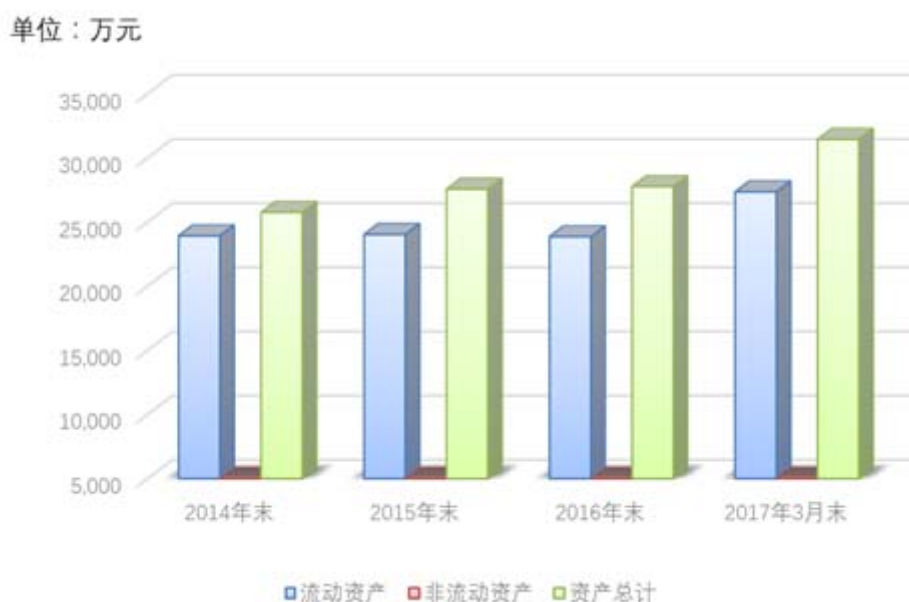
报告期内，公司主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

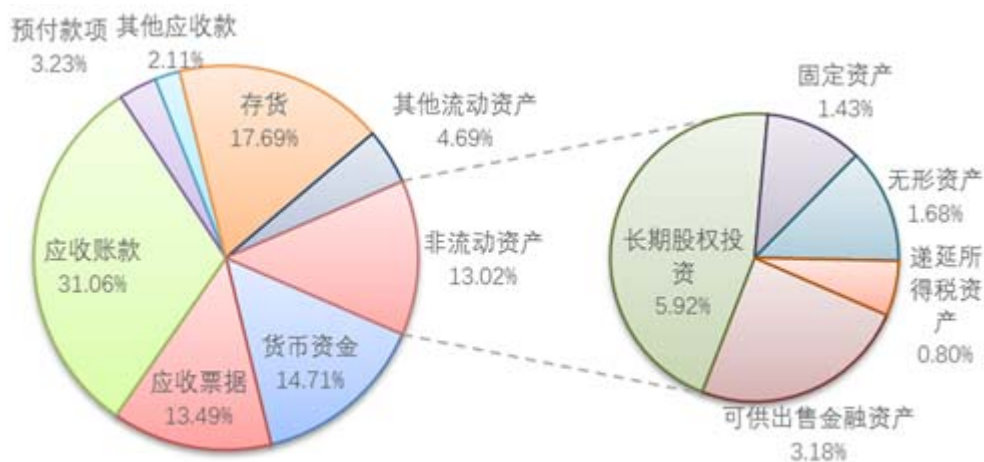
项目	2017年 3月31日		2016年 12月31日		2015年 12月31日		2014年 12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	4,625.64	14.71%	3,936.10	14.18%	4,538.30	16.47%	10,884.09	42.27%
应收票据	4,240.70	13.49%	4,688.64	16.89%	2,446.04	8.87%	373.83	1.45%
应收账款	9,765.21	31.06%	8,155.78	29.38%	6,506.17	23.60%	2,730.87	10.61%
预付款项	1,015.90	3.23%	270.02	0.97%	411.98	1.49%	126.23	0.49%
其他应收款	663.19	2.11%	382.01	1.38%	5,942.11	21.56%	5,314.02	20.64%
存货	5,560.55	17.69%	3,869.85	13.94%	4,177.08	15.15%	4,484.75	17.42%
其他流动资产	1,473.16	4.69%	2,547.17	9.18%	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>27,344.34</b>	<b>86.98%</b>	<b>23,849.58</b>	<b>85.92%</b>	<b>24,021.69</b>	<b>87.15%</b>	<b>23,913.78</b>	<b>92.88%</b>
可供出售金融资产	1,000.00	3.18%	1,000.00	3.60%	1,000.00	3.63%	-	-
长期股权投资	1,862.50	5.92%	1,886.68	6.80%	1,879.26	6.82%	1,273.08	4.94%
固定资产	450.07	1.43%	354.57	1.28%	386.57	1.40%	354.18	1.38%
无形资产	527.52	1.68%	295.36	1.06%	3.07	0.01%	5.24	0.02%
递延所得税资产	252.07	0.80%	213.61	0.77%	272.56	0.99%	201.32	0.78%
其他非流动资产	-	-	158.36	0.57%	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,092.16</b>	<b>13.02%</b>	<b>3,908.58</b>	<b>14.08%</b>	<b>3,541.46</b>	<b>12.85%</b>	<b>1,833.82</b>	<b>7.12%</b>
<b>资产总计</b>	<b>31,436.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,758.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,563.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,747.60</b>	<b>100.00%</b>

2014年末至2017年3月末，公司总资产规模及资产结构与公司业务模式相匹配。其中，流动资产是公司资产的主要部分，2014年末至2017年3月末流动资产占总资产的比重分别为92.88%、87.15%、85.92%和86.98%，流动资产主要为应收账款、应收票据、存货以及货币资金；非流动资产占总资产的比重分别为7.12%、12.85%、14.08%和13.02%，非流动资产主要为可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产以及无形资产。报告期内，公司流动资产占比较高主要原因系公司采用Fabless经营模式，该等轻资产运营无需大型生产设备及厂房的大额投入，固定资产占比相对较小。

报告期内，公司资产构成及变化情况如下图所示：



2017年3月31日，公司资产构成情况如下图所示：



## （二）各项主要资产分析

### 1、流动资产的构成及变化分析

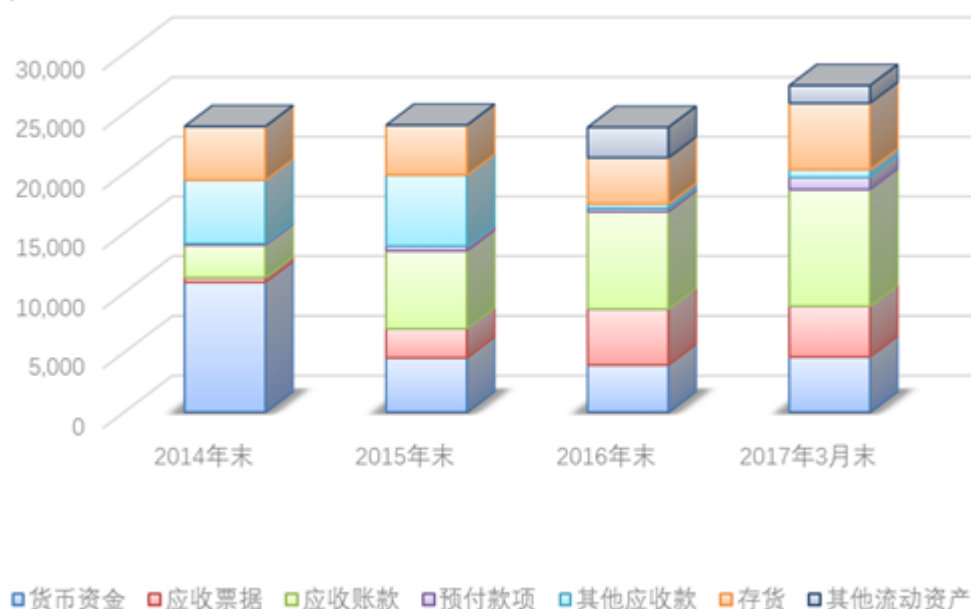
报告期内，公司各项流动资产金额及占比如下：

单位：万元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	4,625.64	16.92%	3,936.10	16.50%	4,538.30	18.89%	10,884.09	45.51%
应收票据	4,240.70	15.51%	4,688.64	19.66%	2,446.04	10.18%	373.83	1.56%
应收账款	9,765.21	35.71%	8,155.78	34.20%	6,506.17	27.08%	2,730.87	11.42%
预付款项	1,015.90	3.72%	270.02	1.13%	411.98	1.72%	126.23	0.53%
其他应收款	663.19	2.43%	382.01	1.60%	5,942.11	24.74%	5,314.02	22.22%
存货	5,560.55	20.34%	3,869.85	16.23%	4,177.08	17.39%	4,484.75	18.75%
其他流动资产	1,473.16	5.39%	2,547.17	10.68%	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>27,344.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>23,849.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,021.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>23,913.78</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司流动资产构成情况如下图所示：

单位：万元



#### （1）货币资金

公司货币资金余额主要为银行存款和其他货币资金，其他货币资金为开具银



行承兑汇票存入的保证金。报告期内，公司货币资金的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行存款	3,188.27	1,485.67	3,802.30	8,591.90
其他货币资金	1,437.37	2,450.43	736.00	2,292.19
<b>合计</b>	<b>4,625.64</b>	<b>3,936.10</b>	<b>4,538.30</b>	<b>10,884.09</b>

2014年末至2017年3月末，公司货币资金余额分别为10,884.09万元、4,538.30万元、3,936.10万元和4,625.64万元，占各期末总资产的比例分别为42.27%、16.47%、14.18%和14.71%。除2015年货币资金余额较2014年下降较大外，公司货币资金余额基本保持稳定。

2015年末，公司货币资金余额较2014年末减少6,345.79万元，主要系：①当期经营性应收项目规模增加较大，导致经营活动现金流量净额为-2,265.85万元；②当期公司投资上海湖杉、上海汉枫以及上海巨微共支付1,700.00万元投资款，导致投资活动现金流量净额为-2,583.29万元。

## （2）应收票据

报告期内，公司应收票据均为银行承兑汇票，具体如下：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	4,240.70	4,688.64	2,446.04	373.83
<b>合计</b>	<b>4,240.70</b>	<b>4,688.64</b>	<b>2,446.04</b>	<b>373.83</b>

2014年末至2017年3月末，公司应收票据分别为373.83万元、2,446.04万元、4,688.64万元及4,240.70万元，应收票据占总资产比例分别为1.45%、8.87%、16.89%及13.49%。报告期内，公司应收票据余额呈现增长趋势，主要原因系随着公司业务规模的扩大以及销售收入的增长，客户以银行承兑汇票进行货款结算的方式有所增加所致。

## （3）应收账款

报告期内，公司应收账款及营业收入变动趋势如下：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款	9,765.21	8,155.78	6,506.17	2,730.87
应收账款同比增幅	-	25.35%	138.25%	-
项目	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
营业收入	15,309.16	57,088.11	35,712.04	33,727.01
营业收入同比增幅	-	59.86%	5.89%	-
应收账款占营业收入比例	63.79%	14.29%	18.22%	8.10%

应收账款与营业收入的比较如下图所示：



2014年末至2017年3月末，公司应收账款净额分别为2,730.87万元、6,506.17万元、8,155.78万元和9,765.21万元，占公司各期末总资产的比重分别为10.61%、23.60%、29.38%和31.06%，占流动资产比重分别为11.42%、27.08%、34.20%和35.71%，占当期营业收入的比重为8.10%、18.22%、14.29%和63.79%。

2015年末，公司应收账款较2014年末增长3,775.30万元，主要原因系2015年11月、12月销售收入同比增幅较大所致。2015年，公司给予大部分经销商的信用期为30天至60天，因此，年末的应收账款多为最后两个月销售形成。2015年11月、12月公司销售收入及波动情况如下：

单位：万元

月份	2015 年度	同比增长 (%)	2014 年度
11 月	3,661.31	38.88%	2,636.32
12 月	4,489.57	114.94%	2,088.79
小计	<b>8,150.88</b>	<b>72.50%</b>	<b>4,725.11</b>
全年销售收入	<b>35,712.04</b>	<b>5.89%</b>	<b>33,727.01</b>

2015 年，公司最后两个月的销售收入较 2014 年同比增长 3,425.78 万元，同比增长率为 72.50%，增幅较大的主要原因为：①2014 年第四季度开始，LED 照明驱动芯片市场竞争加剧，公司部分客户在竞争格局不明朗的情况下减小了驱动芯片的对外采购数量，使得公司第四季度出货量相对较小；②2015 年第四季度，随着行业竞争的逐步稳定，公司凭借着稳定的产品质量及产品技术的更新升级，在保持原有的市场份额基础上获取了更多的市场份额，进一步扩大了公司的销售，使得当期出货量大幅上升。

2016 年末，公司应收账款较 2015 年末增长 25.35%，主要原因系当期销售收入大幅上升所致。公司当期营业收入较上年同比增长 59.86%，当期应收账款回款情况良好。

公司与同行业上市公司应收账款占营业收入的比例对比情况如下：

单位：万元

名称	项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
士兰微	应收账款	64,163.40	61,431.10	54,011.80	50,852.20
	营业收入	58,889.20	237,505.00	192,641.00	187,003.00
	应收账款占营业收入比例	109.00%	25.86%	28.04%	27.19%
圣邦股份	应收账款	-	3,718.55	2,632.90	1,648.61
	营业收入	-	45,196.19	39,445.30	32,591.47
	应收账款占营业收入比例	-	8.23%	6.67%	5.06%
富满电子	应收账款	-	13,284.48	9,616.65	8,663.95
	营业收入	-	32,964.28	27,322.92	25,565.63
	应收账款占营业收入比例	-	40.30%	35.20%	33.89%

应收账款占营业收入 比例的平均值		109.00%	24.80%	23.30%	22.05%
晶丰明源	应收账款	9,765.21	8,155.78	6,506.17	2,730.87
	营业收入	15,309.16	57,088.11	35,712.04	33,727.01
	应收账款占营业 收入比例	63.79%	14.29%	18.22%	8.10%

注：上表可比公司数据来源于其招股说明书或其披露的年报数据。

报告期内，公司应收账款占营业收入的比例均低于同行业上市公司平均水平，公司应收账款回收质量较好。

报告期内公司应收账款账龄分布情况如下：

单位：万元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	余额	比例	余额	比例	余额	比例	余额	比例
半年以内	9,849.20	99.85%	8,220.97	99.74%	6,478.09	98.51%	2,716.39	98.40%
半年至1年以内	15.27	0.15%	1.07	0.01%	97.75	1.49%	42.20	1.53%
1年至2年	-	-	20.00	0.24%	-	-	1.94	0.07%
<b>合计</b>	<b>9,864.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,242.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,575.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,760.53</b>	<b>100.00%</b>

2014年末至2017年3月末，公司应收账款账面余额分别为2,760.53万元、6,575.84万元、8,242.05万元和9,864.47万元，其中半年以内的应收账款占比分别为98.40%、98.51%、99.74%和99.85%，公司应收账款主要为半年以内的应收款项，公司应收账款的质量较高。

报告期内，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：万元

时间	客户	应收账款余额	占应收账款余额 比例（%）
2017年 3月31日	深圳市暗能量电源有限公司	1,254.32	12.72
	广州晶丰电子科技有限公司	1,022.22	10.36
	上海迎霄电子有限公司	1,018.58	10.33
	厦门欣友联电子科技有限公司	980.93	9.94
	上海元捷电子科技有限公司	903.32	9.16
	<b>小计</b>	<b>5,179.38</b>	<b>52.51</b>

2016年 12月31日	厦门欣友联电子科技有限公司	1,567.29	19.02
	上海元捷电子科技有限公司	1,201.79	14.58
	深圳市暗能量电源有限公司	1,138.09	13.81
	上海迎霄电子有限公司	924.59	11.22
	广州晶丰电子科技有限公司	810.08	9.83
	<b>小计</b>	<b>5,641.83</b>	<b>68.46</b>
2015年 12月31日	厦门欣友联电子科技有限公司	1,465.00	22.28
	深圳市暗能量电源有限公司	805.70	12.25
	上海迎霄电子有限公司	673.07	10.24
	上海元捷电子科技有限公司	558.32	8.49
	广州晶丰电子科技有限公司	539.52	8.20
	<b>小计</b>	<b>4,041.61</b>	<b>61.46</b>
2014年 12月31日	深圳市暗能量电源有限公司	1,003.43	36.35
	厦门欣友联电子科技有限公司	299.28	10.84
	宁波凯耀电器制造有限公司	266.36	9.65
	佛山市顺德智晶源电子有限公司	251.91	9.13
	上海元捷电子科技有限公司	247.15	8.95
	<b>小计</b>	<b>2,068.14</b>	<b>74.92</b>

#### （4）预付款项

报告期内，公司预付款项余额分别为 126.23 万元、411.98 万元、270.02 万元和 1,015.90 万元，占公司各期末总资产的比重分别为 0.49%、1.49%、0.97%和 3.23%。公司预付款项主要为预付材料采购款、预付房屋租赁费以及预付费用款等。2017 年 3 月末，公司预付款项相对较大，主要原因系随着公司业务规模的扩大以及销售收入的增长，公司预付当期新引进的晶圆代工厂中芯国际材料采购款以及预付其他材料采购款较多所致。

#### （5）其他应收款

报告期内，公司其他应收款余额分别为 5,314.02 万元、5,942.11 万元、382.01 万元和 663.19 万元。公司其他应收款主要为保证金与押金、暂借款等。具体情况如下：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
保证金与押金	630.48	348.10	58.27	235.30
出口退税款	-	-	2.36	11.33
员工备用金	29.95	30.89	12.77	40.39
暂借款	-	-	5,850.70	5,026.62
其他	2.76	3.02	18.01	0.38
<b>合计</b>	<b>663.19</b>	<b>382.01</b>	<b>5,942.11</b>	<b>5,314.02</b>

2014年末、2015年末，公司其他应收款账面余额较大，主要系应收关联方和非关联方暂借款。上述暂借款的相关情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易情况”。公司已对报告期内存在的资金拆借进行了清理，截至报告期末，其他应收款中暂借款已清理完毕。

#### （6）存货

报告期内，公司各期末存货的账面价值具体情况如下：

单位：万元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	633.75	11.40%	597.09	15.43%	597.96	14.32%	361.14	8.05%
委托加工物资	3,131.99	56.33%	2,472.07	63.88%	2,011.00	48.14%	2,707.46	60.37%
产成品	1,107.83	19.92%	775.21	20.03%	1,473.13	35.27%	1,416.14	31.58%
发出商品	686.97	12.35%	25.48	0.66%	95.00	2.27%	-	-
<b>合计</b>	<b>5,560.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,869.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,177.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,484.75</b>	<b>100.00%</b>

2014年末至2017年3月末，公司存货的账面价值分别为4,484.75万元、4,177.08万元、3,869.85万元和5,560.55万元，占总资产的比例分别为17.42%、15.15%、13.94%和17.69%。公司专注于集成电路设计，采用Fabless经营模式，不直接从事芯片的生产，生产制造环节均以委外方式完成，因此，从存货结构来看，委托加工物资是公司存货的主要组成部分，占存货账面价值的比例分别为60.37%、48.14%、63.88%和56.33%，符合公司实际经营情况。

报告期内，公司按照存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备，具体计提及转销情况如下：

单位：万元

2017年1-3月				
项目	期初数	本期计提	转销或转回	期末数
原材料	2.94	0.10	2.94	0.10
委托加工物资	24.83	6.22	23.84	7.21
产成品	26.37	8.28	1.96	32.69
<b>合计</b>	<b>54.14</b>	<b>14.60</b>	<b>52.34</b>	<b>39.99</b>
2016年				
项目	期初数	本期计提	转销或转回	期末数
原材料	1.22	2.94	1.22	2.94
委托加工物资	75.10	15.93	66.19	24.83
产成品	83.94	6.87	64.44	26.37
发出商品	0.68	-	0.68	-
<b>合计</b>	<b>160.94</b>	<b>25.73</b>	<b>132.53</b>	<b>54.14</b>
2015年				
项目	期初数	本期计提	转销或转回	期末数
原材料	0.69	0.53	-	1.22
委托加工物资	20.06	56.57	1.53	75.10
产成品	20.32	81.88	18.26	83.94
发出商品	-	0.68	-	0.68
<b>合计</b>	<b>41.07</b>	<b>139.67</b>	<b>19.79</b>	<b>160.94</b>
2014年				
项目	期初数	本期计提	转销或转回	期末数
原材料	3.62	0.69	3.62	0.69
委托加工物资	0.79	20.06	0.79	20.06
产成品	7.60	14.32	1.59	20.32
发出商品	6.36	-	6.36	-
<b>合计</b>	<b>18.38</b>	<b>35.06</b>	<b>12.37</b>	<b>41.07</b>

公司按照资产减值准备政策的规定以及各项资产的实际情况，足额地计提了各项资产减值准备。2014年末至2017年3月末，公司存货跌价准备余额分别为41.07万元、160.94万元、54.14万元和39.99万元。2015年，由于产品技术升级，公司对于部分老型号产品及相应原材料计提了跌价准备。

#### （7）其他流动资产

2016年末、2017年3月末，公司其他流动资产的余额分别为2,547.17万元、1,473.16万元，公司其他流动资产系购买的银行理财产品、IPO中介服务费及预缴增值税。

## 2、非流动资产构成及变化分析

报告期内，公司非流动资产构成情况如下：

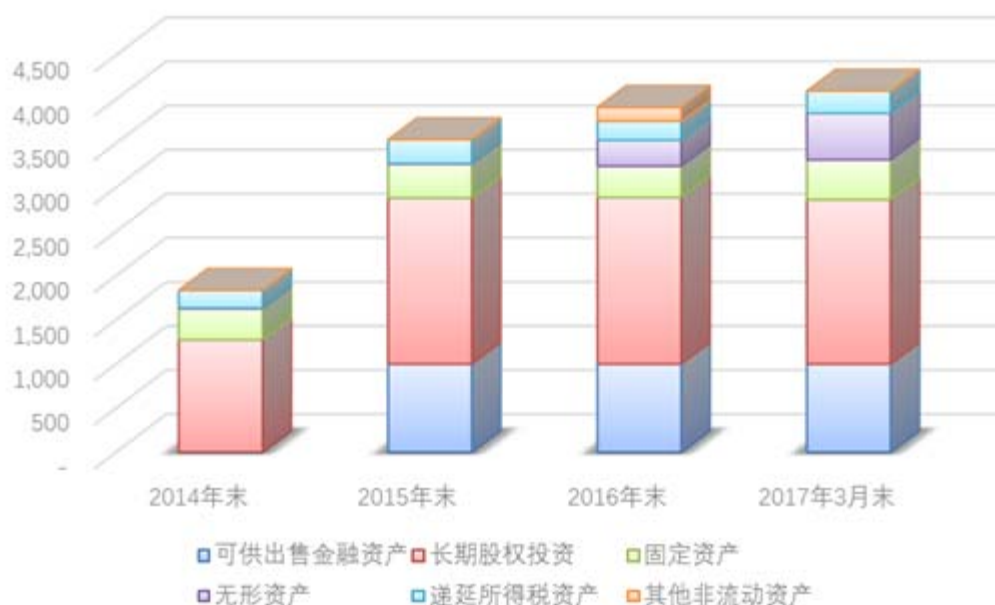
单位：万元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
可供出售金融资产	1,000.00	24.44%	1,000.00	25.58%	1,000.00	28.24%	-	-
长期股权投资	1,862.50	45.51%	1,886.68	48.27%	1,879.26	53.06%	1,273.08	69.42%
固定资产	450.07	11.00%	354.57	9.07%	386.57	10.92%	354.18	19.31%
无形资产	527.52	12.89%	295.36	7.56%	3.07	0.09%	5.24	0.29%
递延所得税资产	252.07	6.16%	213.61	5.47%	272.56	7.70%	201.32	10.98%
其他非流动资产	-	-	158.36	4.05%	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,092.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,908.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,541.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,833.82</b>	<b>100.00%</b>

2014年末至2017年3月末，公司非流动资产分别为1,833.82万元、3,541.46万元、3,908.58万元和4,092.16万元，占总资产的比重分别为7.12%、12.85%、14.08%和13.02%。



单位：万元



公司非流动资产主要由长期股权投资、可供出售金融资产、固定资产、无形资产等构成。

#### (1) 可供出售金融资产

2015年末至2017年3月末，公司各期末可供出售金融资产均系对上海湖杉的投资，公司持有上海湖杉20.00%出资份额，且为有限合伙人，计入“可供出售金融资产”核算。

#### (2) 长期股权投资

报告期内，公司长期股权投资账面价值分别为1,273.08万元、1,879.26万元、1,886.68万元和1,862.50万元，占非流动资产的比重分别为69.42%、53.06%、48.27%和45.51%。公司长期股权投资为对参股公司上海汉枫、上海巨微以及上海兴工微的投资。

#### (3) 固定资产

2014年末至2017年3月末，公司固定资产账面价值分别为354.18万元、386.57万元、354.57万元和450.07万元，包括办公设备、机器设备、计算机与电子设备、运输设备，具体如下：

单位：万元

项目	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
办公设备	72.22	77.68	88.51	73.54
机器设备	155.68	160.91	161.13	212.29
电子设备	60.47	60.44	67.84	59.53
运输设备	161.70	55.55	69.09	8.82
合计	<b>450.07</b>	<b>354.57</b>	<b>386.57</b>	<b>354.18</b>

报告期内，公司固定资产占总资产的比例分别为 1.38%、1.40%、1.28%和 1.43%，比例较小，主要原因为①公司采取轻资产运营的 Fabless 模式，自身不直接从事产品的生产制造。②公司主要经营场所系通过租赁方式取得。

公司资产状况良好，不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，未计提减值准备。

#### （4）无形资产

报告期内，公司无形资产主要包括软件使用权、专用技术以及专利权等。2014年末至2017年3月末，公司无形资产账面价值分别为5.24万元、3.07万元、295.36万元和527.52万元，占非流动资产的比重分别为0.29%、0.09%、7.56%和12.89%。2016年末，公司无形资产增加主要系公司收购了岷创科技的部分专利技术所致。2017年3月末，无形资产增加主要系公司更新ERP系统所致。

#### （5）递延所得税资产

单位：万元

项目	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
资产减值准备	20.93	21.06	34.59	7.07
收入、成本、费用等与税法规定的暂时性差异	96.99	100.20	185.33	172.03
预计负债	134.15	92.35	52.65	22.22
合计	<b>252.07</b>	<b>213.61</b>	<b>272.56</b>	<b>201.32</b>

2014年末至2017年3月末，公司递延所得税资产分别为201.32万元、272.56万元、213.61万元和252.07万元。各期末递延所得税资产主要系公司计提资产减值准备以及收入、成本、费用等与税法规定的暂时性差异形成。

### （三）资产减值准备提取情况

报告期内，公司主要资产减值准备的明细情况如下：

单位：万元

项目	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
应收账款坏账准备	99.26	86.26	69.67	29.66
存货跌价准备	39.99	54.14	160.94	41.07
合计	<b>139.25</b>	<b>140.40</b>	<b>230.61</b>	<b>70.73</b>

公司对应收款项余额前五名应收款项作为报告期内单项金额重大的标准，针对该部分应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。对于具有类似信用风险特征相同账龄的应收款项，公司依据账龄分析法按组合计提坏账准备。对于其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

此外，公司按照制定的减值准备提取政策和谨慎性要求，对存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等进行了核查，除存货外上述资产均不存在减值情况。公司2014年、2015年、2016年和2017年一季度分别计提了41.07万元、160.94万元、54.14万元和39.99万元的存货跌价准备。2015年，公司存货跌价准备计提金额相对较大，主要原因系2015年末公司进行技术升级导致部分老型号产品及对应的原材料、半成品出现减值迹象所致。

综上，公司已按照《企业会计准则》制定各项资产减值准备计提的政策，严格按照公司制定的会计政策计提各项减值准备，公司计提的各项资产减值准备是公允和稳健的，各项资产减值准备提取情况与资产质量实际状况相符。

### （四）负债的构成及其变化

#### 1、总体负债的构成及其变化情况

2014年末至2017年3月末，公司总体负债的构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付票据	2,757.92	15.63%	4,541.19	25.48%	1,375.00	17.78%	2,817.19	33.33%
应付账款	11,597.57	65.71%	9,262.82	51.96%	4,382.64	56.69%	3,235.29	38.28%
预收款项	162.81	0.92%	254.85	1.43%	283.93	3.67%	370.85	4.39%
应付职工薪酬	331.86	1.88%	722.30	4.05%	326.65	4.23%	179.83	2.13%
应交税费	137.58	0.78%	943.51	5.29%	706.81	9.14%	1,318.13	15.60%
其他应付款	1,338.27	7.58%	1,402.91	7.87%	178.56	2.31%	169.65	2.01%
一年内到期的非流动负债	-	-	25.83	0.14%	31.00	0.40%	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>16,326.01</b>	<b>92.50%</b>	<b>17,153.41</b>	<b>96.23%</b>	<b>7,284.59</b>	<b>94.22%</b>	<b>8,090.94</b>	<b>95.74%</b>
长期应付款	-	-	-	-	25.83	0.33%	-	-
预计负债	894.36	5.07%	615.63	3.45%	350.97	4.54%	222.21	2.63%
递延收益	420.80	2.38%	52.00	0.29%	70.00	0.91%	138.00	1.63%
递延所得税负债	7.72	0.04%	4.15	0.02%	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,322.88</b>	<b>7.50%</b>	<b>671.78</b>	<b>3.77%</b>	<b>446.80</b>	<b>5.78%</b>	<b>360.21</b>	<b>4.26%</b>
<b>负债合计</b>	<b>17,648.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,825.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,731.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,451.15</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司负债主要为流动负债，2014年末至2017年3月末，流动负债占负债的比例分别为95.74%、94.22%、96.23%和92.50%，流动负债占比总体保持稳定。

## 2、流动负债的构成及其变化分析

报告期内，公司流动负债构成情况如下：

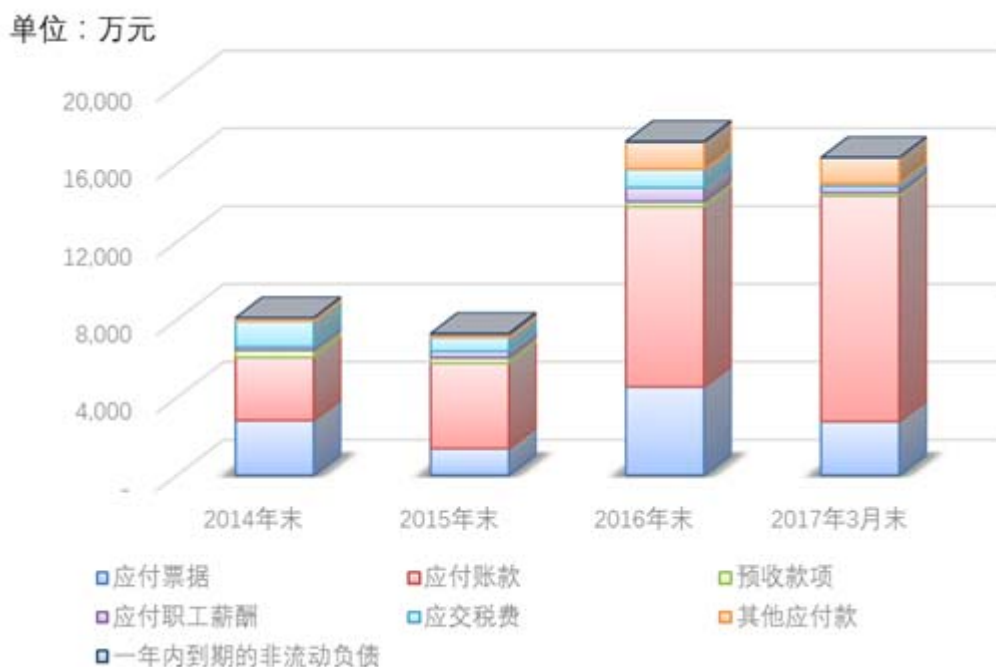
单位：万元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付票据	2,757.92	16.89%	4,541.19	26.47%	1,375.00	18.88%	2,817.19	34.82%
应付账款	11,597.57	71.04%	9,262.82	54.00%	4,382.64	60.16%	3,235.29	39.99%
预收款项	162.81	1.00%	254.85	1.49%	283.93	3.90%	370.85	4.58%
应付职工薪酬	331.86	2.03%	722.30	4.21%	326.65	4.48%	179.83	2.22%
应交税费	137.58	0.84%	943.51	5.50%	706.81	9.70%	1,318.13	16.29%
其他应付款	1,338.27	8.20%	1,402.91	8.18%	178.56	2.45%	169.65	2.10%
一年内到期的非	-	-	25.83	0.15%	31.00	0.43%	-	-

流动负债								
流动负债合计	16,326.01	100.00%	17,153.41	100.00%	7,284.59	100.00%	8,090.94	100.00%

2014年末至2017年3月末，公司流动负债分别为8,090.94万元、7,284.59万元、17,153.41万元和16,326.01万元，公司流动负债主要由应付票据、应付账款、其他应付款等构成。其中2016年末、2017年3月末公司流动负债金额较大，主要原因系当期订单需求旺盛，公司采购大幅增加，使得当期应付账款、应付票据大幅增加所致。

报告期内，公司流动负债变动情况如下图所示：



#### (1) 应付票据

2014年末至2017年3月末，公司应付票据金额分别为2,817.19万元、1,375.00万元、4,541.19万元和2,757.92万元，主要系为利用商业信用、加强资金使用效率，公司利用银行承兑汇票进行货款结算所致。

#### (2) 应付账款

2014年末至2017年3月末，公司应付账款分别为3,235.29万元、4,382.64万元、9,262.82万元和11,597.57万元，占流动负债的比例分别为39.99%、60.16%、54.00%和71.04%。公司应付账款主要为应付晶圆、副芯片（MOS）货款和委外

加工款。报告期内各期末公司应付账款余额总体呈现增长趋势，主要原因系：①随着公司销售规模的扩大，原材料耗用和委外生产规模相应增加；②随着与供应商合作关系的深入以及采购规模的扩大，部分供应商放款对公司的销售政策，延长对公司信用期，使得期末应付账款增长较快。

### （3）预收款项

2014年末至2017年3月末，公司预收款项分别为370.85万元、283.93万元、254.85万元和162.81万元，占流动负债的比例分别为4.58%、3.90%、1.49%和1.00%。公司预收款项主要为向客户收取的货款，在公司流动负债中金额较小，占比较低。

### （4）应付职工薪酬

2014年末至2017年3月末，公司应付职工薪酬分别为179.83万元、326.65万元、722.30万元和331.86万元，占流动负债的比例分别为2.22%、4.48%、4.21%和2.03%。报告期期末公司应付职工薪酬主要系已计提但尚未发放的年终奖，年终奖计提数随着员工人数增加、薪酬水平提高等因素呈现逐年上升趋势。

### （5）应交税费

报告期内，公司各期末应交税费构成如下：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	-	474.25	469.56	246.70
企业所得税	77.81	399.45	120.85	956.70
个人所得税	38.15	32.16	83.90	107.20
城市维护建设税	3.09	5.38	4.64	1.08
教育费附加	15.44	26.90	23.22	5.38
河道管理费	3.09	5.38	4.64	1.08
<b>合计</b>	<b>137.58</b>	<b>943.51</b>	<b>706.81</b>	<b>1,318.13</b>

2014年末至2017年3月末，公司应交税费分别为1,318.13万元、706.81万元、943.51万元和137.58万元，占流动负债的比例分别为16.29%、9.70%和5.50%和0.84%。公司各期末应交税费主要为应交增值税及应交企业所得税。

## （6）其他应付款

2014年末至2017年3月末，公司其他应付款分别为169.65万元、178.56万元、1,402.91万元和1,338.27万元，占流动负债的比例为2.10%、2.45%、8.18%和8.20%。2016年末、2017年3月末，公司其他应付款金额较大，主要原因系公司对持有上海湖杉20%的出资份额进行转让，在转让完成前将已收到的股权转让款在“其他应付款”中核算。

## 3、非流动负债的构成及其变化分析

报告期内，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期应付款	-	-	-	-	25.83	5.78%	-	-
预计负债	894.36	67.61%	615.63	91.64%	350.97	78.55%	222.21	61.69%
递延收益	420.80	31.81%	52.00	7.74%	70.00	15.67%	138.00	38.31%
递延所得税负债	7.72	0.58%	4.15	0.62%	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,322.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>671.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>446.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>360.21</b>	<b>100.00%</b>

2014年末至2017年3月末，公司非流动负债余额分别为360.21万元、446.80万元及671.78万元和1,322.88万元，主要由预计负债和需递延确认的政府补助款构成。报告期内，预计负债系公司计提的尚未与经销商结算的商业折扣。

## （五）偿债能力分析

### 1、偿债能力指标

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

指标	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
流动比率	1.67	1.39	3.30	2.96
速动比率	1.33	1.16	2.72	2.40
资产负债率（母公司）	56.14%	64.16%	28.05%	32.82%
指标	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年

息税折旧摊销前利润（万元）	1,377.11	3,696.59	2,128.48	7,703.86
利息保障倍数	-	40.09	35.86	2,735.28

## 2、公司偿债能力与同行业上市公司的比较分析

时间	指标	士兰微	圣邦股份	富满电子	平均值	中值	晶丰明源
2017年3月31日	流动比率	1.67	-	-	-	-	1.67
	速动比率	1.22	-	-	-	-	1.33
	资产负债率（合并）	40.17%	-	-	-	-	56.14%
2016年12月31日	流动比率	1.65	3.87	2.11	2.54	2.11	1.39
	速动比率	1.24	3.25	1.28	1.92	1.28	1.16
	资产负债率（合并）	39.18%	32.97%	40.12%	37.42%	39.18%	64.22%
2015年12月31日	流动比率	1.49	3.78	2.28	2.52	2.28	3.30
	速动比率	1.01	3.10	1.07	1.73	1.07	2.72
	资产负债率（合并）	44.28%	33.10%	35.94%	37.77%	35.94%	28.05%
2014年12月31日	流动比率	1.81	3.52	2.02	2.45	2.02	2.96
	速动比率	1.28	2.74	0.96	1.66	1.28	2.40
	资产负债率（合并）	39.89%	33.56%	38.27%	37.24%	38.27%	32.82%

## 3、偿债能力分析

2014年末、2015年末，公司流动比率、速动比率、资产负债率均优于行业平均水平，反映了公司良好的偿债能力；2016年末，公司流动比率、速动比率、资产负债率未达行业平均水平，主要原因为：①流动负债大幅增加。随着产品销量及业务规模的快速扩大，原材料及委外加工的采购量也相应大幅增加，从而导致期末应付账款、应付票据较2015年末分别增长4,880.18万元和3,166.19万元。②2016年度共实施现金分红14,384.08万元，使得公司在业务规模快速增长的同时总资产规模并未实现大幅上升。

## （六）资产经营效率分析

### 1、资产经营效率指标

报告期内，公司存货周转率、应收账款周转率如下：



指标	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
存货周转率	2.54	11.24	6.57	6.20
应收账款周转率	1.71	7.79	7.73	13.28

## 2、公司资产运营效率指标与同行业上市公司的比较

公司与同行业上市公司近三年存货周转率、应收账款周转率比较情况如下：

时间	指标	士兰微	圣邦股份	富满电子	平均值	中值	晶丰明源
2017年 1-3月	存货周转率	0.69	-	-	-	-	2.54
	应收账款周转率	0.94	-	-	-	-	1.71
2016年	存货周转率	2.66	4.81	1.70	3.06	2.66	11.24
	应收账款周转率	4.11	14.09	2.70	6.97	4.11	7.79
2015年	存货周转率	2.03	4.18	1.44	2.55	2.03	6.57
	应收账款周转率	3.67	18.24	2.80	8.24	3.67	7.73
2014年	存货周转率	2.24	4.10	1.78	2.71	2.24	6.20
	应收账款周转率	3.84	16.52	3.07	7.81	3.84	13.28

2014年至2017年3月末，公司存货周转率分别为6.20、6.57、11.24和2.54，高于同行业上市公司平均水平，公司存货周转状况良好。

2014年至2017年3月末，公司应收账款周转率分别为13.28、7.73、7.79和1.71，与同行业上市公司平均水平基本相当。从应收账款质量来看，公司账龄在半年以内的应收账款占比达95%以上，应收账款回收质量较好。

## 二、盈利能力分析

### （一）利润的主要来源分析

报告期内，公司利润的主要来源情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利	3,333.18	99.87%	11,524.84	97.14%	7,145.50	98.62%	11,660.72	99.93%
其他业务毛利	4.20	0.13%	338.78	2.86%	99.72	1.38%	7.68	0.07%
<b>合计</b>	<b>3,337.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,863.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,245.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,668.39</b>	<b>100.00%</b>

公司主要从事 LED 照明驱动芯片的研发和销售业务，报告期内，公司利润主要来源于 LED 照明驱动芯片。2014 年至 2017 年 3 月末，公司主营业务毛利分别为 11,660.72 万元、7,145.50 万元、11,524.84 万元和 3,333.18 万元，占比分别为 99.93%、98.62%、97.14%和 99.87%，公司主营业务盈利能力突出。

从产品来看，公司营业毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
通用 LED 照明驱动芯片	2,134.60	63.96%	7,556.93	63.70%	5,344.33	73.76%	11,660.72	99.93%
智能 LED 照明驱动芯片	1,063.60	31.87%	3,701.45	31.20%	1,705.14	23.53%		0.00%
其他	134.98	4.04%	266.47	2.25%	96.03	1.33%	0.00	0.00%
主营业务毛利	3,333.18	99.87%	11,524.84	97.14%	7,145.50	98.62%	11,660.72	99.93%
其他业务毛利	4.20	0.13%	338.78	2.86%	99.72	1.38%	7.68	0.07%
<b>合计</b>	<b>3,337.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,863.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,245.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,668.39</b>	<b>100.00%</b>

公司营业毛利主要来源于 LED 照明驱动芯片，2014 年至 2017 年 1-3 月，公司 LED 驱动芯片毛利占毛利总额的比重分别为 99.93%、98.62%、97.14%和 99.87%。

2015 年，公司营业毛利较 2014 年降低了 4,423.17 万元，主要原因系在下游 LED 照明行业出现价格战的特殊市场环境下，公司采取了压缩产品销售毛利率等针对性销售策略，使得当期毛利下降。自 2016 年开始，随着下游行业竞争格局的逐步稳定，公司营业毛利逐步提升。

## （二）营业收入构成及变动分析

### 1、营业收入结构分析

报告期内，公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，具体如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	15,304.96	99.97%	56,749.33	99.41%	35,612.31	99.72%	33,719.34	99.98%
其他业务收入	4.20	0.03%	338.78	0.59%	99.72	0.28%	7.68	0.02%
合计	<b>15,309.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,088.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,712.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,727.01</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司营业收入主要由主营业务收入构成。2014年至2017年3月末，公司主营业务收入分别为33,719.34万元、35,612.31万元、56,749.33万元和15,304.96万元，占营业收入的比例分别为99.98%、99.72%、99.41%和99.97%。

2016年，公司营业收入较2015年实现了大幅增长，主要原因包括：

①LED照明产品市场内生性增长需求：随着近年来LED照明产品与传统照明产品的价差逐步缩小，凭借低耗能、寿命长、发光效率高、环保等特性，LED产品逐渐替代传统照明产品，市场渗透率不断上升。2016年，我国LED照明产品国内销量较2015年同比增长35%。LED照明产品带动了对LED照明驱动芯片的需求量，是公司2016年营业收入快速增长的原因之一。

②公司市场占有率的提升：公司凭借着稳定的产品质量和领先的技术性能，在LED照明驱动芯片细分市场建立了独特的竞争优势。公司利用2015年下游行业市场波动及所在行业集中度提升的有利时机，通过针对性的销售策略和及时的技术升级，扩大了市场占有率。2016年，公司通用及智能LED照明芯片出货量分别达到214,548.01万粒和20,951.17万粒，较2015年同比增长94.36%、107.26%，增速超过LED照明产品市场增长率，市场占有率提升。

报告期内，公司其他业务收入金额较小，对经营业绩影响较小。

#### （1）主营业务收入构成分析

##### 1) 按产品分类

报告期内，公司主营业务收入按产品分类构成情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年		2014年	
	收入	比例	收入	比例	收入	比例	收入	比例
通用LED照明驱动芯片	12,350.42	80.70%	47,232.06	83.23%	30,857.68	86.65%	33,719.34	100.00%
智能LED照明驱动芯片	2,508.51	16.39%	7,909.19	13.94%	3,870.51	10.87%	-	-
其他	446.03	2.91%	1,608.08	2.83%	884.12	2.48%	-	-
<b>合计</b>	<b>15,304.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>56,749.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,612.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,719.34</b>	<b>100.00%</b>

公司分产品收入结构中，2014年至2017年1-3月，通用LED照明驱动芯片营业收入占比分别为100.00%、86.65%、83.23%和80.70%，是公司营业收入最主要的来源；智能LED照明驱动芯片自2015年起销售，2015年至2017年1-3月的营业收入占比分别为10.87%、13.94%和16.39%，智能LED照明驱动芯片销售收入及其占营业收入比例持续、稳定上升。

## 2) 按地区分类

报告期内，公司主营业务收入按地区分类构成情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年		2014年	
	收入	比例	收入	比例	收入	比例	收入	比例
内销	14,713.55	96.14%	55,087.98	97.07%	34,615.05	97.20%	31,723.18	94.08%
外销	591.41	3.86%	1,661.35	2.93%	997.26	2.80%	1,996.15	5.92%
<b>合计</b>	<b>15,304.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>56,749.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,612.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,719.34</b>	<b>100.00%</b>

2014年至2017年1-3月，公司内销收入占比分别为94.08%、97.20%、97.07%和96.14%，外销收入占比分别为5.92%、2.80%、2.93%和3.86%。报告期内，公司以内销销售为主。

## 3) 按销售模式分类

报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年		2014年	
	收入	比例	收入	比例	收入	比例	收入	比例
经销	12,636.73	82.57%	45,242.94	79.72%	28,446.63	79.88%	23,103.30	68.52%
直销	2,668.22	17.43%	11,506.39	20.28%	7,165.69	20.12%	10,616.04	31.48%
合计	<b>15,304.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>56,749.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,612.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,719.34</b>	<b>100.00%</b>

2014年至2017年1-3月，公司经销业务收入分别为23,103.30万元、28,446.63万元、45,242.94万元和12,636.73万元，占主营业务收入的比重分别为68.52%、79.88%、79.72%和82.57%。报告期内，公司主营业务收入以经销为主、直销为辅。

经销模式是半导体芯片设计行业内较为常见的销售模式，芯片设计行业内企业较多采用Fabless经营模式，一般具有规模相对较小，产品种类较多的特点。经销模式可以帮助芯片设计企业快速地建立销售渠道、扩大市场份额，实现产品和资金的较快周转，节省了公司的资金及资源投入，有利于芯片设计企业将主要精力投入到产品研发及供应链管控环节，快速做大做强，因此被行业内诸多企业采用。同时，公司合作经销商一般深耕区域市场多年，与区域内客户关系密切。采用经销模式可以帮助公司更好地对中小客户进行有效管理，快速响应市场变化，更好的满足市场需求。同时也可以为公司带来更多的客户资源，提高公司资金的周转速度。因此，公司采用经销为主、直销为辅的销售模式，符合集成电路设计行业销售的一般性特点。

## 2、营业收入变动分析

报告期内，公司主要产品营业收入变动情况如下：

项目		营业收入 (万元)	同比 增长	销售数量 (万粒)	同比 增长	平均单价 (元/粒)	同比 增长
2017年 1-3月	通用LED照明 驱动芯片	12,350.42	-	55,386.26	-	0.22	1.29%
	智能LED照明 驱动芯片	2,508.51	-	7,127.97	-	0.35	-6.78%
2016年	通用LED照明 驱动芯片	47,232.06	53.06%	214,548.01	94.36%	0.22	-21.25%

	智能 LED 照明驱动芯片	7,909.19	104.34%	20,951.17	107.26%	0.38	-1.40%
2015 年	通用 LED 照明驱动芯片	30,857.68	-8.49%	110,388.38	33.33%	0.28	-31.36%
	智能 LED 照明驱动芯片	3,870.51	-	10,108.81	-	0.38	-
2014 年	通用 LED 照明驱动芯片	33,719.34	-	82,794.83	-	0.41	-
	智能 LED 照明驱动芯片	-	-	-	-	-	-

分产品具体分析如下：

#### （1）通用 LED 照明驱动芯片

2014 年至 2017 年 1-3 月，公司通用 LED 照明驱动芯片营业收入分别为 33,719.34 万元、30,857.68 万元、47,232.06 万元和 12,350.42 万元，2015 年和 2016 年分别较上年同期增长-8.49%和 53.06%。

报告期内，通用 LED 照明驱动芯片销售量和销售价格变动对公司营业收入影响如下：

项目	2017 年 1-3 月	2016 年	2015 年	2014 年
销售收入（万元）	12,350.42	47,232.06	30,857.68	33,719.34
销售量（万粒）	55,386.26	214,548.01	110,388.38	82,795
销售量增加对营业收入的贡献（万元）	-	29,116.51	11,237.85	-
平均销售价格（元/粒）	0.22	0.22	0.28	0.41
销售价格增加对营业收入的贡献（万元）	-	-12,742.14	-14,099.51	-
<b>累计贡献（万元）</b>	-	<b>16,374.38</b>	<b>-2,861.66</b>	-

2015 年，公司通用 LED 照明驱动芯片销售收入较 2014 年下降 8.49%，销售数量较 2014 年增长 33.33%，销售单价较 2014 年下降 31.36%。销售单价下降是当年该产品销售收入下降的主要原因。

2015 年，公司在下游 LED 照明行业出现价格战的特殊市场环境下，采取了压缩产品销售毛利率、加快成本较低的单芯片产品推广力度等针对性销售策略，增加大客户对公司产品的依存度及采购占比，主动开拓因行业集中度提升带来的

业务机会，当年销售数量实现快速增长，但同时导致通用 LED 照明驱动芯片单价及毛利率下滑。

2016 年，公司通用 LED 照明驱动芯片销售收入较 2015 年上升 53.06%，销售数量较 2015 年增长 94.36%，销售单价较 2015 年下降 21.25%。销售数量上升是当年该产品销售收入上升的主要原因。

2016 年，公司下游 LED 照明行业在经历 2015 年价格战后，行业集中度上升，竞争格局得以改善。LED 照明产品的内生性增长需求促使行业在价格战过后快速回暖，公司产品的需求量得以进一步提升。同时，公司于 2015 年的针对性销售策略取得良好的成效，提高了销售覆盖范围，进一步提升了市场占有率。

## （2）智能 LED 照明驱动芯片

智能 LED 照明驱动芯片区别于通用照明，可以更智能化的感知周围环境，继而调节产品性能。日趋复杂的照明场景对 LED 照明驱动芯片智能化提出了更高的要求，为了贴合市场需求的转变趋势，公司自 2015 年起加大了对智能 LED 照明驱动芯片产品的研发力度并实现销售。智能 LED 照明驱动芯片的推出，丰富和完善了公司的产品线，提高了公司产品的技术附加值，巩固了公司在行业中的竞争优势地位。

2015 年至 2017 年 1-3 月，公司智能 LED 照明驱动芯片营业收入分别为 3,870.51 万元、7,909.19 万元和 2,508.51 万元，2015 年和 2016 年分别较上年同期增长 100.00%和 104.34%。

报告期内，智能 LED 照明驱动芯片销售量和销售价格变动对公司营业收入影响如下：

项目	2017 年 1-3 月	2016 年	2015 年	2014 年
销售收入（万元）	2,508.51	7,909.19	3,870.51	-
销售量（万粒）	7,127.97	20,951.17	10,108.81	-
销售量增加对营业收入的贡献（万元）	-	4,151.38	-	-
平均销售价格（元/粒）	0.35	0.38	0.38	-
销售价格增加对营业收入的贡献（万元）	-	-112.70	-	-

累计贡献（万元）	-	4,038.68	-	-
----------	---	----------	---	---

公司智能 LED 照明驱动芯片自 2015 年起实现销售。2016 年，公司在原有通用产品的基础上加大了智能产品的推广力度，进一步扩大产品的应用领域，优化产品性能，使得当期智能 LED 照明驱动芯片的销量及销售收入较 2015 年均实现了大幅增长，当期销售量增加对营业收入增长的贡献为 4,151.38 万元。

### 3、其他业务收入分析

2014 年至 2017 年 1-3 月，公司其他业务收入分别为 7.68 万元、99.72 万元、338.78 万元和 4.20 万元，占营业收入的比重分别为 0.02%、0.28%、0.59%和 0.03%。报告期内，公司其他业务收入占营业收入的比重较低，对经营业绩的影响较小。

### （三）利润表项目逐项分析

报告期内，公司营业收入、营业成本及利润情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年		2015年		2014年
	金额	金额	变动率	金额	变动率	金额
一、营业总收入	15,309.16	57,088.11	59.86%	35,712.04	5.89%	33,727.01
其中：营业收入	15,309.16	57,088.11	59.86%	35,712.04	5.89%	33,727.01
二、营业总成本	13,991.12	54,605.68	56.96%	34,790.31	29.21%	26,924.58
其中：营业成本	11,971.77	45,224.49	58.87%	28,466.82	29.05%	22,058.62
营业税金及附加	30.95	178.28	152.63%	70.57	-16.15%	84.16
销售费用	297.09	1,209.96	32.27%	914.75	8.84%	840.45
管理费用	1,652.29	7,958.47	53.48%	5,185.29	33.77%	3,876.42
财务费用	11.43	-41.51	73.46%	-23.93	17.49%	-20.37
资产减值损失	27.59	76.00	-57.02%	176.81	107.29%	85.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-5.79	105.96	-340.90%	-43.99	-160.52%	72.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24.18	-49.67	-47.06%	-93.83	134.94%	-39.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,312.25	2,588.39	194.89%	877.74	-87.23%	6,875.12
加：营业外收入	10.20	900.21	-18.92%	1,110.22	42.50%	779.13



其中：非流动资产处置利得	-	-	-	-	-	-
减：营业外支出	-	34.53	149.35%	13.85	62.47%	8.52
其中：非流动资产处置损失	-	9.54	-3.16%	9.85	15.54%	8.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,322.45	3,454.07	74.97%	1,974.11	-74.18%	7,645.72
减：所得税费用	132.21	462.54	832.49%	49.60	-94.82%	956.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,190.24	2,991.53	55.44%	1,924.51	-71.23%	6,688.94
归属于母公司所有者的净利润	1,190.24	2,991.53	55.44%	1,924.51	-71.23%	6,688.94

## 1、营业收入分析

公司营业收入结构及变动情况详见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“（二）营业收入构成及变动分析”的内容。

## 2、营业成本分析

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	11,971.77	100.00%	45,224.49	100.00%	28,466.82	100.00%	22,058.62	100.00%
其他业务成本	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<b>11,971.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,224.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,466.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,058.62</b>	<b>100.00%</b>

公司营业成本全部由主营业务成本构成。公司其他业务收入主要为汇票利息、账期逾期利息以及配合度罚金等收入，无对应成本。

### （1）主营业务成本分产品构成情况

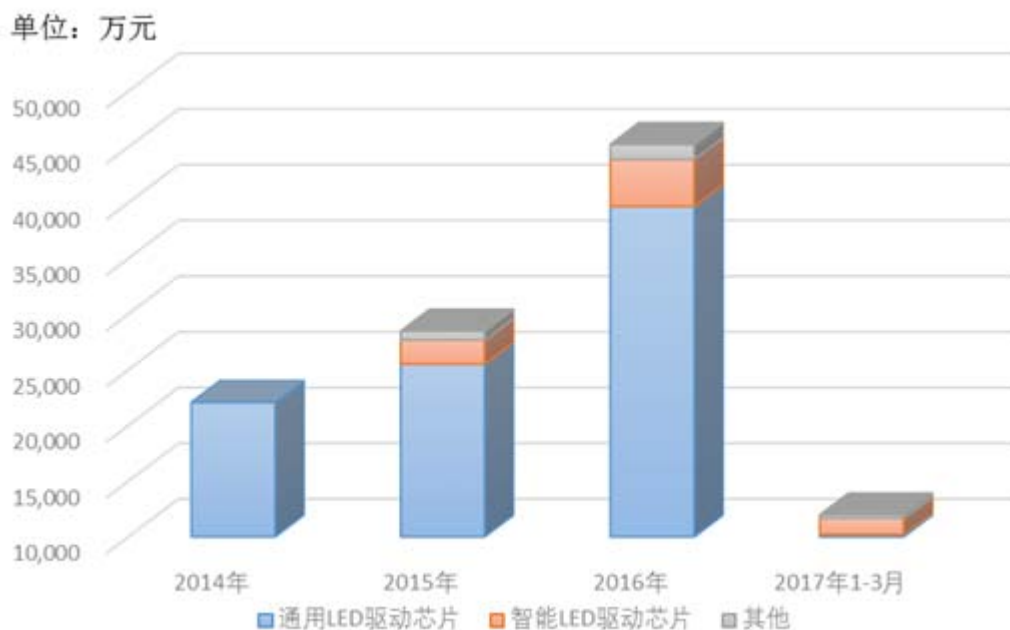
报告期内，公司分产品确认的主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
通用LED照明驱动芯片	10,215.82	85.33%	39,675.13	87.73%	25,513.35	89.62%	22,058.62	100.00%

智能LED照明驱动芯片	1,444.90	12.07%	4,207.74	9.30%	2,165.37	7.61%	0.00	0.00%
其他	311.05	2.60%	1,341.61	2.97%	788.09	2.77%	-	0.00%
<b>主营业务成本</b>	<b>11,971.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,224.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,466.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,058.62</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主要产品营业成本变化情况如下图所示：



报告期内，公司营业成本主要为收入占比较高的通用LED照明驱动芯片和智能LED照明驱动芯片成本。

### 3、期间费用分析

报告期内，公司各项期间费用及占营业收入的比例情况如下：

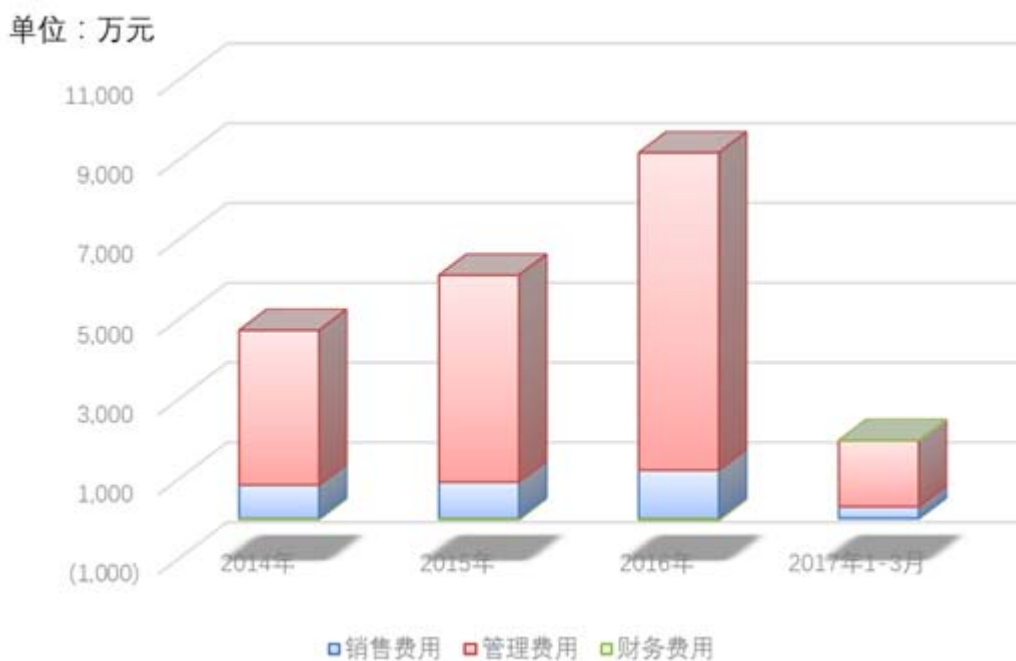
单位：万元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售费用	297.09	1.94%	1,209.96	2.12%	914.75	2.56%	840.45	2.49%
管理费用	1,652.29	10.79%	7,958.47	13.94%	5,185.29	14.52%	3,876.42	11.49%
财务费用	11.43	0.07%	-41.51	-0.07%	-23.93	-0.07%	-20.37	-0.06%
<b>合计</b>	<b>1,960.81</b>	<b>12.81%</b>	<b>9,126.92</b>	<b>15.99%</b>	<b>6,076.11</b>	<b>17.01%</b>	<b>4,696.50</b>	<b>13.93%</b>
营业收入	15,309.16	100.00%	57,088.11	100.00%	35,712.04	100.00%	33,727.01	100.00%

2014年至2017年1-3月，公司期间费用分别为4,696.50万元、6,076.11万元、9,126.92万元和1,960.81万元，占营业收入的比例分别为13.93%、17.01%、

15.99%和 12.81%，总体略有波动。

报告期内，公司期间费用的构成情况如下图所示：



#### （1）销售费用分析

报告期内，公司销售费用占营业收入的比例如下图所示：



报告期内，公司销售费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	190.68	64.18%	808.07	66.79%	645.74	70.59%	542.13	64.50%
物流费	37.91	12.76%	205.26	16.96%	147.84	16.16%	162.63	19.35%
租赁费	10.21	3.44%	57.83	4.78%	59.77	6.53%	46.36	5.52%
办公费用	28.63	9.64%	23.80	1.97%	20.95	2.29%	56.37	6.71%
其他	29.66	9.98%	114.99	9.50%	40.45	4.42%	32.96	3.92%
<b>合计</b>	<b>297.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,209.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>914.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>840.45</b>	<b>100.00%</b>

2014年至2017年1-3月，公司销售费用分别为840.45万元、914.75万元、1,209.96万元和297.09万元，占营业收入的比例分别为2.49%、2.56%、2.12%和1.94%。报告期内，随着公司销售规模不断扩大，销售费用呈现逐年增长的趋势，在销售规模迅速扩大的同时，规模效应逐渐显现，使得销售费用率自2015年起有逐年降低趋势。

报告期内，公司销售费用占营业收入比例与同行业上市公司对比情况如下：

项目	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
士兰微	3.00%	3.22%	2.83%	2.59%
圣邦股份	-	7.01%	7.01%	7.79%
富满电子	-	2.84%	3.15%	3.89%
<b>平均值</b>	-	<b>4.36%</b>	<b>4.33%</b>	<b>4.76%</b>
<b>公司</b>	<b>1.94%</b>	<b>2.12%</b>	<b>2.56%</b>	<b>2.49%</b>

公司销售费用率较低的主要原因为：①公司LED照明驱动芯片领域客户集中度较高，报告期内公司前十大客户占主营业务收入比例分别为72.91%、74.20%、73.14%和72.19%；此外，公司经销销售占比较高，报告期内公司经销收入占主营业务收入的比例分别为68.52%、79.88%、79.72%和82.57%，较高的客户集中度及主要采取经销销售有效的降低了公司的销售费用。②公司主要产品为通用LED照明驱动芯片，该等产品市场需求及销售渠道较为稳定，且公司在LED照明驱动芯片领域市场中建立了一定的市场优势地位，客户及销售渠道稳定，客户及渠道维护成本相对较低。

## （2）管理费用分析

报告期内，公司管理费用占营业收入的比例如下图所示：

单位：万元



报告期内，公司管理费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
研发费用	1,022.86	61.91%	4,571.88	57.45%	2,887.78	55.69%	2,373.63	61.23%
职工薪酬	424.34	25.68%	1,434.71	18.03%	1,262.71	24.35%	677.01	17.46%
办公费用	53.24	3.22%	246.57	3.10%	174.40	3.36%	225.94	5.83%
租赁费	44.96	2.72%	121.25	1.52%	115.41	2.23%	88.51	2.28%
摊销及折旧	38.37	2.32%	46.55	0.58%	39.89	0.77%	10.16	0.26%
咨询服务费	10.37	0.63%	130.97	1.65%	105.82	2.04%	91.54	2.36%
其他	58.14	3.52%	80.93	1.02%	88.47	1.71%	105.67	2.73%
股份支付	-	-	1,325.61	16.66%	510.80	9.85%	303.95	7.84%
<b>合计</b>	<b>1,652.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,958.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,185.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,876.42</b>	<b>100.00%</b>

2014年至2017年1-3月，公司管理费用分别为3,876.42万元、5,185.29万元、7,958.47万元和1,652.29万元，占营业收入的比例分别为11.49%、14.52%、13.94%和10.79%。公司管理费用主要为研发费用及职工薪酬，报告期内，该两项支出占管理费用的比重分别为78.70%、80.04%、75.47%和87.59%。

2015年、2016年，公司管理费用分别较上年增长33.76%和53.48%，主要

原因是公司当年研发费用、计入管理费用的职工薪酬、股份支付较上年增长所致。公司为保证产品的竞争力，持续加大研发投入，使得研发费用逐年大幅增长。由于公司经营规模的不断扩大、员工人数的增长以及薪酬水平的提高，报告期各年计入管理费用的职工薪酬均较上年增长。

报告期内，公司管理费用占营业收入比例与同行业上市公司对比情况如下：

项目	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
士兰微	16.00%	17.20%	19.58%	19.17%
圣邦股份	-	14.07%	13.31%	12.08%
富满电子	-	11.62%	11.99%	11.71%
平均值	-	14.30%	14.96%	14.32%
公司	10.79%	13.94%	14.52%	11.49%

报告期内，公司管理费用率分别为 11.49%、14.52%、13.94%和 10.79%，与同行业公司平均水平较为接近。公司管理费用支出符合公司实际经营状况，管理费用率处于合理水平。

### （3）财务费用分析

报告期内，公司财务费用占营业收入的比例如下图所示：

单位：万元



报告期内，公司财务费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
利息支出	-	-	88.37	-212.86%	56.63	-236.61%	2.80	-13.73%
减：利息收入	2.72	23.83%	20.77	-50.04%	76.30	-318.82%	26.01	-127.67%
汇兑损益	12.63	110.51%	-117.92	284.06%	-8.88	37.11%	-0.76	3.74%
其他	1.52	13.32%	8.81	-21.23%	4.62	-19.32%	3.60	-17.68%
<b>合计</b>	<b>11.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>-41.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>-23.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>-20.37</b>	<b>100.00%</b>

2014年至2017年1-3月，公司财务费用分别为-20.37万元、-23.93万元和-41.51万元和11.43万元，占营业收入的比例分别为-0.06%、-0.07%、-0.07%和0.07%。

2016年，公司财务费用下降幅度较大，主要原因系：2016年以来，美元对人民币汇率持续上升，公司外销收入全部以外币结算，汇率上升使得公司汇兑收益较大。

#### 4、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
坏账损失	12.99	47.09%	77.15	101.51%	37.15	21.01%	50.24	58.90%
存货跌价损失	14.60	52.91%	-1.15	-1.51%	139.67	78.99%	35.06	41.10%
<b>合计</b>	<b>27.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>176.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>85.30</b>	<b>100.00%</b>

2014年至2017年1-3月，公司资产减值损失分别为85.30万元、176.81万元、76.00万元和27.59万元。报告期内，公司资产减值损失主要为坏账损失和存货跌价损失。

#### 5、营业外收入与支出

报告期内，公司营业外收入与支出如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
营业外收入				
政府补助	0.91	884.60	1,094.00	771.32
其他	9.29	15.62	16.22	7.81
合 计	<b>10.20</b>	<b>900.21</b>	<b>1,110.22</b>	<b>779.13</b>
营业外支出				
固定资产处置损失	-	9.54	9.85	8.52
对外捐赠	-	15.00	4.00	-
其他	-	0.06	-	-
盘亏损失	-	9.94	-	-
合 计	-	<b>34.53</b>	<b>13.85</b>	<b>8.52</b>

#### （1）营业外收入

报告期内，公司营业外收入主要为政府补助。2014年至2017年1-3月，公司收到金额在5万元以上的政府补助如下：

##### 1) 2017年1-3月

公司当期不存在金额在5万元以上的政府补助。

##### 2) 2016年

单位：万元

序号	政府补助文件	金额	批准单位
1	上海市张江高科技园区管理委员会《关于政府补助的情况说明》	363.00	上海市张江高科技园区管理委员会
2	《高新技术成果转化专项资金扶持办法》（沪财企[2006]66号）	238.40	上海市财政局
3	上海市浦东新区科技和经济委员会关于晶丰明源财政补助情况的《证明》	80.00	上海市浦东新区科技和经济委员会
4	上海市张江高科技园区管理委员会《关于政府补助的情况说明》	73.00	上海市张江高科技园区管理委员会
5	《领军人才专项资金资助拨款通知》（沪人社专领[2016]103号）	40.00	上海市人力资源和社会保障局
6	上海市浦东新区科技和经济委员会关于晶丰明源财政补助情况的《证明》	30.00	上海市浦东新区科技和经济委员会



7	《关于公布 2014 年度上海市科技型中小企业技术创新资金立项项目并下达资助经费的通知》	30.00	上海市科学技术委员会
8	上海市张江高科技园区管理委员会《关于政府补助的情况说明》	13.00	上海市张江高科技园区管理委员会
9	《上海市集成电路布图设计登记资助决定书》	7.15	上海市知识产权局
10	《关于下达 2015-2016 年度上海市科技创新券补贴兑现经费安排的通知》	6.70	上海市科学技术委员会
小计		<b>881.25</b>	-

## 3) 2015 年

单位：万元

序号	政府补助文件	金额	批准单位
1	《高新技术成果转化专项资金扶持办法》（沪财企[2006]）66 号	474.70	上海市财政局
2	上海市张江高科技园区管理委员会《关于政府补助的情况说明》	251.50	上海市张江高科技园区管理委员会
3	上海市浦东新区科技和经济委员会关于晶丰明源财政补助情况的《证明》	100.00	上海市浦东新区科技和经济委员会
4	《上海市科技小巨人工程实施办法》	100.00	上海市科学技术委员会
5	上海市经济信息化委关于下达 2013 年度软件和集成电路产业发展专项资金项目计划的通知（沪经信信[2013]713 号）	100.00	上海市经济和信息化委员会
6	上海市浦东新区科技和经济委员会关于晶丰明源财政补助情况的《证明》	10.00	上海市浦东新区科技和经济委员会
7	上海市浦东新区科技和经济委员会关于晶丰明源财政补助情况的《证明》	40.00	上海市浦东新区科技和经济委员会
8	上海市张江高科技园区管理委员会《关于政府补助的情况说明》	9.00	上海市张江高科技园区管理委员会
9	上海市张江高科技园区管理委员会《关于政府补助的情况说明》	8.80	上海市张江高科技园区管理委员会
小计		<b>1,094.00</b>	-

## 4) 2014 年

单位：万元

序号	政府补助文件	金额	批准单位
1	《高新技术成果转化专项资金扶持办法》（沪财企[2006]）66 号	297.80	上海市财政局

2	上海市张江高科技园区管理委员会《关于政府补助的情况说明》	278.60	上海市张江高科技园区管理委员会
3	上海市张江高科技园区管理委员会《关于政府补助的情况说明》	100.00	上海市张江高科技园区管理委员会
4	上海市浦东新区科技和经济委员会关于晶丰明源财政补助情况的《证明》	60.00	上海市浦东新区科技和经济委员会
5	《科技型中小企业创新基金管理中心-2010年第2批立项项目公告》	15.00	科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心
6	上海市浦东新区科技和经济委员会关于晶丰明源财政补助情况的《证明》	10.00	上海市浦东新区科技和经济委员会
7	上海市张江高科技园区管理委员会《关于政府补助的情况说明》	9.92	上海市张江高科技园区管理委员会
小计		<b>771.32</b>	

## （2）营业外支出

2014年至2016年末，公司营业外支出分别为8.52万元、13.85万元和34.53万元，主要为对外捐赠、固定资产处置损失及盘亏损失等。

## （四）毛利率及其变化情况分析

### 1、综合毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率情况如下表：

项目	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
主营业务毛利率	21.78%	20.31%	20.06%	34.58%
其他业务毛利率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
综合毛利率	21.80%	20.78%	20.29%	34.60%

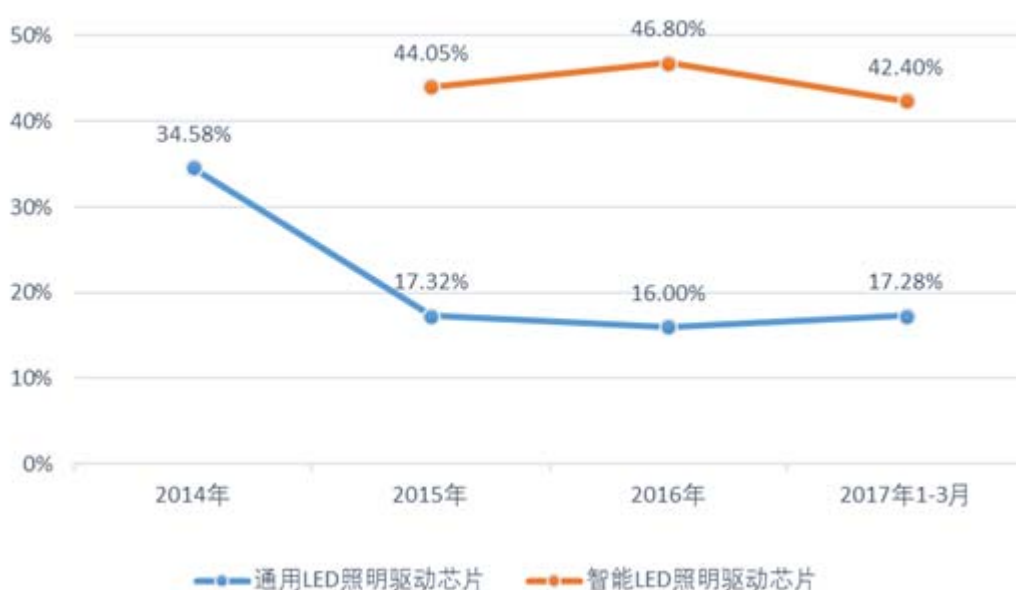
2014年至2017年1-3月，公司综合毛利率分别为34.60%、20.29%、20.78%和21.80%。2015年，公司综合毛利率较2014年下降14.31%，除此以外，公司报告期其他各期毛利率基本稳定。公司2015年毛利率下降的主要原因为当年占营业收入比例较大的通用LED驱动芯片产品毛利率由34.58%下降至17.32%。

### 2、公司主营产品毛利率情况

报告期内，公司主要产品毛利率情况如下表所示：

名称	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
主营业务毛利率	21.78%	20.31%	20.06%	34.58%
通用LED照明驱动芯片	17.28%	16.00%	17.32%	34.58%
智能LED照明驱动芯片	42.40%	46.80%	44.05%	-
其他产品	30.26%	16.57%	10.86%	-

公司主要产品毛利率变化情况如下图所示：



#### (1) 通用LED驱动芯片产品毛利率分析

报告期内，通用LED照明驱动芯片的单位价格、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
单位价格（元/粒）	0.2230	0.2201	0.2795	0.4073
单位成本（元/粒）	0.1844	0.1849	0.2311	0.2664
毛利率	17.28%	16.00%	17.32%	34.58%

2015年，公司通用LED照明驱动芯片毛利率较2014年下降17.26个百分点，毛利率下降的主要原因系当期该等产品销售价格的降低。

公司凭借着先入优势及核心技术优势在报告期初获得了较高的毛利率水平。随着产品技术成熟度越来越高及更多竞争对手进入本行业，通用 LED 芯片产品毛利率逐步回归到正常水平。

2015 年，公司下游的 LED 照明行业因产能过度扩张等原因出现价格战，驱动芯片占 LED 照明产品成本比例一般约为 5%，占比虽然较低，但在 LED 照明产品价格大幅下降的市场背景下，公司仍面临来自下游客户的降价压力。同时，下游 LED 照明行业重新洗牌的过程中 LED 驱动芯片市场集中度提升，公司需要快速抢占竞争对手退出带来的市场空白。针对上述情况，公司于 2015 年制定了针对性的销售策略，对通用 LED 驱动芯片产品进行了价格调整，平均单价由 2014 年的 0.4073 元/粒降低至 2015 年的 0.2795 元/粒，降幅为 31.38%。

### （2）智能 LED 驱动芯片产品毛利率分析

报告期内，智能 LED 照明驱动芯片的单位价格、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2017 年 1-3 月	2016 年	2015 年	2014 年
单位价格（元/粒）	0.3519	0.3775	0.3829	-
单位成本（元/粒）	0.2027	0.2008	0.2142	-
毛利率	42.40%	46.80%	44.05%	-

报告期内，公司智能 LED 驱动芯片产品毛利率相对稳定。公司于 2015 年推出了智能 LED 驱动芯片产品，该产品在通用 LED 驱动芯片产品的基础上加入了全自动调光、调色、智能场景转换等功能，技术含量较高。公司智能 LED 产品技术指标领先，性价比较高，初步形成了进口替代优势，毛利率相对通用 LED 驱动芯片产品较高。

### （3）其他产品毛利率分析

公司主营业务其他产品主要为电机驱动芯片及部分原材料，自 2015 年起开始销售，2015 年至 2017 年 1-3 月，公司其他产品销售收入分别为 884.12 万元、1,608.08 万元和 446.03 万元，毛利率分别为 10.86%、16.57%和 30.26%，其他产品毛利占公司利润的比例较低，对公司经营业绩的影响较小。

### 3、公司综合毛利率与同行业上市公司的比较

同行业中无专门从事 LED 照明驱动芯片的上市公司，现选取与公司产品结构等方面具有一定相似度的三家可比上市公司作比较分析，其中士兰微集成电路产品中的 LED 照明驱动、富满电子 LED 控制及驱动类芯片以及圣邦股份电源管理模拟芯片中的 LED 驱动器与公司产品具有一定相似度。

报告期内，公司综合毛利率与同行业上市公司比较情况如下表所示：

名称	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
士兰微	26.89%	24.67%	26.67%	29.46%
圣邦股份	-	40.24%	40.65%	40.37%
富满电子	-	28.32%	29.80%	30.59%
平均值	-	31.08%	32.37%	33.47%
晶丰明源	21.80%	20.78%	20.29%	34.60%

由上表可以看出，除 2014 年外，公司报告期内的综合毛利率低于同行业平均水平，主要原因为：同行业上市公司虽同为芯片企业，但由于市场竞争情况、产品结构、产品应用领域、公司运营规模、经营策略不尽相同，从而导致同行业上市公司毛利率水平也各有不同。

### （五）非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益	-	36.89	-9.85	-8.52
计入当期损益的政府补助	0.91	884.60	1,094.00	771.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	4.25	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	18.40	109.20	49.84	112.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	26.00	4.80	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9.29	-9.38	12.22	7.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-1,325.61	-510.80	-303.95

非经常性损益合计	28.60	-274.05	640.21	579.27
减：非经常性损益对所得税的影响	-4.29	41.11	-64.02	-72.41
扣除所得税影响后非经常性损益合计	24.31	-232.94	576.19	506.86
减：归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	24.31	-232.94	576.19	506.86
归属于母公司普通股股东的净利润	1,190.24	2,991.53	1,924.51	6,688.94
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	<b>1,165.93</b>	<b>3,224.47</b>	<b>1,348.32</b>	<b>6,182.08</b>
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司普通股股东的净利润的比例	<b>2.04%</b>	<b>-7.79%</b>	<b>29.94%</b>	<b>7.58%</b>

2014年至2017年1-3月，公司非经常性损益影响的净利润分别为506.86万元、576.19万元和-232.94万元和24.31万元，占归属于母公司普通股股东的净利润的比例分别为7.58%、29.94%、-7.79%和2.04%。2015年末，公司非经常性损益占当期净利润比例达29.94%，主要系当期政府补助金额相对较大，其余各期非经常性损益对公司净利润影响相对较小。

## （六）所得税税率优惠影响分析

1、公司于2012年11月18日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业证书，并于2015年10月30日通过了高新技术企业复审，取得了《高新技术企业证书》，证书号：GR201531000545。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），本公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2016年度、2017年1-3月企业所得税实际执行税率为15%。

2、根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），公司2015年度符合国家规划布局内重点集成电路设计企业有关企业所得税优惠条件，2015年度公司按照10%的优惠税率缴纳企业所得税。

3、根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财

税[2008]1号)和《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)的规定,公司享受软件企业自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税,第三年至五年减半征收企业所得税。根据《企业所得税优惠事先备案结果通知书》(浦税十五所备(2012)第036X号),公司2011-2012年免征所得税,2013-2015年减半征收,税率为12.5%。2014年度公司企业所得税按应纳税所得额的12.5%计缴。

2014年至2016年,公司享受的所得税税收优惠金额及影响比例如下表:

单位:万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
利润总额(母公司)	3,424.71	1,974.11	7,645.72
净利润(母公司)	2,962.57	1,924.51	6,688.94
净利润(假设所得税税率按25%法定税率)	2,703.59	1,744.19	5,732.25
<b>所得税政策优惠金额</b>	<b>258.99</b>	<b>180.31</b>	<b>956.70</b>
<b>所得税政策优惠金额占当期利润总额的比例</b>	<b>7.56%</b>	<b>9.13%</b>	<b>12.51%</b>

2014年至2016年,公司依法享受的所得税税率优惠金额分别为956.70万元、180.31万元和258.99万元,占当期利润总额的比例分别为12.51%、9.13%和7.56%。

### 三、现金流量分析

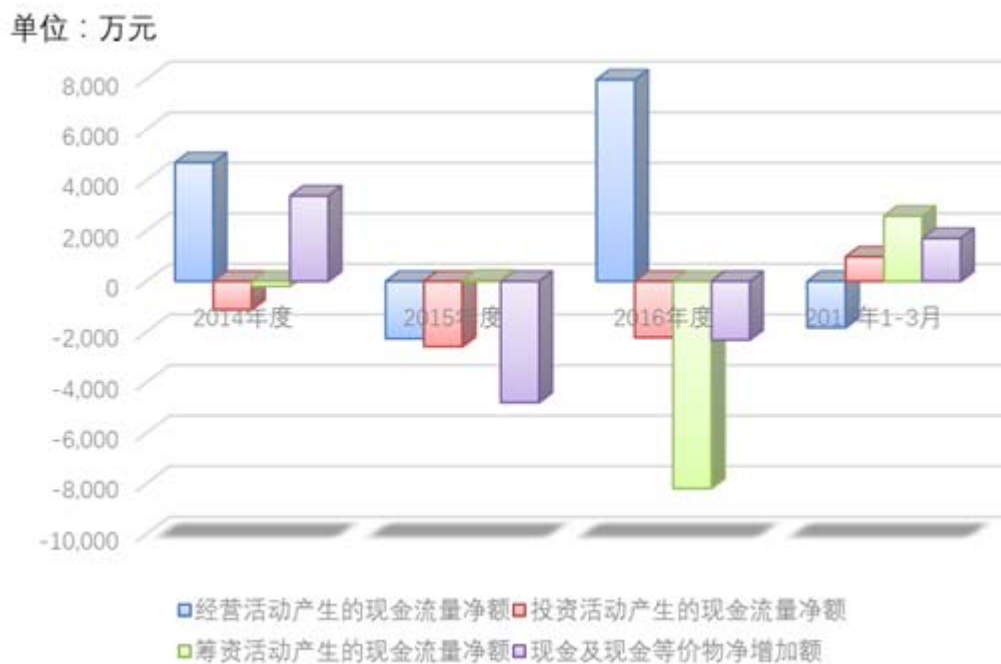
报告期内,公司现金流量情况如下:

单位:万元

项目	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
经营活动现金流入小计	10,011.04	48,087.39	24,861.17	26,441.83
经营活动现金流出小计	11,844.53	40,114.09	27,127.03	21,743.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,833.49</b>	<b>7,973.30</b>	<b>-2,265.85</b>	<b>4,698.76</b>
投资活动现金流入小计	9,118.40	65,274.33	23,740.24	79,062.62
投资活动现金流出小计	8,149.79	67,495.45	26,323.54	80,183.81
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>968.60</b>	<b>-2,221.12</b>	<b>-2,583.29</b>	<b>-1,121.19</b>

筹资活动现金流入小计	2,666.50	-	1,100.00	-
筹资活动现金流出小计	84.91	8,192.34	1,056.63	197.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,581.59</b>	<b>-8,192.34</b>	<b>43.37</b>	<b>-197.80</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14.11	123.53	16.18	0.25
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,702.60</b>	<b>-2,316.63</b>	<b>-4,789.59</b>	<b>3,380.01</b>

报告期内，公司现金流量主要数据变动情况如下：





## （一）经营活动现金流量分析

2014年至2017年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,698.76万元、-2,265.85万元和7,973.30万元和-1,833.49万元，同期净利润分别为6,688.94万元、1,924.51万元和2,991.53万元和1,190.24万元。报告期内，公司经营活动现金流与同期净利润存在一定差异。

2015年，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,265.85万元，同期净利润为1,924.51万元，两者差额为4,190.36万元，主要原因系：随着市场竞争的逐步稳定，2015年11月份、12月份公司销售出库量大幅增长，导致期末应收账款及应收票据余额增加，当期经营性应收项目共增加5,749.80万元。

2016年，公司经营活动产生的现金流量净额为7,973.30万元，同期净利润为2,991.53万元，两者差额为4,981.77万元，主要原因系：①2016年公司营业收入较2015年增长59.86%，随着产品销量及业务规模的快速扩大，原材料及委外加工的采购量也相应大幅增加，导致当期经营性应收项目增加4,117.50万元，而当期经营性应付项目增加7,197.95万元；②当期公司用于股权激励发生股份支付成本共1,325.61万元。

2017年3月末，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,833.49万元，同期净利润为1,190.24万元，两者差额为3,023.73万元，主要原因系：①每年第二季度为公司出货旺季，公司生产备货量较高，期末公司存货增加1,676.55万元；②当期应付票据减少1,783.27万元。

## （二）投资活动现金流量分析

2014年至2017年1-3月，公司投资活动现金流量净额分别为-1,121.19万元、-2,583.29万元、-2,221.12万元和968.60万元。

报告期内，投资活动现金流入主要为赎回理财产品及收到其他与投资活动有关的现金等，投资活动现金流出主要为购买理财产品及支付其他与投资活动有关的现金等。收到及支付其他与投资活动有关的现金主要为公司向关联方和非关联方借出资金并收回所形成。

### （三）筹资活动现金流量分析

2014年至2017年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-197.80万元、43.37万元和-8,192.34万元和2,581.59万元。

报告期内，筹资活动现金流入主要为银行短期借款及收到的增资款，筹资活动现金流出主要为归还银行借款以及股东分红等。

2016年，公司筹资活动流出净额较大，主要系当期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,145.17万元。

## 四、资本性支出分析

### （一）报告期内公司的资本性支出情况

2014年至2017年3月末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为186.30万元、109.05万元、613.37万元和249.79万元，报告期内公司资本性支出金额相对较小。上述资本性支出主要为购置机器设备、办公设备以及软件等。上述资本性支出均为与公司主营业务相关的支出，是为了公司日常经营正常开展、保障技术产品研发创新性的必要投入。

### （二）未来可预见的重大资本性支出情况

未来可预见的重大资本性支出主要为建设本次募集资金拟投资项目的支出，具体情况请参见本招股说明书“第十三节 本次募集资金运用”。除此之外，公司近期无其他可预见的重大资本性支出情况。

## 五、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

报告期内，公司未发生重大会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正等事项。

## 六、担保、诉讼、其他或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保、诉讼及其他或有事项。

## 七、公司经营优势、困难及未来发展趋势分析

### （一）公司的主要优势及困难分析

#### 1、公司目前的主要经营优势

公司主要优势详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“三、发行人在行业中的竞争地位”。

#### 2、公司的主要经营困难

公司目前可用的融资方式较少，主要通过自身积累的方式来筹措资金。随着公司本次发行募集资金投资项目的实施，未来资金的需求量将更大，仅仅依靠银行贷款和公司内部积累将无法缓解公司资金短缺压力，影响了公司的持续盈利能力。本次发行上市如能成功，将为公司产品结构优化、营销服务网络升级、人才储备等方面提供有力的资金支持，以确保公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。

### （二）盈利能力的趋势分析

随着近年来终端 LED 照明产品与传统照明产品的价差逐步缩小，以及 LED 照明产品的低耗能、寿命长、发光效率高、环保等特性，相关产品逐渐进入大众消费市场，促使市场需求进一步扩大，渗透率不断上升。LED 终端客户的旺盛需求将进一步带动 LED 芯片市场的大力发展。报告期内，公司凭借着稳定的产品品质和研发优势，业务实现了快速发展，在 LED 照明芯片领域内已经拥有了稳定的市场地位，公司盈利水平较好，毛利率趋于稳定。

未来，公司仍将专注于 LED 驱动芯片领域，借助多年积累的技术优势、市场优势和产品优势，积极开拓新客户和新产品，继续保持并努力提高在行业中的地位。募集资金投资项目的建成将进一步促进公司营业收入的稳步增长，进一步提高公司盈利水平，从而全面提升公司的综合竞争实力和抗风险能力。

## 八、公司未来分红回报规划及安排

根据公司2017年8月19日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》，本次发行后，发行人股东未来分红回报规划如下：

### （一）股东回报规划制定考虑因素

本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排。

### （二）分红回报规划制定原则

1、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司可以进行中期现金分红；

2、公司坚持以现金分红为主，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

前述重大资金支出安排是指：公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 20%。在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下，公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

3、公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，并考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

### （三）股东回报规划的决策机制

1、利润分配政策由公司董事会制定，经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会批准。

（1）董事会制定利润分配政策和事项时应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见。公司董事会对利润分配政策作出决议，必须经董事会全体董事过半数以上通过。独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。

（2）公司监事会对利润分配政策和事项作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

（3）公司股东大会审议利润分配政策和事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。公司股东大会对利润分配政策作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

2、既定利润分配政策的调整条件、决策程序和机制

（1）公司调整既定利润分配政策的条件：因外部经营环境发生较大变化；因自身经营状况发生较大变化；因国家法律、法规或政策发生变化。

（2）既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的，应事先征求独立董事和监事会意见，经过公司董事会、监事会表决通过后提请公司股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过批准，调整利润分配政策的提案中

应详细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

## 九、本次发行摊薄即期回报的分析

### （一）每股收益变动趋势

发行人按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算的每股收益如下：

期间	报告期利润	每股收益（元）	
		基本	稀释
2017年1-3月	归属于普通股股东的净利润	0.26	0.26
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	0.26	0.26
2016年	归属于普通股股东的净利润	0.90	0.90
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	0.97	0.97
2015年	归属于普通股股东的净利润	1.80	1.80
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	1.26	1.26
2014年	归属于普通股股东的净利润	6.69	6.69
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	6.18	6.18

本次发行募集资金到位后，公司资产规模和股本总额均将大幅度提升，募集资金将充实公司资本实力，降低公司财务风险。募集资金投资项目达产后，公司营业收入规模及利润水平也将有所增加，公司综合竞争力得到加强。但由于募集资金投资项目建设周期的存在，短期内募集资金投资项目对公司经营业绩的贡献程度将较小，因此预计发行当年每股收益与上年同期相比将下降。

### （二）董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次募集资金拟投资的智能及通用LED照明芯片开发及产业化项目的实施将会进一步优化公司产品结构，扩宽产品功能与应用领域，提升公司研发实力，增强公司持续盈利能力。本次募集资金投资项目的实施是公司发展战略的重要举措。

未来，随着集成电路产业的不断发展与相关技术的进步，客户对公司产品功

能和性能提出了更高的要求，需要公司加大研发投入以满足客户不断变化的需求。资金紧张等因素限制和制约公司的业务发展，选择本次融资能够合理的发挥募集资金投资项目动力、进一步增强公司资本实力及盈利能力，巩固公司行业优势地位，促进公司长期发展。

本次发行募集资金投资项目的必要性与合理性分析具体请参见本招股说明书“第十三节 本次募集资金运用”。

### （三）本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司开展该等项目的准备情况

本次募集资金投资项目是公司在原有的业务基础上，对公司现有业务结构进行补充以及对业务规模进行扩大。公司本次募集资金投资项目“通用LED照明驱动芯片开发及产业化项目”、“智能LED照明芯片开发及产业化项目”是公司原有产品基础上的扩产开发项目。因此，募集资金投资项目实施后，对公司现有经营模式没有重大影响，将进一步巩固和扩大公司主营业务的市场份额，提升公司综合竞争优势。

目前，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，具体如下：

人员方面，公司重视研发投入和引进高素质人才以提高技术创新能力，公司的技术研发团队、市场销售团队的核心成员均拥有集成电路行业多年的研发和管理经验。截至2017年3月31日，公司在职员工166人，其中技术研发人员94人，销售人员19人，管理和行政人员53人，完善的人员结构为发行人从事募集资金投资项目的实施奠定了人力基础。

技术方面，经过多年的研发积累，公司逐步形成自身的技术竞争优势。公司是国内领先的驱动类集成电路设计企业之一，已成为国内LED照明驱动芯片等细分领域的领先企业之一，是经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局、地方税务局联合认定的高新技术企业。公司自成立以来，即专注于LED照明驱动芯片的研发与销售，致力于为下游LED照明设备产品生产商提供IC产品和工艺解决方案。公司目前的技术储备有利于公司募集资金投资项目的顺利实施。

市场方面，经过多年模拟芯片行业的市场经营与深耕服务，公司积累并沉淀了一大批优质且忠诚的客户，逐步形成了较强的品牌影响力。公司一方面与资深电子元器件经销商结成了长期的合作伙伴关系，并通过经销商的丰富终端客户资源，实现大规模销售。另一方面，公司亦与部分终端客户保持紧密联系，依靠成熟的经销渠道、良好的产品品质和及时的技术支持，公司在客户资源上具备明显优势。良好的品牌形象以及丰富的客户资源为公司募集资金投资项目的实施奠定了基础。

#### （四）填补回报的具体措施

本次发行后公司股本总额和净资产将大幅增加。公司募集资金将应用于公司主营业务，募集资金投资项目符合行业发展趋势及公司的发展规划。但由于募投资金投资项目实施并产生效益需要一定时间，在此之前，如公司净利润未产生相应幅度的增长，公司的每股收益和净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

因此，公司拟通过加强市场开拓，降低公司运营成本，积极实施募投项目，完善利润分配制度等方式，提高公司盈利能力，以填补被摊薄即期回报，具体措施如下：

##### 1、加强市场开拓，提高公司持续盈利能力

公司作为行业领先的LED照明驱动芯片供应商，主要从事模拟和混合信号集成电路的研发与销售，凭借着持续的研发投入和优良的产品质量，公司产品已具有较大的市场影响力。公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步提升公司产品品牌影响力及主营产品市场占有率。同时，公司将继续加大研发投入和技术储备，加强自身核心技术的开发和积累，提高公司竞争能力和持续盈利能力。

##### 2、提高发行人日常运营效率，降低发行人运营成本

发行人经过多年的经营积累，已经形成了较为有效的管理体系以保证日常高效运营，但随着募集资金投资项目实施，公司的业务规模将不断扩大，公司经营活动、组织架构以及管理体系均将趋于复杂，管理难度相应增加。因此，培养优秀人才、建立完善的绩效考核体系是提升公司经营业绩的必要选择。



公司将坚持“以人为本”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性；明确各岗位的职责权限、任职条件和工作要求；通过公开招聘、竞争上岗等多种方式选聘优秀人才，切实做到因事设岗、以岗选人。

公司将不断完善目标管理和绩效考核体系，设置科学的业绩考核指标，对各级管理人员和全体员工进行合理的考核与评价。公司通过晋升规划、补充规划、培训开发规划、职业规划等人力资源计划确保员工队伍持续优化，实现人力资源管理的良性循环。

### **3、积极实施募投项目，争取实现项目预期收益**

本次募集资金投资项目经过公司充分论证，符合行业发展趋势及公司发展规划，项目实施后将进一步巩固和扩大公司主要产品的市场份额，提升公司综合竞争优势。在募集资金到位前，公司以自有资金先期投入建设，以争取尽早产生收益。

### **4、完善利润分配制度**

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的相关要求，修订了公司章程。《公司章程（草案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行上市后三年分红回报规划》，进一步明确对新老股东权益分红的回报，细化了本次发行后关于股利分配原则的条款。

上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报，然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。

## **（五）董事、高级管理人员对公司填补回报措施作出的承诺**

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

经核查，保荐机构认为：发行人制定的填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神。

## 第十二节 业务发展目标

### 一、公司发展规划

#### （一）发展战略

经过多年的快速发展，公司在 LED 照明驱动芯片领域拥有较强的行业竞争力。未来，公司将继续秉承“创造之芯”企业使命，坚持“诚信、创新、承诺和持续改进”企业文化，通过持续创新引领 LED 照明驱动细分领域发展。公司将在巩固 LED 照明驱动芯片领域优势的基础上，持续专注于节能、环保和智能化等行业发展趋势，成为多元化模拟及混合芯片公司，以创新的芯片技术为更多细分领域客户创造差异化价值和共同发展机会。

#### （二）经营目标

##### 1、整体经营目标

未来两到三年内，公司将不断加大研发投入、引进高新技术人才、加强技术创新、完善管理制度及运行机制，将更多高技术含量、高附加值适应市场需求的 LED 照明驱动芯片产品推向市场。结合多年积累的 LED 照明驱动芯片研发与销售经验，公司还将通过电机驱动芯片产品的持续研发与市场推广，实现公司产品的多元化布局。公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步优化公司现有产品结构、提升公司品牌影响力及产品市场竞争力。

##### 2、主要业务经营目标

公司未来三年的具体发展目标是：通过加强现有产品线的研发升级、提升产品性能及竞争力，进一步提升公司核心竞争力；通过不断完善和优化专业化营销体系和管理流程，提升企业的品牌知名度，扩大区域及行业的覆盖，积极开拓国内外市场。

本业务发展目标是公司基于过往的经营轨迹并结合宏观经济形势以及行业发展状况，对未来三年公司业务发展做出的审慎规划。由于行业竞争激烈且发展迅速，本发展规划的实现存在一定程度的不确定性，因此不排除根据公司的实际

经营状况、宏观经济情况和行业发展变化对本业务发展目标进行调整和完善的可能性。

### （三）发展计划

#### 1、产品研发计划

公司作为上海市高新技术企业以及上海市科技小巨人企业，将继续坚持自主创新的模式，着眼于行业最前沿技术，充分发挥公司多年的技术储备和研发经验，致力于模拟及混合信号芯片的研发及设计产品的升级换代要求更细化的功能、更高的性能和更广泛的应用。公司未来将通过系列化产品的研发并快速推向市场，使业务快速增长。利用现有的技术与市场优势，不断推出高性能、高品质、高附加值的产品，充分发挥公司在技术和产业化方面的优势，适时涉足新的产品市场和应用领域，开辟新的利润增长点。

#### 2、市场开拓和营销网络建设

在市场开拓和营销网络建设方面，公司将通过参加各种专业会议和行业展会，积极宣传产品的性能和特点，提升品牌知名度；培养技术型的销售人才，加强销售团队建设。通过组织业务培训和学习，不断提高销售人员的产品知识和业务水平，提高销售部整体营销能力；在客户集中的区域和有市场潜力的地方建立办事机构，加强营销网络的建设，加强与客户的交流与沟通，加大市场开拓力度；进一步强化“创造之芯”的公司使命。通过不同行业的芯片技术创新给不同行业的客户和其他合作伙伴带来新的机会，努力提高服务质量和水平，不断提高客户满意度，进一步提高公司产品在国内外市场的占有率。

#### 3、国际化战略

公司始终坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，公司产品远销海外多个国家和地区。公司拥有香港子公司，并通过持续引进高层次的具有国际战略思路和专长的人才，不断提升公司国际产品研发和营销水平；充分利用公司的技术优势、品牌优势、市场等优势，结合当地市场特点，整合各类资源，提高公司的国际化竞争优势。

#### 4、人力资源发展计划

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升企业的核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会大幅扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对企业各级员工进行合理的考核与评价。

## 5、再融资计划

本次股票发行募集资金到位后，公司将按计划实施募集资金投资项目。公司不排除今后根据具体情况通过发行新股、债券等方式来筹集资金，以满足公司发展的需要。公司对再融资将采取谨慎的态度，对于公司发展所需要的资金，公司将根据实际财务状况，提高资金的使用效率，降低融资成本，防范和降低财务风险，确保股东权益最大化。

## 二、拟定上述计划所依据的假设条件

公司拟定上述计划所依据的主要假设条件主要为：

- 1、国家宏观政治、经济、法律和社会环境，以及公司所在行业及相关领域的国家政策没有发生不利于公司经营活动的重大变化；
- 2、国家宏观经济继续平稳发展，公司所处行业和市场环境不会出现重大变化；
- 3、本次公司股票发行上市能够成功，募集资金能够顺利到位；
- 4、本次募集资金计划投资项目能够按计划顺利实施，并取得预期收益；
- 5、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件和其它不可抗力因素。
- 6、公司能够持续保持现有管理层、核心技术人员的稳定性或连续性。

### 三、实施上述计划将面临的主要困难

本次募集资金到位后，在较大规模资金运用和公司业务进一步拓展的背景下，公司在发展战略、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理，特别是资金管理和内部控制等方面，都将面临更大的挑战。公司将从制度建设、人才引进、技术研发等方面不断加强投入，积极应对挑战。

### 四、公司业务发展规划与现有业务的关系

公司业务发展规划是在公司现有业务的基础上，按照公司发展战略和经营目标而制定的。发展计划是对公司现有业务的巩固、夯实、扩展和提升，发展计划的实施，将进一步强化公司主业，全面提升公司核心竞争力。

### 五、本次募集资金对上述业务发展目标的作用

本次募集资金的运用将对上述业务目标具有重要意义，主要表现在：

（一）通过募集资金，公司将有效拓展现有产品线，完善公司的产品线和业务链条。本次募集资金的运用，对公司发展战略的实施、战略目标的实现、核心竞争力的提升，具有非常重要的意义。

（二）通过募集资金，公司将加大研发投入，提高研究成果转化能力，根据市场需求快速开发新产品并推广抢先占领市场先机，推动公司的可持续发展。

（三）通过募集资金，公司将迅速拓宽公司融资渠道，改变融资渠道单一所造成的资金瓶颈，进一步转变和优化公司的财务结构，增强公司的资金实力，提高公司的抗风险能力。

（四）通过募集资金，公司将依托资本市场的各种资源优势，加大投入，努力打造公众公司形象，吸收社会优秀人才，着力提升公司的核心竞争力。同时，公司将切实接受社会各界的监督，进一步完善公司法人治理结构，实现企业管理机制的持续升级。

## 第十三节 本次募集资金运用

### 一、募集资金运用概况

#### （一）募集资金拟投资项目

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公众公开发行人民币普通股 A 股，发行数量为不超过 1,540 万股。募集资金总额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。本次发行 A 股募集的资金将全部应用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体项目如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟募集资金投资额 (万元)
1	通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化项目	16,890.00	16,890.00
2	智能 LED 照明芯片开发及产业化项目	24,130.00	24,130.00
3	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		<b>55,020.00</b>	<b>55,020.00</b>

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。在本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以银行贷款和自有资金先行投入。在本次发行募集资金到位后，募集资金可用于置换公司先行投入的资金。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目总投资额，资金缺口部分将由公司通过自筹方式解决，保证项目的顺利实施。

#### （二）募集资金专项存储制度的建立及执行情况

公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会决定的专项账户。公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并严格执行中国证监会及上海证券交易所有关募集资金使用的规定。

#### （三）募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定

本次募集资金投资项目已获得相关主管部门的批复文件，具体情况如下：

序号	项目名称	项目备案	签发部门
1	通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化项目	项目代码：（国家代码：2017-310000-65-03-004476）	上海市张江高科技园区管理委员会
2	智能 LED 照明芯片开发及产业化项目	项目代码：（国家代码：2017-310000-65-03-004475）	上海市张江高科技园区管理委员会
3	补充流动资金	-	-

本次募集资金投资项目中补充流动资金项目不涉及工程建设及产品生产，无须申报建设项目环境影响评价。通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化项目及智能 LED 照明芯片开发及产业化项目建设内容为芯片设计，不涉及生产、封装、测试等工艺环节。根据上海市张江高科技园区管理委员会出具的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司募集资金投资项目不涉及环评审批的证明》，通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化项目及智能 LED 照明芯片开发及产业化项目符合上海市环境保护局《上海市不纳入建设项目环评分类管理的项目类型》（2015 年版）免于环评审批的条款。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人本次发行上市的募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护以及其他法律、法规和规章的规定。

## 二、募集资金运用对同业竞争和独立性的影响

上述募集资金投资项目的实施主体为上海晶丰明源半导体股份有限公司。本次募集资金投资项目实施后，不会和本公司控股股东、实际控制人之间产生同业竞争或者对本公司的独立性产生不利影响。

## 三、通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化项目

### （一）项目投资概算

本项目拟完善现有通用LED照明驱动芯片产品结构，同时加强通用LED照明驱动芯片产品的市场推广。本项目总投资额为16,890.00万元，具体项目投资构成如下：

单位：万元



序号	资金类别	合计	T+12	T+24	T+36
一	<b>建设投资</b>	<b>4,848.48</b>	<b>1,955.00</b>	<b>2,381.30</b>	<b>512.19</b>
1	工程建设费用	4,617.60	1,861.90	2,267.90	487.80
1.1	场地购置费	1,752.50	-	1,752.50	-
1.2	设备购置费	2,865.10	1,861.90	515.40	487.80
2	基本预备费	230.88	93.10	113.40	24.39
二	<b>实施费用</b>	<b>9,771.03</b>	<b>2,236.50</b>	<b>3,674.60</b>	<b>3,859.93</b>
1	研发费用	700.00	210.00	245.00	245.00
2	试制费用	3,180.00	954.00	1,113.00	1,113.00
3	人员投入	5,891.03	1,072.50	2,316.60	2,501.93
三	<b>铺底流动资金</b>	<b>2,270.49</b>	<b>756.83</b>	<b>756.83</b>	<b>756.83</b>
<b>项目总投资</b>		<b>16,890.00</b>	<b>4,948.33</b>	<b>6,812.73</b>	<b>5,128.95</b>

## （二）项目必要性、可行性分析

### 1、项目必要性分析

#### （1）升级产品工艺技术，提高资源整合能力

集成电路设计是决定芯片质量与功能实现的重要因素。通用 LED 照明驱动芯片功能设计需要工艺技术的有力支撑。工艺技术改进不仅有利于精简芯片设计工艺，缩短生产周期、降低生产成本、提高生产效率，而且有利于合理优化芯片设计物理版图，降低生产过程中发生技术故障的风险。此外，通过工艺技术水平的提升以及封装技术的研发、升级，公司将进一步牢固与上游集成电路制造、封测厂商之间的技术转换基础，有助于公司加大对产品供应链的把控度，提升公司在供应链各环节的议价能力，从而真正实现与上游合作者的深度嵌合与资源整合。

#### （2）提高下游客户满意度，巩固产品市场优势

公司自成立以来即专注于 LED 照明驱动芯片的研发与销售，经过多年不懈努力和发展，公司在通用 LED 照明驱动芯片市场具有明显的品牌、规模和技术优势，在国内外市场均有较高的市场占有率，位列行业前茅。公司发展过程中，客户满意度始终是衡量公司行业地位的重要指标之一。公司需要加大对通用 LED 照明驱动芯片的研发投入，不断升级产品技术和工艺，通过优化产品性能、提高

产品质量来提升客户忠诚度、满意度，巩固产品市场优势。

## **2、项目可行性分析**

### **（1）巨大的市场需求、广泛的客户基础**

随着 LED 制造技术的逐步成熟发展以及国家政策关于节能照明的大力推进，LED 对传统照明市场的替代效应极大激发了半导体照明市场的需求（具体详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（三）下游市场需求情况”）。公司已与飞利浦、三雄极光、佛山照明、阳光照明等国内外主要的 LED 照明厂商建立了长期稳定的合作关系，能够掌握行业、产品发展的最新动态。同时，公司与怡海能达、亚讯等多家专业的电子元器件经销商保持密切的合作关系，使公司能够更好地进行推广、宣传与销售通用 LED 照明驱动产品。综上，公司通用 LED 照明驱动芯片具有巨大的市场需求、广泛的客户基础。

### **（2）多年的技术沉淀，丰富的管理经验**

经过多年的培养与锻炼，公司已建立了一批具有丰富 LED 照明驱动芯片开发经验的专业技术人才以及集通用 LED 照明驱动芯片设计、研发、销售为一体经验丰富的产品线管理团队，专业为通用 LED 照明驱动芯片提供解决方案。此外，公司通过健全的人才培训制度确保其技术优势及行业管理经验的延续。因此，公司多年的产品技术沉淀及自身积累的行业管理经验为项目的建设及实施提供了支持。

## **（三）项目实施方案**

### **1、项目产品**

本项目产品为通用 LED 照明驱动芯片。公司将从 AC/DC 非隔离、AC/DC 隔离、AC/DC 线性、MOSFET 和晶圆等 5 个方向对通用 LED 照明驱动芯片进行深入研究与开发。

### **2、通用LED照明驱动芯片市场前景及容量**

随着全球能源短缺及环境恶化等问题愈发严重，促使各国都积极响应节能减

排的号召，纷纷出台白炽灯淘汰政策，加快淘汰白炽灯等低效、耗能的照明产品。随着 LED 照明产品设计和生产技术提高以及 LED 照明在节能、使用寿命、环保等优势逐渐突出，LED 照明将逐渐成为照明领域的主流产品，逐渐引领照明史上继白炽灯、荧光灯之后的又一场照明光源的革命。关于通用 LED 照明驱动芯片市场需求的详细分析参见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（三）下游市场需求情况”。

### 3、项目实施的技术基础

公司自成立之初就一直非常注重自主研发，经过多年发展，公司自主研发并掌握了 700V 高压集成工艺、LED 恒流的源级驱动技术、LED 驱动芯片的供电技术、LED 电流纹波消除技术、700V 单芯片技术等 LED 照明驱动芯片核心技术。截至本招股说明书签署日，公司已取得了 35 项国内发明专利、72 项国内实用新型专利、2 项国外发明专利和 61 项集成电路布图设计登记证书，为公司实施本次募投项目奠定了技术基础。此外，公司经过多年营运拥有一支具有卓越研发能力的研发团队，截至 2017 年 3 月 31 日，公司现有研发技术人员共 94 名，占企业职工人数的 56.63%，具有多年从业经验。

公司依托 ISO9001 质量、环境管理体系标准打造系统、规范、先进的研发管理体系。为了保证照明相关研发任务顺利完成，公司不断引进专业型人才，以项目管理的形式打造了涵盖电子设计、结构设计、光学设计、热学设计、工艺、产品质量监督等专职技术人员组成的研发小组。并且以项目管理的方式确定相关计划阶段目标、任务、责任人，从而保证研发项目的创新。

### 4、行业内重要供应商情况

具体情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“三、发行人在行业中的竞争地位”之“（二）同行业其他企业情况”。

## （四）项目主要设备选择

本项目拟购置主要设备清单如下：

序号	名称	数量（台/套）
一、新增研发设备		

1	探针测试台	4
2	静电 ESD 测试台	2
3	芯片全参数自动测试机	4
4	电磁兼容测试设备	4
5	高性能示波器	10
6	高性能服务器	20
<b>二、新增办公设备</b>		
1	投影仪	3
2	会议电话	3
3	打字复印机	4
4	数码复合机（大型打印复印扫描机）	3
5	笔记本电脑	60
6	办公座椅	60
<b>三、新增软件</b>		
1	Calibre（芯片版图设计软件）	20
2	Altium Designer（印刷电路板 PCB 设计软件）	15
3	MFGDream（测试良率分析软件）	15
4	EDA（Cadence Composer、Virtuoso、ADE）	29
5	MeQLab（博达微模型提取验证软件）	1

## （五）生产及动力供应情况

本项目的芯片生产制造、封装测试等生产环节均通过委外加工完成，具体流程详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（八）行业特有的经营模式与特征”。

本项目动力消耗主要包括水、电等。相关能源为市场化产品，可保证供应。

## （六）项目竣工时间、产量、产品销售方式

本项目将严格按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定严格执行建设程序，确保建设期工作质量，做到精心设计、安装及调试，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程如期保质完成。本项目建设期为36个月。

公司将重点把握市场发展趋势，在更广阔的范围推广公司的品牌和影响力，提高公司的市场占有率，适应客户采购模式变化和行业竞争特点，创新销售管理模式，打造综合销售平台。公司继续强化对现有客户资源的掌控，同时持续提升产品营销能力，不断拓展新客户。具体产品销售方式和营销措施参见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（八）行业特有的经营模式与特征”。

## （七）环境保护

本项目性质为新产品设计研发，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。

## （八）项目选址

项目实施地点为上海市浦东新区，项目前期基础研发和准备工作的实施场所为公司现经营所在地上海市浦东新区张衡路666弄2号5层。随着项目投资进程，公司拟在现有经营所在地附近或其他集成电路产业企业较为集中的地段购置新的办公场所，以实施本项目后续的技术研究与产品开发。

## （九）项目的组织及实施

### 1、组织实施

为了保证项目顺利实施，公司专门成立项目领导组，同时针对项目的实施进度、工艺设备选型、设备工艺安装等成立项目实施组，针对工艺设备布置、安全环保工程等成立项目工程组，保证项目建设有序、保质开展。

### 2、项目进度计划

本项目计划建设期36个月，计划分五个阶段实施完成，包括初步设计、设备采购及安装、人员招聘及培训、试运营等阶段。

## 四、智能 LED 照明芯片开发及产业化项目

### （一）项目投资概算

本项目拟完善现有智能LED照明驱动芯片产品结构，提升产品所搭载智能功能的集成度，并加强产品的市场推广能力。本项目总投资额为24,130.00万元，具体项目投资构成如下：

单位：万元

序号	资金类别	合计	T+12	T+24	T+36
一	<b>建设投资</b>	<b>5,962.95</b>	<b>2,969.09</b>	<b>2,341.19</b>	<b>652.68</b>
1	工程建设费用	5,679.00	2,827.70	2,229.70	621.60
1.1	场地购置费	1,592.50	-	1,592.50	-
1.2	设备购置费	4,086.50	2,827.70	637.20	621.60
2	基本预备费	283.95	141.39	111.49	31.08
二	<b>实施费用</b>	<b>13,826.19</b>	<b>3,535.00</b>	<b>5,063.86</b>	<b>5,227.33</b>
1	研发费用	2,800.00	840.00	980.00	980.00
2	试制费用	5,830.00	1,749.00	2,040.50	2,040.50
3	人员投入	5,196.19	946.00	2,043.36	2,206.83
三	<b>铺底流动资金</b>	<b>4,340.86</b>	<b>1,446.95</b>	<b>1,446.95</b>	<b>1,446.95</b>
	<b>项目总投资</b>	<b>24,130.00</b>	<b>7,951.04</b>	<b>8,852.00</b>	<b>7,326.96</b>

## （二）项目必要性、可行性分析

### 1、项目必要性分析

#### （1）顺应照明智能化趋势，满足市场需要

伴随着信息科技的进步，人们的智能生活需求得到了越来越多的满足，智能化服务也逐渐深化到了各类不同的人居生活场景当中。其中，智能家居作为最贴近人们日常起居的“智能化”概念，近年来受到了越来越多的关注与追捧。特别是在信息化与智能化飞速发展的当下，智能家居的“智能”维度将会不断得以延伸，落实在各类家居场景上的智能化服务也还会持续渗透。而从智能家居服务的主要组成部分来看，智能照明由于有着适用性高、需求大等特点，正在整个智能家居运作体系中发挥着愈发突出的关键作用。首先，智能照明可满足个性化照明控制方案的使用需求，为用户提供最直观和最个性化的智能起居体验；其次，其更能作为家居环境搭建智能物联的基础节点，通过对各个照明区域内智能服务需求进行捕捉，为智能家居提供决策依据，帮助智能家居更好地实现智能服务。因此，无论从技术层面还是需求层面上来看，智能照明都能为智能家居的方案落地

提供不可或缺的支持。而作为智能照明的核心部件，智能 LED 照明芯片也会充分享受到照明智能化流程所带来的市场红利。

## **（2）优化产品结构，增强盈利能力**

凭借多年快速发展，公司通用 LED 照明驱动芯片领域已取得了较强的产品竞争优势以及深厚的市场基础，市场占有率较高。相较于传统的 LED 通用照明，智能 LED 照明能够提供多功能的照明服务来满足各类场景需求，各大 LED 照明厂商及上游厂商也逐渐发力开拓智能化照明领域，以求顺应行业发展趋势，实现市场占领并获得市场的早期发展红利。良好的市场环境也吸引了大量的信息技术相关厂商开始布局照明市场，2016 年华为、小米、海尔等知名品牌相继开始跨界智能照明，共同致力于打造以物联网为基础的智能照明生态体系。在此背景下，公司布局智能 LED 照明芯片产品，加大智能照明芯片技术研发投入，是顺应市场需求的转变趋势，满足市场需求的必然举措。同时，智能 LED 照明驱动芯片具有较高的技术附加值，相对通用 LED 照明驱动芯片产品毛利率更高，可进一步提升公司的盈利能力，符合公司的发展战略。

## **2、项目可行性分析**

### **（1）符合国家产业政策导向**

智能 LED 照明产品为国家鼓励发展产品，符合国家产业政策导向。

国家将半导体照明作为我国战略性新兴产业，制定和出台了一系列扶持政策与行动计划，尤其是智能 LED 照明细分领域。如 2013 年国家发改委出台的《半导体照明节能产业规划》明确提出加快 LED 照明核心材料、装备和关键技术的研发（包括智能化照明系统关键技术），支持 LED 智能化系统管理等技术研究等要求。2016 年国务院发布的《“十三五节能减排综合工作方案”》中指出推广半导体照明等成熟适用技术，推动照明系统优化升级。工信部、财政部联合发布的《智能制造发展规划（2016-2020 年）》明确提出“促进智能网联汽车、智能工程机械、智能船舶、智能照明电器、服务机器人等研发和产业化”等目标。

### **（2）公司具备了开展本项目的各项必要条件**

公司自成立以来即专注于各类LED照明芯片的研发与销售，在LED照明芯片设计领域具有长期而深厚的技术积累，在此基础上，公司较早开展了对各类智能化技术进行探索及研发，并取得了一定的技术积累。2015年起，公司已开始逐步向市场推广智能LED照明芯片产品，智能产品及技术已经经过市场的充分论证，具备进一步扩大智能化产品线的基础。公司建立了一支对照明智能化及信息技术有较丰富研发和实践经验、对市场需求有着深刻理解的研发团队，为本项目的开展提供了强有力的保障。此外，公司还积极对外开展技术研究交流，与电子科技大学等研究机构协议建立了产学研合作关系，在芯片工艺的前沿技术探索、科技攻关、产品研究、试验检测和应用示范等方面开展了广泛合作。

综上，公司基本具备了开展本项目的各项基本条件。

### （三）项目实施方案

#### 1、项目产品

本项目产品为智能LED照明芯片，本项目产品线主要包括5个子产品分类，项目建设将围绕以下产品类别展开：①调光调色，主要为面向LED球泡和吸顶灯应用，用户通过操作墙壁上的开关或者使用无线遥控设备，方便实现预先设定好的色温或亮度的组合，从而可以针对客户常见的使用场景，提供不同的照明模式；②多段线性，主要针对LED光源类产品，为整灯生产厂家提供性价比更高的驱动电源解决方案；③可控硅调光，主要针对出口北美和欧洲的LED光源类产品，用来替代传统的白炽灯和节能灯，为客户带来更节能，长寿命的光源类产品，同时不需要更改之前的灯具和布线；④直流驱动，针对一些由适配器或者USB端口供电的应用场合，为低压直流供电的LED照明设备提供可调光调色的驱动解决方案；⑤中功率电源，针对一些大功率，高品质的商业类和工业类照明，提供外置驱动电源解决方案，实现调光，调色，无频闪，低谐波等功能。

#### 2、市场前景及容量

国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部联合印发了《“十三五”节能环保产业发展规划》明确提出“支持LED智能系统技术发展，加快智能控制等通用技术的推广应用”、“推进照明节能减排技术系统集成应用，推进



区域、城镇、园区、用能单位等照明系统用能和节能，大力发展“互联网+”智慧照明，推动建立城市智慧智能系统，推动照明系统优化升级”。随着集成电路设计、生产水平的进步以及大众生活条件的改善，智能 LED 照明的应用愈加普遍，应用范围愈加广泛。巨大的发展潜力吸引着大量的国内外主要的 LED 照明企业启动智能照明业务，如海尔推出专业照明品牌海尔小管家，正式参与到智能照明的角逐中；飞利浦照明与小米签署协议组建合资公司，共推智能互联家居照明的发展；雷士与中科院就建设满足智慧城市需求的智能 LED 照明解决方案完成签约，发力布局户外城市照明。智能 LED 照明有望成为未来照明市场重要的发展趋势之一。

### 3、项目实施的技术基础

公司自成立之初就一直非常注重自主研发，经过多年发展，公司积累并掌握了兼容可控硅调光器调光的 LED 照明驱动电路、LED 调光技术、改进中间色亮度可调的 LED 开关调光技术、兼容可控硅调光器调光的 LED 照明驱动技术等智能 LED 照明驱动芯片技术。

### 4、行业内重要供应商情况

具体情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“三、发行人在行业中的竞争地位”之“（二）同行业其他企业情况”。

## （四）项目主要设备选择

本项目拟购置主要设备清单如下：

序号	名称	数量（台/套）
<b>一、新增研发设备</b>		
1	探针测试台	6
2	芯片全参数自动测试机	4
3	全自动 IV 特性测试仪 Curve Tracer	1
4	IPM 模块热电阻测试系统	1
5	示波器带高速 AC 和 DC 电流探头	10
6	差动高压探头	10
7	示波器高压探头	10

8	高压电源和开关电源	4
9	高性能示波器	40
10	高性能服务器	60
<b>二、新增办公设备</b>		
1	投影仪	4
2	会议电话	4
3	打字复印机	4
4	数码复合机（大型打印复印扫描机）	2
5	笔记本电脑	50
6	办公座椅	50
<b>三、新增软件</b>		
1	calibre（芯片版图设计软件）	25
2	Altium Designer（印刷电路板 PCB 设计软件）	15
3	MFGDream（测试良率分析软件）	20
4	EDA（Cadence Composer、Virtuoso、ADE）	37
5	MeQLab（博达微模型提取验证软件）	2

## （五）生产及动力供应情况

本项目的芯片生产制造、封装测试均委外代工，具体流程详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（八）行业特有的经营模式与特征”。

本项目动力消耗主要包括水、电等，可保证供应。

## （六）项目竣工时间、产量、产品销售方式

本项目将严格按照国家关于加强建设项目工程质量管理的相关规定严格执行建设程序，确保建设期工作质量，做到精心设计、安装及调试，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程如期保质完成。本项目建设期为36个月。

公司将重点把握市场发展趋势，在更广阔的范围推广公司的品牌和影响力，提高公司的市场占有率，适应客户采购模式变化和行业竞争特点，创新销售管理模式，打造综合销售平台。公司继续强化对现有客户资源的掌控，同时持续提升

产品营销能力，不断拓展新客户。具体产品销售方式和营销措施参见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“五、发行人的主营业务情况”之“（三）主要经营模式”。

## （七）环境保护

本项目性质为新产品设计研发，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。

## （八）项目选址

项目实施地点为上海市浦东新区，项目前期基础研发和准备工作的实施场所为公司现经营所在地上海市浦东新区张衡路666弄2号5层。随着项目投资进程，公司拟在现有经营所在地附近或其他集成电路产业企业较为集中的地段购置新的办公场所，以实施本项目后续的技术研究与产品开发。

## （九）项目的组织及实施

### 1、组织实施

为了保证项目顺利实施，公司专门成立项目领导组，同时针对项目的实施进度、工艺设备选型、设备工艺安装等成立项目实施组，针对工艺设备布置、安全环保工程等成立项目工程组，保证项目建设有序、保质开展。

### 2、项目进度计划

本项目计划建设期36个月，计划分五个阶段实施完成，包括初步设计、设备采购及安装、人员招聘及培训、试运营等阶段。

## 五、补充流动资金项目

### （一）项目背景及必要性

#### 1、满足公司经营规模快速增长带来的流动资金需求

报告期内，公司发展迅速，经营规模呈现快速增长趋势。2014年至2016年，公司分别实现营业收入33,727.01万元、35,712.04万元、57,088.11万元，复合增

长率达到 30.10%。在国家集成电路产业政策大力支持以及下游市场需求持续增长的背景下，预计未来公司经营规模仍将保持快速增长的趋势。公司资产主要以流动资产为主，公司日常经营较多涉及现款支付，折旧、摊销类的非现金支出相对较少。因此，公司需要保持较高水平的流动资金用于新产品技术研发、人才引进、原材料采购、市场销售等环节，以保持公司的竞争优势和行业领先地位，推动公司业务可持续发展。

## **2、优化财务结构，防范经营风险**

通过补充流动资金，公司的资产负债率将进一步降低，偿债能力和资产流动性进一步增强，进一步优化公司财务结构，防范经营风险，保证公司业务的顺利开展，有利于公司扩大业务规模，提高公司的综合竞争力，为公司未来可持续发展创造宽松的资金环境和良好的融资条件。

### **（二）补充流动资金的管理运营安排**

本次募集资金到位后，公司将根据实际经营状况和未来发展规划，合理投入募集资金，减少公司财务风险，提高持续经营能力。

公司将规范募集资金管理，保证募集资金合法合理使用，提高募集资金使用效率。公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件制定了募集资金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

公司将严格履行募集资金的申请和审批手续，努力提高资金的使用效率，完善并加强内部决策程序，全面有效的控制公司经营风险，合理防范募集资金使用风险，提高经营效率和盈利能力。

### **（三）对公司财务状况及经营成果的影响和对提升公司核心竞争力的作用**

本次募集资金补充营运资金后，公司可依据业务发展的实际需要将营运资金用于扩大生产、技术研发、市场开拓等方面，进一步提升公司的核心竞争力，同时还将优化公司资产负债结构，提高公司的偿债能力，降低公司的营运风险。

## 六、新增固定资产折旧对公司经营状况的影响

公司本次募集资金投资项目将有较大部分用于投资固定资产。以公司现行固定资产折旧政策，按直线法计算折旧，房屋及建筑物和机器设备分别按 20 年和 5 年的折旧年限。公司预计房屋及建筑物、机器设备的残值率为 5%。建成后各项目的新增年折旧费用如下：

单位：万元

项目名称	设备及办公设备		房屋建筑物		合计	
	投资额	年折旧	投资额	年折旧	投资额	年折旧
通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化项目	2,865.10	544.37	1,752.50	83.24	4,617.60	627.61
智能 LED 照明芯片开发及产业化项目	4,086.50	776.44	1,592.50	75.64	5,679.00	852.08
<b>合计</b>	<b>6,951.60</b>	<b>1,320.80</b>	<b>3,345.00</b>	<b>158.88</b>	<b>10,296.60</b>	<b>1,479.68</b>

募集资金项目全部建成投产后，公司每年增加折旧费用合计为 1,479.68 万元。报告期内，公司综合毛利率平均为 24.37%，在公司生产经营环境不发生重大变化的情况下，采用保守 20.00%的综合毛利率计算，项目建成投产后只要新增营业收入约 7,398.40 万元即可消除新增折旧费用的影响，保证公司盈利水平。

## 七、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响

### （一）对公司净资产和每股净资产的影响

预计本次募集资金到位后，公司的净资产及每股净资产将出现大幅提升。净资产的增加可进一步提高公司股票的内在价值，增强公司的资金规模和实力，提升公司的融资能力和抗风险能力，为公司下一步的市场扩张和战略部署提供有利的保障。

### （二）对净资产收益率和未来盈利能力的影响

本次募集资金到位后，公司的财务状况将得到显著改善。但由于受到固定资产增加而财务摊薄的影响，在短期内净资产收益率仍呈现下降趋势。此外，从项目筹备建设到完全达产仍需一段时间，在此期间内，募集资金投资项目尚不能对公司盈利提供贡献。但从中长期考虑，募集资金投资项目的顺利实施将大幅提升公司的营业收入和盈利水平。

### （三）对资产结构及资本结构的影响

本次募集资金到位后，公司资产总额、净资产将显著增加，流动比率和速动比率将大幅提高，资产负债水平将进一步下降，降低了公司的财务风险、增强了公司的偿债能力、提高了公司的融资能力。此外，在资本结构上，公司将引进较大比例的社会公众股东，进一步优化公司的股权结构，实现多元化的投资主体和完善的法人治理结构。

## 八、募集资金投资项目实施后对公司现有经营模式的影响

本次募集资金投资项目建成后，公司的经营模式不会发生重大变化。募集资金项目实施后，公司的业务结构将获得进一步的优化，生产规模、盈利能力和市场竞争力将得到进一步的提升，有利于公司继续保持和巩固市场领先地位。

## 第十四节 股利分配政策

### 一、发行人现行股利分配政策

#### （一）股利分配的一般政策

公司股票全部为普通股，每股享有同等权益，实行同股同利的分配政策，按各股东持有股份的比例派发股利。

#### （二）利润分配的顺序

1、公司的税后利润，按下列顺序分配：

- （一）弥补以前年度的亏损；
- （二）提取税后利润的百分之十列入法定公积金；
- （三）提取任意公积金；
- （四）向股东分配红利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司按照股东持有的股份比例分配红利。

2、股东大会决议将公积金转为股本时，按股东持有的股份比例派送新股。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

### 二、近三年股利分配情况

2016年4月15日，晶丰有限召开股东会，决定向全体股东分配现金红利7,313.00万元，该部分现金股利已经支付完成。

2016年11月11日，晶丰有限召开股东会，决定以未分配利润2,224.00万元转增注册资本，注册资本由1,100.00万元增至3,324.00万元，由各股东按原出资比例增资，该次增资方案已实施完毕。同时，会议决定向全体股东分配现金红利7,071.08万元，该部分现金股利已经支付完成。

### 三、发行后的股利分配政策

公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过《公司章程（草案）》，公司上市后的利润分配政策主要内容如下：

“第一百六十二条 公司的利润分配政策为：

#### （一）利润分配原则

公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分配股利，公司利润分配政策的基本原则为：

1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利；

4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

#### （二）利润分配形式及时间间隔

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律、法规允许的其他方式分配利润，分配的利润不得超过累计可分配利润的范围。具备现金分红条件的，公司优先考虑采取现金方式分配利润。公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况提议公司进行中期现金分红。

#### （三）现金分红的具体条件



- 1、公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、公司累计可供分配利润为正值；
- 3、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

#### （四）现金分红的比例

在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下，公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### （五）发放股票股利的具体条件

公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司经营情况良好，且董事会认为公司股本规模与公司规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，根据公司的累计可分配利润、公积金及现金流情况提出股票股利分配预案。

#### （六）利润分配的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、公司财务经营情况提出、拟定，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准；

2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；股东大会对利润分配方案进行审议时，除设置现场会议投票外，公司应为股东提供网络投票方式以方便中小股东参与表决；

4、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案、利润分配政策的修改进行审议；

5、公司上一个会计年度实现盈利，但董事会未提出年度现金分红预案的，公司董事会应当在年度报告中披露未分配现金红利的原因及未用于分配现金红利的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

6、公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### （七）利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### （八）利润分配政策的调整

若公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整或者变更利润分配政策的，董事会应当经过详细论证后，以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策。公司利润分配政策的修改由公司董事会向公司股东大会提出，并经出席股东大会的股东所持表决

权的 2/3 以上表决通过。独立董事应当对利润分配政策的修改发表意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

#### （九）利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合法、合规和透明等。”

### 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

## 第十五节 其他重要事项

### 一、信息披露相关情况

为保护投资者合法权利，加强公司信息披露工作的有序管理，公司按照中国证监会的有关规定，建立了严格的信息披露制度，并设立证券管理部作为公司信息披露和投资者关系的负责部门，该部门负责人为公司董事会秘书汪星辰先生，对外咨询电话：021-51870166；传真：021-50275095。

### 二、重要合同

截至本招股说明书签署之日，公司现行有效的重大商务合同如下：

#### （一）重大销售合同

1、公司与多家经销商签订了《产品经销协议》，协议形式为框架协议，双方就经销商渠道操作规则、订货、交货与验收规则、支付方式等内容进行了约定。与主要经销商的协议内容如下：

序号	经销商	合同编号	签署日期	有效期
1	广州晶丰电子科技有限公司	BPS-JX-201701-002	2017.1.1	一年
2	厦门欣友联电子科技有限公司	BPS-JX-201701-008	2017.1.1	一年
3	深圳市怡海能达有限公司	BPS-JX-201701-004	2017.1.1	一年
4	中山市苏电科技电子有限公司	BPS-JX-201701-009	2017.1.1	一年
5	上海元捷电子科技有限公司	BPS-JX-201701-001	2017.1.1	一年
6	上海迎霄电子有限公司	BPS-JX-201701-006	2017.1.1	一年
7	深圳市弘雷电子有限公司	BPS-JX-201701-012	2017.1.1	一年

2、公司与直销客户深圳市暗能量电源有限公司签订《销售框架协议》，约定由公司向深圳市暗能量电源有限公司出售相关产品，期限为一年，自2017年1月1日至2017年12月31日。该合同为框架性销售合同，双方就产品订货、交付、付款规则等内容进行了约定。

#### （二）重大采购合同

1、2014年12月8日，公司与江苏长电科技股份有限公司签订《封装加工合同》，约定由公司委托江苏长电科技股份有限公司提供封装加工服务，有效期两年，自2014年12月1日起至2016年11月30日止，如合同一方在合同到期日的前两个月未有通知另一方终止合同，则本合同有效期自动续展一年。双方就交货方式、交货日期、包装要求等事项做了约定。

2、2016年12月29日，公司与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司签订《芯片代工协议》，约定由公司向中芯国际集成电路制造（上海）订购晶圆片，有效期三年。双方就订单和生产测试、芯片的运输与验收、定价及付款等事项做了约定。

3、2017年4月14日，公司与天水华天科技股份有限公司签订《IC封装（测试）协议》，约定由公司委托天水华天科技股份有限公司提供封装加工服务和测试，有效期一年。双方就加工内容、加工计划与交期、主要原材料、技术及变更、质量及交验等事项做了约定。

4、2017年6月26日，公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司签订《晶圆制造协议》，约定由公司委托上海华虹宏力半导体制造有限公司按照相应的规格要求生产制造晶圆产品，有效期三年。双方就生产和订单、支付、质量和验收等事项做了约定。

5、2017年7月21日，公司与吉林华微电子股份有限公司签订《买卖合同》，约定由公司向吉林华微电子股份有限公司采购相关产品，有效期三年，自2017年7月21日起至2020年7月20日止。双方就结算期限及付款方式、交货地点、运输方式及包装标准等事项做了约定。

### （三）银行承兑协议

截至本招股说明书签署之日，公司正在履行的金额在500.00万元以上的银行承兑协议如下：

序号	承兑协议编号	承兑申请人	承兑人	承兑金额(元)
1	CD97162017880042	晶丰明源	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	6,820,167.02

2	CD97162017880045	晶丰明源	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	12,000,000.00
3	CD97162017880052	晶丰明源	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	6,554,352.95
4	CD97162017880074	晶丰明源	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	6,800,000.00

# 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构 声明

## 一、董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

胡黎强 胡黎强

刘洁茜

刘洁茜

夏 风

夏风

苏仁宏

苏仁宏

冯震远

冯震远

孙文秋

孙文秋

应 俊

应俊

全体监事签名：

张 宜

张宜

周占荣

周占荣

李 宁

李宁

其他高级管理人员签名：

孙顺根

孙顺根

汪星辰

汪星辰

上海晶丰明源半导体股份有限公司

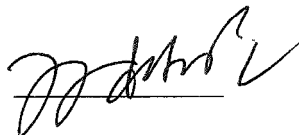


2017年 9月 18日

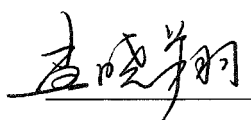
## 二、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

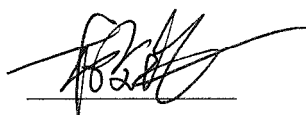
法定代表人： 孙树明



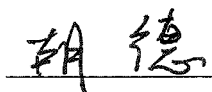
保荐代表人： 孟晓翔



林文坛



项目协办人： 胡 德



广发证券股份有限公司

2017年 9月 18日





### 三、发行人律师声明

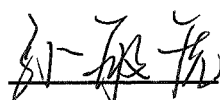
本所及经办律师已阅读上海晶丰明源半导体股份有限公司招股说明书及其摘要，确认上海晶丰明源半导体股份有限公司招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在上海晶丰明源半导体股份有限公司招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认上海晶丰明源半导体股份有限公司招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

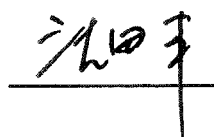
王 侃



孙敏虎



律师事务所负责人：沈田丰



国浩律师（杭州）事务所

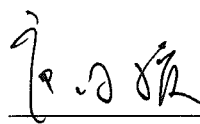



2017年9月16日

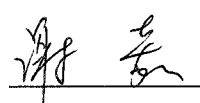

#### 四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读上海晶丰明源半导体股份有限公司招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



签字注册会计师：唐国骏

谢嘉

会计师事务所负责人：朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

  
2017年9月18日


## 五、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读上海晶丰明源半导体股份有限公司招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字资产评估师： 刘媛媛

  
资产评估师  
刘媛媛  
31080005

侯旭芳

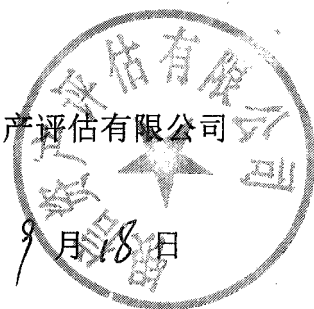
  
资产评估师  
侯旭芳  
31160015

资产评估机构负责人： 梅惠民



银信资产评估有限公司

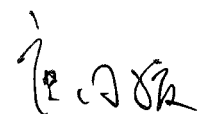

2017年9月18日



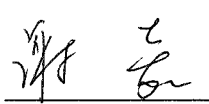

## 六、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读上海晶丰明源半导体股份有限公司招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师： 唐国骏

谢 嘉

验资机构负责人： 朱建弟


立信会计师事务所（特殊普通合伙）

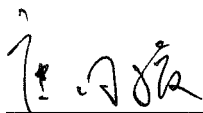


2017年9月18日

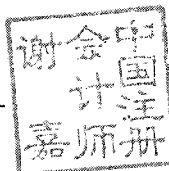
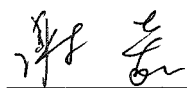
### 七、验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读上海晶丰明源半导体股份有限公司招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师： 唐国骏



谢 嘉



验资机构负责人： 朱建弟



立信会计师事务所（特殊普通合伙）



## 第十七节 备查文件

### 一、附录和备查文件

- （一）发行保荐书；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制鉴证报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、整套发行申请材料和备查文件查阅地点

投资者可以在下列地点查阅整套发行申请材料和有关备查文件。

- （一）发行人：上海晶丰明源半导体股份有限公司

联系地址：中国(上海)自由贸易试验区张衡路 666 弄 2 号 5 层 504-511

室

联系人：汪星辰

联系电话：021-51870166、021-50275095（传真）

- （二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

联系地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼

联系人：聂韶华

联系电话：020-87555888、020-87553577（传真）